

澜起科技股份有限公司

Montage Technology Co., Ltd.

（上海市徐汇区宜山路 900 号 1 幢 A6）



**关于澜起科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文
件的第二轮审核问询函之回复报告**

保荐机构（牵头主承销商）



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

上海证券交易所：

贵所于 2019 年 5 月 9 日出具的《关于澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）（2019）98 号）（以下简称“问询函”）收悉，中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构（牵头主承销商），会同澜起科技、国浩律师（上海）事务所（以下简称“发行人律师”）、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关各方对问询函相关问题逐项进行了落实，回复如下，请审核。

除另有说明外，本回复报告所用简称与招股说明书所用简称一致。

问询函所列问题	黑体（不加粗）
对问题的回答	宋体（不加粗）
引用原招股说明书内容	楷体（不加粗）
对招股说明书的修改、补充	楷体（加粗）

目录

1.关于首轮问询未完成事项	3
2.关于增资协议的约定	50
3.关于津逮®服务器	59
4.关于关联交易	70
5.关于业务重组	74
6.关于营业收入	89
7.关于成本	102
8.关于存货	112
9.关于费用	125
10.关于销售和采购返利	134
11.关于 IP 授权许可费	136
12.关于研发项目	142
13.关于发行人股东	147
14.关于银行理财产品	150
15.关于现金分红	153
16.关于核心技术人员认定	156
17.关于股东承诺	159
18.关于信息披露	161
19.关于其他问题	164

1.关于首轮问询未完成事项

请发行人、保荐机构及相关证券服务机构对首轮问询回复中未明确答复的以下问题予以答复并说明首轮未答复的理由：（1）发行人改制、历次股权转让时各股东缴纳所得税的情况；（2）对于申报前一年内发行人通过增资或股权转让引入的新股东，请发行人补充披露相关股东的股权结构及实际控制人，如为合伙企业的，请补充披露基本情况及其普通合伙人的基本信息，如为自然人的，请补充披露其基本信息；（3）成都澜至、上海澜至、澜至半导体穿透后直接和间接股东与发行人直接或间接股东的重叠情况，报告期内与发行人存在人员、技术、业务或资金往来的具体情况，报告期各期与发行人存在重叠供应商、客户的具体情况；（4）对津逮[®]服务器平台业务面临的不确定性风险、DDR5 推出可能给发行人带来的影响等作重大事项提示；（5）提供全体股东关于确认 2019 年第一次临时股东大会决议效力的书面意见。

请发行人、保荐机构及相关证券服务机构全面核查是否存在其他未回复或回复存在问题的情况，认真评估自身申请文件的制作质量并发表明确意见。

回复：

1.1 发行人说明

一、发行人改制、历次股权转让时各股东缴纳所得税的情况；

1、公司改制时，各股东缴纳所得税情况

2018 年 10 月 28 日，澜起有限以截至 2018 年 7 月 31 日经审计的净资产值 1,749,770,556.92 元为依据，按照 1:0.516554 比例折成股本 903,851,100 股，每股面值为 1 元，净资产大于股本的部分，即 845,919,456.92 元计入公司资本公积，改制后的注册资本为 903,851,100 元。本次改制前后，公司注册资本未发生变化，不存在以资本公积转增股本的情形，仅存在将未分配利润和盈余公积转增资本公积的情形。

改制时公司共有 44 名境内外股东，其中境外非自然人股东 10 名、境外自然人股东 6 名、境内法人股东 5 名、境内合伙企业股东 23 名，上述股东缴纳所得税情况具体如下：

（1）境外非自然人股东

就公司改制时涉及的股东所得税事宜，公司已为其 10 名境外非自然人股东向国家税务总局上海市徐汇区税务局递交境外投资者递延缴纳预提所得税报告并获得其确认，确认该部分境外非自然人股东可以享受递延缴纳预提所得税待遇。

（2）境外自然人股东

根据《财政部、国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税。因此，境外自然人股东针对本次股改免征收个人所得税。

（3）境内法人股东

根据《企业所得税法》及其实施条例等的相关规定，法人按照年度计算所得税的应纳税所得额，公司的境内法人股东无需单独就改制事项缴纳企业所得税。

根据境内法人股东的确认及承诺，该部分股东均将按照法律、法规及规范性文件的要求，向主管税务机关缴纳相应税款。

（4）境内合伙企业股东

根据《企业所得税法》、《个人所得税法》等相关法律法规的规定，就公司的合伙企业股东针对改制涉及的纳税事宜，公司依法不承担代扣代缴义务。本次改制并没有现金分配及资金流转，因境内合伙企业都采用“先分后税”的方式，目前相关境内合伙企业股东暂未针对本次股改进行缴税。

根据境内合伙企业股东的确认及承诺，该部分股东均将按照法律、法规及规范性文件的要求，向主管税务机关缴纳相应税款。

2、历次股权转让所得税缴纳情况

公司历史上共有 2 次股权转让，具体情况如下：

（1）第一次股权转让

Montage Group 与 Montage HK 于 2010 年 11 月 15 日签署《股权转让协议》，约定将其持有的澜起有限 100% 的股权转让给 Montage HK，具体情况如下：

转让方名称	受让方名称	受让注册资本金额 (万美元)	股权转让价款 (万美元)	受让比例 (%)
Montage Group	Montage HK	1,000	1,000	100.00

上述股权系平价转让，转让价格系 Montage Group 的投入成本，故转让方应缴纳所得税额为零元。

（2）第二次股权转让

Montage HK 于 2018 年 4 月将其所持澜起有限 83.757%股权转让给包括中电投控、嘉兴芯电、WLT 在内的 39 名境内外主体，具体情况如下：

序号	受让方名称/姓名	受让注册资本金额 (元)	股权转让价款 (元)	受让比例 (%)
1	中电投控	161,716,775	918,551,282.00	17.892
2	嘉兴芯电	21,128,300	120,008,744.00	2.338
3	WLT	87,816,687	498,798,782.16	9.716
4	珠海融英	23,088,413	131,142,185.84	2.554
5	上海临理	53,506,750	303,918,340.00	5.920
6	上海临丰	18,610,575	105,708,066.00	2.059
7	上海临骥	15,234,825	86,533,806.00	1.686
8	上海临利	13,339,175	75,766,514.00	1.476
9	上海临国	13,070,825	74,242,286.00	1.446
10	临桐建发	9,276,675	52,691,514.00	1.026
11	上海临齐	7,011,450	39,825,036.00	0.776
12	嘉兴宏越	44,247,750	251,327,220.00	4.895
13	嘉兴莫奈	20,634,525	117,204,102.00	2.283
14	Xinyun I	44,247,750	251,327,220.00	4.895
15	Xinyun	12,057,500	68,486,600.00	1.334
16	Xinyun III	2,076,425	11,794,094.00	0.230
17	中证投资	51,033,325	289,869,286.00	5.646
18	中睿一期	35,294,550	200,473,044.00	3.905
19	中睿二期	5,597,200	31,792,096.00	0.619
20	泰瑞嘉德	16,108,750	91,497,700.00	1.782
21	华天宇投资	9,758,175	55,426,434.00	1.080
22	上海华伊	21,500,000	122,120,000.00	2.379
23	光大投资	10,535,175	59,839,794.00	1.166
24	西藏长乐	10,217,075	58,032,986.00	1.130
25	宁波信远	10,206,675	57,973,914.00	1.129
26	杭州调露	9,250,000	52,540,000.00	1.023
27	上海君弼	8,235,350	46,776,788.00	0.911
28	Green Spark	7,525,000	42,742,000.00	0.833

序号	受让方名称/姓名	受让注册资本金额 (元)	股权转让价款 (元)	受让比例 (%)
1	中电投控	161,716,775	918,551,282.00	17.892
2	嘉兴芯电	21,128,300	120,008,744.00	2.338
3	WLT	87,816,687	498,798,782.16	9.716
29	Chen Xiao	3,750,000	21,300,000.00	0.415
30	New Speed	3,125,000	17,750,000.00	0.346
31	TransLink	3,125,000	17,750,000.00	0.346
32	Pine Stone Capital	2,212,500	12,567,000.00	0.245
33	BICI	1,047,350	5,948,948.00	0.116
34	Lip-Bu Tan	500,000	2,840,000.00	0.055
35	Ko Ping Keung	500,000	2,840,000.00	0.055
36	前海珂玺	196,250	1,114,700.00	0.022
37	Xi Jin	100,000	568,000.00	0.011
38	Shun-Wen Chang	100,000	568,000.00	0.011
39	Qian-Shen Bai	50,000	284,000.00	0.006
合计		757,031,775	4,299,940,482.00	83.757

根据《企业所得税法》的规定，作为股权转让方，Montage HK 为股权转让所得的纳税义务人，股权转让价款的支付方即受让方为扣缴义务人，由于此次股权转让的价格低于 Montage HK 对公司的投资成本，此次转让的应交税额为零元。境内受让方及 Montage HK（代境外受让方）已向相关税务主管机关报送了对外支付税务备案表和所得税报告表，完成了相关的代扣代缴义务。

3、发行人的税务合规情况

根据国家税务总局上海市徐汇区税务局于 2019 年 1 月 17 日出具的《证明》，确认“澜起科技股份有限公司系我局所辖纳税人，纳税人统一社会信用代码为 913100007626333657。经查询：该公司自 2016 年 1 月至 2018 年 12 月，一般能按期申报、缴纳各项税费。暂未发现税收违法行为。”

综上所述，发行人改制、历次股权转让时，除无需办理税务缴纳的股东外，发行人各股东已按照或承诺将按照相关税务法律法规的规定办理了纳税申报，公司在报告期内依法纳税并取得合规证明。

二、对于申报前一年内发行人通过增资或股权转让引入的新股东，请发行

人补充披露相关股东的股权结构及实际控制人，如为合伙企业的，请补充披露基本情况及其普通合伙人的基本信息，如为自然人的，请补充披露其基本信息

(一) 发行人第二次股权转让

2018年4月26日，澜起有限决议同意股东 Montage HK 将其所持澜起有限 83.757%股权转让予包括中电投控、嘉兴芯电、WLT 在内的 39 名境内外主体。此次股权转让的目的为发行人拆除境外架构以实现公司间接股东直接持有澜起有限股权。

(二) 发行人第六次增加注册资本

2018年11月23日，发行人2018年第一次临时股东大会作出决议，同意 Intel Capital 以 175,074,860 美元的价格认购发行人 101,683,250 股新增股份，SVIC No. 28 Investment 以 19,452,762 美元的价格认购发行人 11,298,150 股新增股份，增资价格系发行人与增资方协商确定。此次增资后发行人注册资本由 903,851,100 元增加至 1,016,832,500 元。

(三) 新股东基本情况

申报前一年内发行人通过增资引入的新股东 2 名，通过股权转让引入的新股东 38 名，合计 40 名。其中 9 名为公司法人，25 名为合伙企业，其余 6 名为自然人，该部分股东具体情况如下：

1、法人股东

(1) 中电投控

名称	中国电子投资控股有限公司
成立时间	2012 年 8 月 27 日
统一社会信用代码	91110000717833800A
经营范围/主营业务	股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询
住所	北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 21 层
实际控制人	无实际控制人，第一大股东为中国电子信息产业集团有限公司

中电投控目前的股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
----	------	---------

序号	股东名称	持股比例（%）
1	中国电子信息产业集团有限公司	30.00
2	国新科创股权投资基金（有限合伙）	20.00
3	北京建信瑞祥投资管理中心（有限合伙）	20.00
4	北京亦庄国际投资发展有限公司	15.00
5	武汉伊莱克股权投资基金合伙企业（有限合伙）	15.00
	合计	100.00

（2）中证投资

名称	中信证券投资有限公司
成立时间	2012 年 4 月 1 日
统一社会信用代码	91370212591286847J
经营范围/主营业务	金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）
住所	青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
实际控制人	中信证券股份有限公司

中证投资目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	中信证券股份有限公司	100.00
	合计	100.00

（3）光大投资

名称	中国光大投资管理有限责任公司
成立时间	1992 年 8 月 3 日
统一社会信用代码	91100000710931678K
经营范围/主营业务	资产受托管理；企业重组、兼并策划；企业管理咨询；投资及投资管理；财务顾问；物业管理
住所	北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 22 层
实际控制人	国务院

光大投资目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	中国光大实业（集团）有限责任公司	100.00

序号	股东名称	出资比例（%）
1	中国光大实业（集团）有限责任公司	100.00
	合计	100.00

(4) 西藏长乐

名称	西藏长乐投资有限公司
成立时间	2015 年 7 月 8 日
统一社会信用代码	91540091321327434U
经营范围/主营业务	投资管理（不含金融和经纪业务）；资产管理（不含金融资产管理 和保险资产管理）；企业策划；财务咨询
住所	拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号世通阳光新城 1 栋 5 单元 3-2 号
实际控制人	芦清云

西藏长乐目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	乾通科技实业有限公司	100.00
	合计	100.00

(5) Green Spark

名称	Green Spark Investment Limited
成立时间	2015 年 2 月 10 日
注册编号	1862216
国家/地区	英属维京群岛
经营范围/主营业务	投资
实际控制人	YU Feng

Green Spark 目前的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Yunfeng Fund II,L.P.	100.00
	合计	100.00

(6) New Speed

名称	New Speed Consultancy Co., Ltd.
成立时间	2001 年 4 月 20 日

注册编号	441519
国家/地区	英属维京群岛
经营范围/主营业务	投资
实际控制人	Shaw Shung-Ho

New Speed 目前的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Anfu Holdings Limited	100.00
	合计	100.00

(7) Pine Stone Capital

名称	Hong Kong Pine Stone Capital Limited
成立时间	2016 年 4 月 11 日
注册编号	2359357
国家/地区	香港特别行政区
经营范围/主营业务	投资
实际控制人	Zhou Jianjun

Pine Stone Capital 目前的股权结构情况如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Zhou Jianjun	100.00
	合计	100.00

(8) 前海珂玺

名称	深圳前海珂玺资本管理有限公司
成立时间	2016 年 2 月 22 日
统一社会信用代码	914403003600799209
经营范围/主营业务	受托资产管理、资本管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资管理（不含金融、证券、保险及其它限制项目）；股权投资（不含限制项目）
住所	深圳市南山区粤海街道海德一道 88 号中洲控股金融中心 B 座 33A-2
实际控制人	王珍

前海珂玺目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	王珍	95.00
2	朱后锋	5.00
	合计	100.00

(9) Intel Capital

名称	Intel Capital Corporation
成立时间	1998 年 4 月 6 日
统一社会信用代码	2880872
国家/地区	美国
经营范围/主营业务	投资
实际控制人	Intel Corporation

Intel Capital 目前的股权结构如下：

序号	股东名称	出资比例（%）
1	Intel Corporation	100.00
	合计	100.00

2、合伙企业股东

(1) 嘉兴芯电

名称	嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016 年 1 月 29 日
统一社会信用代码	91330402MA28A6T11A
经营范围/主营业务	实业投资、投资管理
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 101 室-64
普通合伙人	嘉兴中电朝云投资管理有限公司

嘉兴芯电目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	嘉兴中电朝云投资管理有限公司	普通合伙人	0.04
2	天津鹏吉亚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	99.44
3	王静	有限合伙人	0.52
	合计	/	100.00

嘉兴芯电普通合伙人嘉兴中电朝云投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	嘉兴中电朝云投资管理有限公司
成立时间	2016 年 9 月 26 日
统一社会信用代码	91330402MA28ANKX26
经营范围/主营业务	投资管理、资产管理
住所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 101 室-65

嘉兴中电朝云投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	中电通商融资租赁有限公司	100.00
	合计	100.00

(2) WLT

名称	WLT Partners, L.P.
成立时间	2015 年 10 月 15 日
注册编号	83610
国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	WYK Co., Ltd.

WLT 目前的合伙人权益情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	合伙权益比例（%）
1	WYK Co., Ltd.	普通合伙人	23.33
2	杨崇和	有限合伙人	23.33
3	Stephen Kuong-Io TAI	有限合伙人	23.33
4	SCGC Capital Holding Company Limited	有限合伙人	30.00
	合计	/	100.00

WLT 普通合伙人 WYK Co., Ltd.的基本情况如下：

名称	WYK Co., Ltd.
成立时间	2015 年 10 月 9 日
注册编码	304710
国家/地区	开曼群岛

经营范围/主营业务	投资
-----------	----

WYK Co., Ltd.目前的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资比例 (%)
1	Tai kuai Lap	50.00
2	Chao Iong Wa	50.00
	合计	100.00

(3) 上海临理

名称	上海临理投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 23 日
统一社会信用代码	91310115MA1H75XF98
经营范围/主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）
主要经营场所	上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
普通合伙人	上海临芯投资管理有限公司、上海理能资产管理有限公司

上海临理目前的合伙人出资情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例 (%)
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.09
2	上海理能资产管理有限公司	普通合伙人	0.09
3	昆山理成盛联股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	20.48
4	上海理成资产管理有限公司	有限合伙人	14.73
5	宁波江淦投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	13.21
6	平潭建发柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9.22
7	西藏派诺投资咨询有限公司	有限合伙人	8.80
8	宁波钰鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.48
9	上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.05
10	程义全	有限合伙人	3.97
11	深圳市同创伟业创业投资有限公司	有限合伙人	2.99
12	上海俊颐商务咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	2.65
13	上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2.20
14	盐城经济技术开发区燕舞半导体产业基金（有限合伙）	有限合伙人	1.77

15	深圳市创新投资集团有限公司	有限合伙人	1.77
16	上海临港智兆股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1.76
17	广州隆玺壹号投资中心(有限合伙)	有限合伙人	0.89
18	上海永徽隆启创业投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	0.89
	合计	/	100.00

上海临理普通合伙人上海临芯投资管理有限公司、上海理能资产管理有限公司的基本情况如下：

A. 上海临芯投资管理有限公司

名称	上海临芯投资管理有限公司
成立时间	2015 年 5 月 26 日
统一社会信用代码	91310115342373528A
经营范围/主营业务	实业投资、投资咨询、投资管理（除经纪）
住所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 1250 室

上海临芯投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	李亚军	35.00
2	上海清云图投资合伙企业（有限合伙）	30.00
3	靖昕伟	20.00
4	中原信托有限公司	15.00
	合计	100.00

B. 上海理能资产管理有限公司

名称	上海理能资产管理有限公司
成立时间	2013 年 7 月 16 日
统一社会信用代码	913101130729710765
经营范围/主营业务	资产管理；投资管理
住所	上海市宝山区蕴川路 5503 号 A 幢 561 室

上海理能资产管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	程义全	100.00

	合计	100.00
--	----	--------

(4) 上海临丰

名称	上海临丰投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 23 日
统一社会信用代码	91310115MA1H75XE0B
经营范围/主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
普通合伙人	上海临芯投资管理有限公司、法鳌资本管理（北京）有限公司

上海临丰目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.27
2	法鳌资本管理（北京）有限公司	普通合伙人	0.45
3	萍乡盛誉企业管理中心（有限合伙）	有限合伙人	23.19
4	张伟	有限合伙人	23.19
5	谭健	有限合伙人	16.24
6	薛超雄	有限合伙人	13.13
7	张益驰	有限合伙人	9.28
8	刘曙光	有限合伙人	4.64
9	沈存礼	有限合伙人	1.95
10	顾然	有限合伙人	1.86
11	华通	有限合伙人	1.39
12	周玟朵	有限合伙人	1.39
13	张雪菲	有限合伙人	0.93
14	郝若辰	有限合伙人	0.93
15	廖茂林	有限合伙人	0.70
16	常亮	有限合伙人	0.46
	合计	/	100.00

上海临丰普通合伙人上海临芯投资管理有限公司、法鳌资本管理（北京）有限公司的基本情况如下：

A. 上海临芯投资管理有限公司

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本题 3、新股东情况（2）合伙企业股东 3）上海临理 A 上海临芯投资管理有限公司部分。

B. 法鳌资本管理（北京）有限公司

名称	法鳌资本管理（北京）有限公司
成立时间	2016 年 3 月 11 日
统一社会信用代码	91110105MA0043NX3P
经营范围/主营业务	资产管理；投资管理；项目投资
住所	北京市朝阳区霞光里 8 号 2 号楼六层 8602A 室

法鳌资本管理（北京）有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	周玖朵	100.00
	合计	100.00

（5）上海临骥

名称	上海临骥投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 23 日
统一社会信用代码	91310115MA1H75RT5G
经营范围/主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
普通合伙人	上海临芯投资管理有限公司、深圳市领骥资本管理有限公司

上海临骥目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.37
2	深圳市领骥资本管理有限公司	普通合伙人	0.19
3	青岛银邑投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	99.44
	合计	/	100.00

上海临骥普通合伙人上海临芯投资管理有限公司、深圳市领骥资本管理有限公司的基本情况如下：

A. 上海临芯投资管理有限公司

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本题 3、新股东情况（2）合伙企业股东 3）上海临理 A 上海临芯投资管理有限公司部分。

B. 深圳市领骥资本管理有限公司

名称	深圳市领骥资本管理有限公司
成立时间	2015 年 2 月 28 日
统一社会信用代码	914403003197446777
经营范围/主营业务	投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

深圳市领骥资本管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	曹鸿伟	65.00
2	湖北瑞森嘉茂贸易有限公司	35.00
	合计	100.00

（6）上海临利

名称	上海临利投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 12 月 7 日
统一社会信用代码	91310115MA1H77T49A
经营范围/主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
普通合伙人	上海临芯投资管理有限公司、北京盛世共赢资产管理有限公司

上海临利目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	1.37
2	北京盛世共赢资产管理有限公司	普通合伙人	0.46
3	达孜欧律投资中心（有限合伙）	有限合伙人	44.03
4	江阴优势同创产业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	36.06
5	上海桐彤企业管理中心（有限合伙）	有限合伙人	9.11
6	苏州优势四号投资中心（有限合伙）	有限合伙人	8.98
	合计	/	100.00

上海临利普通合伙人上海临芯投资管理有限公司、北京盛世共赢资产管理有限公司的基本情况如下：

A. 上海临芯投资管理有限公司

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本题 3、新股东情况（2）合伙企业股东 3）上海临理 A 上海临芯投资管理有限公司部分。

B. 北京盛世共赢资产管理有限公司

名称	北京盛世共赢资产管理有限公司
成立时间	2014 年 11 月 6 日
统一社会信用代码	91110105318162288D
经营范围/主营业务	资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；项目投资；投资管理；投资咨询
住所	北京市朝阳区朝阳门南大街 14 号二层 2412

北京盛世共赢资产管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	中欧盛世资产管理（上海）有限公司	100.00
	合计	100.00

（7）上海临国

名称	上海临国投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 23 日
统一社会信用代码	91310115MA1H75XD2G
经营范围/主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
普通合伙人	上海临芯投资管理有限公司、青岛海丝泉宗投资管理有限公司

上海临国目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.39
2	青岛海丝泉宗投资管理有限公司	普通合伙人	0.65
3	青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）	有限合伙人	98.97
	合计	/	100.00

上海临国普通合伙人上海临芯投资管理有限公司、青岛海丝泉宗投资管理有限公司的基本情况如下：

A. 上海临芯投资管理有限公司

上海临芯投资管理有限公司基本信息及股权结构详见本题 3、新股东情况（2）合伙企业股东 3）上海临理 A 上海临芯投资管理有限公司部分。

B. 青岛海丝泉宗投资管理有限公司

名称	青岛海丝泉宗投资管理有限公司
成立时间	2015 年 9 月 7 日
统一社会信用代码	91370212350344436P
经营范围/主营业务	自有资金对外投资及管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），股权投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
住所	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 1001 室

青岛海丝泉宗投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	青岛城投金融控股集团有限公司	36.00
2	王朝晖	32.00
3	深圳泉宗投资有限公司	32.00
	合计	100.00

（8）临桐建发

名称	上海临桐建发投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 24 日
统一社会信用代码	91310115MA1H763C6F
经营范围/主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
普通合伙人	上海临芯投资管理有限公司

临桐建发目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	0.80
2	厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	有限合伙人	40.00

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
3	宁波典烁投资中心（有限合伙）	有限合伙人	30.00
4	王琳玲	有限合伙人	12.00
5	施金根	有限合伙人	5.60
6	尤金花	有限合伙人	5.60
7	王荣仙	有限合伙人	4.00
8	徐晓刚	有限合伙人	1.00
9	梅勤峰	有限合伙人	1.00
	合计	/	100.00

临桐建发普通合伙人上海临芯投资管理有限公司的基本信息及股权结构详见本题 3、新股东情况（2）合伙企业股东 3）上海临理 A 上海临芯投资管理有限公司部分。

（9）上海临齐

名称	上海临齐投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 23 日
统一社会信用代码	91310115MA1H75Y7XK
经营范围/主营业务	实业投资、投资管理、投资咨询（除经纪）
主要经营场所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼
普通合伙人	上海临芯投资管理有限公司

上海临齐目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	上海临芯投资管理有限公司	普通合伙人	1.20
2	文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	37.05
3	郝向东	有限合伙人	24.70
4	宁波瀚丰长元股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	24.70
5	崔春	有限合伙人	12.35
	合计	/	100.00

临桐建发普通合伙人上海临芯投资管理有限公司的基本信息及股权结构详见本题 3、新股东情况（2）合伙企业股东 3）上海临理 A 上海临芯投资管理有限公司部分。

（10）嘉兴宏越

名称	嘉兴宏越投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 17 日
统一社会信用代码	91330402MA28A2DL2A
经营范围/主营业务	实业投资、投资管理
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 101 室-70
普通合伙人	嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、上海齐银股权投资基金管理有限公司

嘉兴宏越目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.40
2	上海齐银股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	0.01
3	昆山理弋股权投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	23.78
4	义乌淳施投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	16.70
5	华峰集团有限公司	有限合伙人	15.20
6	杭州秋祺投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	15.20
7	杭州圆成投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	13.31
8	海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.50
9	丽水中盈酉导天行股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.50
10	袁霞	有限合伙人	0.40
	合计	/	100.00

嘉兴宏越普通合伙人嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、上海齐银股权投资基金管理有限公司的基本情况如下：

A. 嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）

名称	嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 11 月 12 日

统一社会信用代码	91330402MA28A27P7T
经营范围/主营业务	投资管理
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 101 室-68

嘉兴宏鼎投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	袁霞	普通合伙人	80.00
2	刘芳	有限合伙人	20.00
	合计	/	100.00

B. 上海齐银股权投资基金管理有限公司

名称	上海齐银股权投资基金管理有限公司
成立时间	2015 年 11 月 25 日
统一社会信用代码	91310000MA1FL0NK7W
经营范围/主营业务	股权投资管理，投资管理，资产管理
住所	中国（上海）自由贸易试验区东方路 738 号 905 室

上海齐银股权投资基金管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	孙兴华	51.00
2	王路	49.00
	合计	100.00

（11）嘉兴莫奈

名称	嘉兴莫奈股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2018 年 4 月 17 日
统一社会信用代码	91330402MA2B9X3B91
经营范围/主营业务	股权投资及相关咨询服务
主要经营场所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 120 室-26
普通合伙人	宁波梅山保税港区宏燚投资管理有限公司

嘉兴莫奈目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	宁波梅山保税港区宏燚投资管理有限公司	普通合伙人	0.01

2	上海旗贤企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	49.79
3	上海霆杨投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	18.37
4	上海涌善投资管理中心（有限合伙）	有限合伙人	10.19
5	上海恒融电子科技合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8.25
6	宁波与君股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7.32
7	杨永梅	有限合伙人	2.29
8	袁霞	有限合伙人	1.47
9	天津德瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1.44
10	杨玉杰	有限合伙人	0.87
	合计	/	100.00

嘉兴莫奈普通合伙人宁波梅山保税港区宏燚投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	宁波梅山保税港区宏燚投资管理有限公司
成立时间	2018 年 3 月 15 日
统一社会信用代码	91330206MA2AHH893W
经营范围/主营业务	投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 H0173

宁波梅山保税港区宏燚投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	袁霞	95.00
2	韩丹	5.00
	合计	100.00

（12）Xinyun I

名称	Xinyun Capital Fund I, L.P.
成立时间	2016 年 7 月 29 日
注册编号	86620
国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.

Xinyun I 目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.	普通合伙人	0.00
2	Xinyun Investment I, LLC	有限合伙人	0.00
3	Green Spark Investment II Limited	有限合伙人	100.00
	合计	/	100.00

Xinyun I 普通合伙人 Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.的基本情况如下：

名称	Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.
成立时间	2014 年 4 月 10 日
注册编码	286896
国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资

Yunfeng Moon Co-Invest GP, Ltd.的目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Yunfeng Investment III, Ltd.	100.00
	合计	100.00

(13) Xinyun

名称	Xinyun Capital Fund, L.P.
成立时间	2014 年 12 月 19 日
注册编号	80503
国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	Xinyun Capital Management,Ltd.

Xinyun 目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	Xinyun Capital Management,Ltd.	普通合伙人	0.00
2	Tonex Controls Limited	有限合伙人	91.74
3	Leslie Lee	有限合伙人	8.26
	合计	/	100.00

Xinyun 普通合伙人 Xinyun Capital Management,Ltd.的基本情况如下:

名称	Xinyun Capital Management,Ltd.
成立时间	2014 年 12 月 17 日
注册编码	294758
国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资

Xinyun Capital Management,Ltd.的目前的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资比例 (%)
1	Yuan Xia	50.00
2	Jimmy Lee	50.00
	合计	100.00

(14) Xinyun III

名称	Xinyun Capital Fund III, L.P.
成立时间	2015 年 9 月 30 日
注册编号	83426
国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	Xinyun Capital Management III,Ltd

Xinyun III 目前的合伙人出资情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例 (%)
1	Xinyun Capital Management III,Ltd.	普通合伙人	0.00
2	Li Tong	有限合伙人	56.25
3	Sino French Resources Limited	有限合伙人	16.41
4	Sun Fanghong	有限合伙人	19.79
5	Jimmy Lee	有限合伙人	7.55
	合计	/	100.00

Xinyun III 普通合伙人 Xinyun Capital Management III,Ltd 的基本情况如下:

名称	Xinyun Capital Management III,Ltd
成立时间	2015 年 9 月 30 日
注册编码	304386

国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资

Xinyun Capital Management III,Ltd 的目前的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资比例 (%)
1	Yuan Xia	50.00
2	Jimmy Lee	50.00
	合计	100.00

(15) 中睿一期

名称	金石中睿一期(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2015 年 7 月 13 日
统一社会信用代码	91440300349571316F
经营范围/主营业务	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);企业管理咨询(具体项目另行申报)
主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
普通合伙人	深圳金石中睿投资管理有限公司

中睿一期目前的合伙人出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资比例 (%)
1	深圳金石中睿投资管理有限公司	普通合伙人	0.69
2	珠海百诚立合投资有限公司	有限合伙人	50.21
3	鹏华资产管理有限公司	有限合伙人	42.41
4	深圳润泽一期股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	6.68
	合计	/	100.00

中睿一期普通合伙人深圳金石中睿投资管理有限公司的基本情况如下:

名称	深圳金石中睿投资管理有限公司
成立时间	2015 年 5 月 27 日
统一社会信用代码	91440300342662215D
经营范围/主营业务	投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理、投资咨询、受托资产管理(以上不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集

	资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)；企业管理咨询(具体项目另行申报)
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

深圳金石中睿投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例(%)
1	国经泰富投资有限公司	100.00
	合计	100.00

(16) 中睿二期

名称	金石中睿二期(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2015年9月2日
统一社会信用代码	914403003500686381
经营范围/主营业务	投资兴办实业(具体项目另行申报)；投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营)；受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目)；企业管理咨询
主要经营场所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
普通合伙人	深圳金石中睿投资管理有限公司

中睿二期目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资比例(%)
1	深圳金石中睿投资管理有限公司	普通合伙人	3.33
2	珠海百诚立合投资有限公司	有限合伙人	50.44
3	鹏华资产管理有限公司	有限合伙人	40.48
4	深圳润泽二期股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5.75
	合计	/	100.00

中睿二期普通合伙人深圳金石中睿投资管理有限公司的基本信息及股权结构详见本题3、新股东情况(2)合伙企业股东15)中睿一期部分。

(17) 泰瑞嘉德

名称	新疆泰瑞嘉德股权投资合伙企业(有限合伙)
成立时间	2016年7月27日
统一社会信用代码	91650100MA776KUP9T

经营范围/主营业务	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份
主要经营场所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 258 号数码港大厦 2015-846 号
普通合伙人	厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）

泰瑞嘉德目前的合伙人出资情况如下：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例（%）
1	厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.33
2	苏州市华田宇股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	99.67
	合计	/	100.00

泰瑞嘉德普通合伙人厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016 年 9 月 13 日
统一社会信用代码	91350203MA2XNMUW9G
经营范围/主营业务	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）
主要经营场所	厦门市同安区新民镇人民政府文化活动综合楼 118 号

厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	厦门英华资本管理有限公司	普通合伙人	60.00
2	张淑荣	有限合伙人	40.00
	合计	/	100.00

（18）华天宇投资

名称	厦门市华天宇股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016 年 9 月 18 日
统一社会信用代码	91350200MA2XNNUC8Q
经营范围/主营业务	依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务
主要经营场所	厦门市同安区洪塘镇洪塘里 228 号 141 室
普通合伙人	厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）

华天宇投资目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.27
2	厦门珑耀投资有限公司	有限合伙人	74.64
3	深圳盛屯集团有限公司	有限合伙人	15.64
4	周由	有限合伙人	9.45
	合计	/	100.00

华天宇投资普通合伙人厦门华英汇股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息及股权结构详见本题 3、新股东情况（2）合伙企业股东 17）泰瑞嘉德部分。

（19）上海华伊

名称	上海华伊投资中心（有限合伙）
成立时间	2016 年 1 月 13 日
统一社会信用代码	91310000MA1K36A468
经营范围/主营业务	实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
普通合伙人	一村资本有限公司

上海华伊目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	一村资本有限公司	普通合伙人	29.01
2	一村资产管理有限公司	有限合伙人	41.67
3	昆山晗村投资中心（有限合伙）	有限合伙人	6.58
4	合肥海鲲佐顺投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6.49
5	苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5.81
6	嘉兴君镐投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4.07
7	克拉玛依天诺盛天股权投资管理有限合伙企业	有限合伙人	3.82
8	宁波如厚投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1.49
9	赵盛	有限合伙人	0.42
10	仇虹豪	有限合伙人	0.33
11	孙建	有限合伙人	0.17
12	常惠华	有限合伙人	0.17

	合计	/	100.00
--	----	---	--------

上海华伊普通合伙人一村资本有限公司的基本情况如下：

名称	一村资本有限公司
成立时间	2015 年 8 月 18 日
统一社会信用代码	91310115351124697B
经营范围/主营业务	投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询
住所	浦东新区南汇新城镇环湖西二路 588 号 203-1 室

一村资本有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	江苏华西村股份有限公司	89.29
2	安徽交控产业发展基金有限公司	10.71
	合计	100.00

（20）SVIC No. 28 Investment

名称	SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P.
成立时间	2015 年 2 月 5 日
注册编号	214-80-12280
国家/地区	韩国
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	Samsung Venture Investment Co., Ltd.

SVIC No. 28 Investment 目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	Samsung Venture Investment Co., Ltd.	普通合伙人	1.00
2	Samsung Electronics Co., Ltd.	有限合伙人	99.00
	合计	/	100.00

SVIC No. 28 Investment 普通合伙人 Samsung Venture Investment Co., Ltd. 的基本情况如下：

名称	Samsung Venture Investment Co., Ltd.
成立时间	1999 年 10 月 8 日

注册编码	110111-1785538
国家/地区	韩国
经营范围/主营业务	投资

根据 SVIC No. 28 Investment 的资料及其确认, Samsung Venture Investment Co., Ltd.目前的股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	出资比例 (%)
1	Samsung Electronics Co., Ltd.	16.33
2	Samsung SDI Co., Ltd.	16.33
3	Samsung C&T Corporation	16.67
4	Samsung Securities Co., Ltd.	16.67
5	Samsung Electro-mechanics Co., Ltd.	17.00
6	Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	17.00
	合计	100.00

(21) 宁波信远

名称	宁波信远融科股权投资基金合伙企业(有限合伙)
成立时间	2015 年 11 月 12 日
统一社会信用代码	91330201MA2815EM6L
经营范围/主营业务	股权投资及其相关咨询服务
主要经营场所	宁波保税区鸿海商贸楼 628-3 室
普通合伙人	北京朗玛峰创业投资管理有限公司、北京信远资本管理有限公司

宁波信远目前的合伙人出资情况如下:

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例 (%)
1	北京朗玛峰创业投资管理有限公司	普通合伙人	1.08
2	北京信远资本管理有限公司	普通合伙人	0.08
3	北京朗玛永祥投资管理股份公司	有限合伙人	98.84
	合计	/	100.00

宁波信远普通合伙人北京朗玛峰创业投资管理有限公司、北京信远资本管理有限公司的基本情况如下:

A. 北京朗玛峰创业投资管理有限公司

名称	北京朗玛峰创业投资管理有限公司
----	-----------------

成立时间	2010 年 7 月 19 日
统一社会信用代码	91110108558526079N
经营范围/主营业务	投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计
住所	北京市海淀区北四环西路 58 号 18 层 1818

北京朗玛峰创业投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	肖建聪	99.80
2	梁显宏	0.20
	合计	100.00

B. 北京信远资本管理有限公司

名称	北京信远资本管理有限公司
成立时间	2015 年 9 月 9 日
统一社会信用代码	91110105357934009T
经营范围/主营业务	资产管理；投资管理
住所	北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 8 层 1 座 902

北京信远资本管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	北京信远业隆投资管理有限公司	50.00
2	北京信远置业有限公司	30.00
3	上海厚稳企业管理咨询中心（有限合伙）	20.00
	合计	100.00

（22）杭州调露

名称	杭州调露投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2016 年 1 月 7 日
统一社会信用代码	91330102MA27WNUB5K
经营范围/主营业务	服务；投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
主要经营场所	浙江省杭州市上城区白云路 26 号 238 室-35 号
普通合伙人	杭州艮盛投资管理合伙企业（有限合伙）

杭州调露目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	杭州艮盛投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	0.01
2	北京华富开元财务咨询有限公司	有限合伙人	83.05
3	杭州金研学而投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	16.94
	合计	/	100.00

杭州调露普通合伙人杭州艮盛投资管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

名称	杭州艮盛投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 3 月 18 日
统一社会信用代码	913301023281237842
经营范围/主营业务	服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
主要经营场所	上城区凤山新村 217 号 145 室

杭州艮盛投资管理合伙企业（有限合伙）的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	杭州皇建投资管理有限公司	普通合伙人	20.00
2	毛国华	有限合伙人	80.00
	合计	/	100.00

（23）上海君弼

名称	上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）
成立时间	2015 年 9 月 15 日
统一社会信用代码	91310000350856933E
经营范围/主营业务	投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让，计算机软件的开发、销售，从事货物及技术的进出口业务
主要经营场所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层
普通合伙人	上海君桐股权投资管理有限公司

上海君弼目前的合伙人出资情况如下：

序号	股东名称	合伙人类型	出资比例
----	------	-------	------

			(%)
1	上海君桐股权投资管理有限公司	普通合伙人	0.47
2	青岛汇创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	16.01
3	文轩恒信（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	19.65
4	西藏文轩创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	39.30
5	嘉兴云初投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	24.57
	合计	/	100.00

上海君弼普通合伙人上海君桐股权投资管理有限公司的基本情况如下：

名称	上海君桐股权投资管理有限公司
成立时间	2015 年 5 月 26 日
统一社会信用代码	913100003423649638
经营范围/主营业务	股权投资管理，资产管理
住所	中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2029 室

上海君桐股权投资管理有限公司目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	闻威	78.00
2	翁逸卿	12.00
3	杨博	10.00
	合计	100.00

（24）TransLink

名称	TransLink Capital Partners I, L.P.
成立时间	2007 年 4 月 27 日
注册编号	19936
国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	TransLink Management I, L.L.C

TransLink 目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	TransLink Management I, L.L.C.	普通合伙人	1.57
2	Fairview Capstone Partners LP	有限合伙人	15.57

3	Ant Capital Partners Co., Ltd.	有限合伙人	10.38
4	UMC Capital	有限合伙人	10.38
5	KT Corporation	有限合伙人	10.38
6	NTT Investment Partners Fund, L.P.	有限合伙人	8.31
7	SK Telecom	有限合伙人	6.23
8	Industry Ventures Secondary VII-A, LP	有限合伙人	6.23
9	Hyosung Corporation	有限合伙人	4.15
10	Moon Limited	有限合伙人	4.15
11	Amberbrook VII LP	有限合伙人	2.08
12	NTT Leasing Capital (U.S.A.), Inc.	有限合伙人	2.08
13	The Lin Family	有限合伙人	2.08
14	Tong Yang Life Insurance Co.	有限合伙人	2.08
15	Jung-Hung Yang	有限合伙人	2.08
16	Yuanta Securities Korea Co., Ltd	有限合伙人	2.08
17	SVB Strategic Investors Fund IV, L.P.	有限合伙人	2.08
18	Plaza Create Co. Ltd.	有限合伙人	1.04
19	Real Bless International Ltd.	有限合伙人	1.04
20	Perfect Apex Limited	有限合伙人	1.04
21	Jack Huang	有限合伙人	0.83
22	Hong Chen and Lynn Liu	有限合伙人	0.52
23	Ching-Chien Yu	有限合伙人	0.42
24	Ki Sub Lee	有限合伙人	0.42
25	Pei Yun Lee	有限合伙人	0.42
26	Tai kuai Lap and Chao Iong Wa	有限合伙人	0.42
27	Nelson Haung	有限合伙人	0.31
28	David Chao and Amanda M. Minami Revocable	有限合伙人	0.21
29	The Park Family	有限合伙人	0.21
30	James Huang	有限合伙人	0.21
31	Leechung Yiu	有限合伙人	0.21
32	Nahm Family	有限合伙人	0.21
33	Young K. Sohn, TTEE Marcy Yanta Sohn	有限合伙人	0.21

34	Kihyun Joo	有限合伙人	0.21
35	Curtis Ling	有限合伙人	0.10
36	Koichi Narasaki	有限合伙人	0.06
37	Koji Osawa	有限合伙人	0.04
	合计	/	100.00

TransLink 普通合伙人 TransLink Management I, L.L.C.的基本情况如下：

名称	TransLink Management I, L.L.C.
成立时间	2006 年 12 月 15 日
注册编码	4269132
国家/地区	美国
经营范围/主营业务	投资

TransLink Management I, L.L.C.目前的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资比例（%）
1	Jae Eum	19.80
2	Toshiya Otani	19.80
3	Jung Kung Yang	19.80
4	ANT Capital Partners Co., Ltd.	19.80
5	Sung Park	9.90
6	Soundpipe Korea (SPKorea)	9.90
7	CIQ Partners, LLC	1.00
	合计	100.00

（25）BICI

名称	Beijing Integrated Circuit Industry
成立时间	2014 年 12 月 18 日
注册编号	80560
国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资
普通合伙人	Hua-Captial Cayman, L.P.

BICI 目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
----	----------	-------	---------

1	Hua-Captial Cayman, L.P.	普通合伙人	1.00
2	SVIC No. 21 New Technology Business Investment L.L.P.	有限合伙人	61.00
3	Qorvo International Pte. Ltd.	有限合伙人	19.00
4	Gaintech Co., Limited	有限合伙人	19.00
	合计	/	100.00

BICI 普通合伙人 Hua-Captial Cayman, L.P.的基本情况如下：

名称	Hua-Captial Cayman, L.P.
成立时间	2014 年 12 月 18 日
注册编码	80513
国家/地区	开曼群岛
经营范围/主营业务	投资

Hua-Captial Cayman, L.P.的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	合伙人类型	出资比例（%）
1	Hua-Capital International Inc.	普通合伙人	1.00
2	Sino Vision Capital Partners, L.P	有限合伙人	99.00
	合计	/	100.00

3、自然人股东

- 1) Chen Xiao，香港特别行政区永久居民，身份证号码：R60****(*)。
- 2) Lip-Bu Tan，美国国籍，护照号码：5307*****。
- 3) Ko Ping Keung，香港特别行政区永久居民，身份证号码：A96****(*)。
- 4) Xi Jin，美国国籍，护照号码：5312*****。
- 5) Shun-Wen Chang，美国国籍，护照号码：5612*****。
- 6) Qian-Shen Bai，美国国籍，护照号码：4521*****。

三、成都澜至、上海澜至、澜至半导体穿透后直接和间接股东与发行人直接或间接股东的重叠情况，报告期内与发行人存在人员、技术、业务或资金往来的具体情况，报告期各期与发行人存在重叠供应商、客户的具体情况

（一）成都澜至、上海澜至、澜至半导体穿透后直接和间接股东与发行人直接或间接股东的重叠情况

经查询工商登记相关材料，截至本问询函回复日，成都澜至、上海澜至和澜至半导体穿透后的股东均为 Montage Holding，Montage Holding 系无实际控制人的企业，其股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
普通股		
1	CEC Industrial Development Investment Inc.	21.362%
2	CEC Tongshang Company Limited	0.286%
3	Hong Kong Sunic Yun Electronic Technology Co., Limited	17.179%
4	Harmonialux Holdings Limited	14.650%
5	Xinyun Capital STB Fund, L.P.	5.845%
6	Xinyun Capital STB Fund II, L.P.	2.714%
7	Xinyun Capital Fund I, L.P.	5.845%
8	Neptune Connection Limited	12.143%
9	Hong Kong Zhizhen Investment Management Co., Limited	4.177%
10	Eight Square Capital Limited	3.417%
11	Huayi Global Holding Limited	2.840%
12	Pangea Capital Limited	2.776%
13	China Everbright Investment and Assets Management (HK) Limited	1.392%
14	Tibet Changle Investment Company Limited	1.350%
15	Xianggang Junbi Limited	0.991%
16	Shanghai JunBi Investment & Management Partnership Enterprise (Limited Partnership)	0.097%
17	Green Spark Investment Limited	0.994%
18	Chen Xiao	0.495%
19	New Speed Consultancy Co., Ltd.	0.413%
20	TransLink Capital Partners I, L.P.	0.413%
21	Hong Kong Pine Stone Capital Limited	0.292%
22	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P.	0.138%
23	A&E Investment LLC	0.066%
24	Ko Ping Keung	0.066%
25	Ian Matthew Brooks	0.026%
26	Xi Jin	0.013%
27	Shun-wen Chang	0.013%

28	Qian-shen Bai	0.007%
普通股合计		100.000%
优先股		
1	Intel Capital Corporation	90.000%
2	SVIC No. 28 New Technology Business Investment L.L.P.	10.000%
优先股合计		100.00%

截至本问询函回复日，Montage Holding 直接和间接股东与公司的直接或间接股东存在部分重叠的情形。其具体重叠情况如下：

序号	发行人股东	存在重叠的 Montage Holding 股东	备注
1	中电投控	CEC Industrial Development Investment Inc. CEC Tongshang Company Limited	均受中电投控控制
2	嘉兴芯电		
3	WLT	Harmonialux Holdings Limited	穿透后股东均存在 Tai kuai Lap 及 Chao Iong Wa
4	珠海融英		
5	上海临理	Hong Kong Sunic Yun Electronic Technology Co., Limited	受上海临理、上海临丰、上海临骥、上海临利、上海临国、临桐建发、上海临齐共同控制
6	上海临丰		
7	上海临骥		
8	上海临利		
9	上海临国		
10	临桐建发		
11	上海临齐		
12	嘉兴宏越	Xinyun Capital STB Fund, L.P. Xinyun Capital STB Fund II, L.P.	均受同一自然人控制
13	嘉兴莫奈		
14	Xinyun III		
15	Xinyun		
16	Xinyun I	Xinyun I	Montage Holding 直接股东

序号	发行人股东	存在重叠的 Montage Holding 股东	备注
17	蒋石一号	无	/
18	蒋石二号	无	/
19	蒋石三号	无	/
20	中证投资	Neptune Connection Limited	均受中信证券控制
21	中睿一期	无	/
22	中睿二期	无	/
23	珠海融扬	无	/
24	Theon Investment	无	/
25	泰瑞嘉德	无	/
26	华天宇投资	无	/
27	上海华伊	Huayi Global Holding Limited	受上海华伊控制
28	光大投资	China Everbright Investment and Assets Management (HK) Limited	受光大投资控制
29	西藏长乐	Tibet Changle Investment Company Limited ¹	Montage Holding 直接股东
30	宁波信远	无	/
31	杭州调露	无	/
32	上海君弼	Shanghai JunBi Investment & Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) ²	Montage Holding 直接股东
		Xianggang Junbi Limited	受上海君弼控制
33	Green Spark	Green Spark	Montage Holding 直接股东
34	Chen Xiao	Chen Xiao	Montage Holding 直接股东
35	New Speed	New Speed	Montage Holding 直接股东
36	TransLink	TransLink	Montage Holding 直接股东
37	Pine Stone Capital	Pine Stone Capital	Montage Holding 直接股东
38	BICI	BICI	Montage Holding 直接股东
39	Lip-Bu Tan	A&E Investment LLC	Lip-Bu Tan 间接持有 A&E

¹ 中文名称为：西藏长乐投资有限公司

² 中文名称为：上海君弼投资管理合伙企业（有限合伙）

序号	发行人股东	存在重叠的 Montage Holding 股东	备注
			Investment LLC 权益
40	Ko Ping Keung	Ko Ping Keung	Montage Holding 直接股东
41	前海珂玺	无	/
42	Xi Jin	Xi Jin	Montage Holding 直接股东
43	Shun-Wen Chang	Shun-Wen Chang	Montage Holding 直接股东
44	Qian-Shen Bai	Qian-Shen Bai	Montage Holding 直接股东
45	Intel Capital	Intel Capital	Montage Holding 优先股股东
46	SVIC No. 28 Investment	SVIC No. 28 Investment	Montage Holding 优先股股东

(二)成都澜至、上海澜至、澜至半导体报告期内与发行人存在人员、技术、业务或资金往来的具体情况

报告期内，公司同成都澜至、上海澜至、澜至半导体交易及资金往来主要包括 2017 年公司转让消费电子芯片业务资产及转租办公室，相关情况已在招股说明书“第七节 公司治理及独立性”之“八、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易”章节披露，具体情况如下：

1、转让消费电子芯片业务相关资产

2017 年，公司将消费电子芯片业务相关资产转让给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group，实现了业务层面的分离。

报告期内，公司因资产转让产生的关联交易情况如下：

单位：万元

公司名称	交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Montage Group	销售消费电子芯片产品	-	4,310.47	-
成都澜至	销售消费电子芯片产品	-	11,310.91	-
成都澜至	资产转让	-	4,983.64	-
澜至半导体	资产转让	-	850.52	-
Montage Group	资产转让	-	3,351.33	-
合计		-	24,806.87	-

2017 年因转让消费电子芯片业务资产产生的交易合计 24,806.87 万元，其中影响销售收入 15,621.38 万元，占公司总营业收入比例 12.73%，资产转让的金额为 9,185.49 万元。上述交易价格系参考转让资产的评估价值确定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、转租办公室

2017 年 7 月公司向成都澜至及其关联方转让资产前，公司与成都澜至及上海澜至存在转租办公室的情形，具体为公司与出租方签订场地租赁协议，承租办公室，并将部分办公室以平价转租给成都澜至及上海澜至。

2017 年 7 月公司完成对成都澜至及其关联方的资产转让，在原租期结束后，公司与成都澜至及新承租方澜至半导体分别与出租方重新签订租赁协议，前述转租交易终止。

报告期内，公司因转租办公室产生的关联交易情况如下：

单位：万元

公司名称	交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
上海澜至	转租办公室	-	364.52	179.62
成都澜至	转租办公室	-	38.11	-
合计		-	402.63	179.62

2016 年、2017 年公司转租办公室合计金额分别为 179.62 万元和 402.63 万元，均为平价转租，对公司的生产经营成果无重大影响。

3、往来款项余额

(1) 应收账款

单位：万元

关联方	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
成都澜至	4,218.84	6,653.84	-
Montage Group	-	941.00	-
合计	4,218.84	7,594.84	-

2017 年 12 月 31 日，公司应收成都澜至 6,653.84 万元，应收 Montage Group 941.00 万元，系公司转让消费电子芯片业务相关存货的转让款余款。

2018 年 12 月 31 日，公司应收成都澜至 4,218.84 万元，系根据相关协议尚未到期的相关资产转让余款，成都澜至已于 2019 年 4 月支付该笔款项。

(2) 其他应收款

单位：万元

关联方	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Montage Group	-	1,616.25	-
成都澜至	2,604.82	2,604.82	-
澜至半导体	-	489.52	-
上海澜至	-	-	106.40
合计	2,604.82	4,710.59	106.40

2016 年 12 月 31 日，公司其他应收上海澜至 106.40 万元，系当时同一控制下关联企业之间的转租。

2017 年 12 月 31 日，公司其他应收 Montage Group 1,616.25 万元、其他应收成都澜至 2,604.82 万元、其他应收澜至半导体 489.52 万元，系公司转让消费电子芯片业务相关资产的转让款余款。

2018 年 12 月 31 日，公司其他应收成都澜至 2,604.82 万元，系公司转让消费电子芯片业务相关资产的转让款余款。成都澜至已于 2019 年 3 月支付该笔款项。

(3) 其他应付款

单位：万元

关联方	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
上海澜至	-	-	817.72
澜至半导体	3.59	-	-
合计	3.59	-	817.72

2016 年 12 月 31 日，公司对上海澜至的其他应付款余额为 817.72 万元，主要系代收应付上海澜至员工 2014 年 Montage Group 私有化股权激励款，公司已于 2019 年初完成对相关其他应付款的支付。

除上述事项外，自 2017 年 7 月公司转让消费电子芯片业务资产后，成都澜至、上海澜至、澜至半导体与发行人不存在其他人员、技术、业务或资金往来。

（三）报告期各期成都澜至、上海澜至、澜至半导体与发行人存在重叠供应商、客户的具体情况

发行人同成都澜至仅存在个别客户和供应商重叠，自 2017 年 7 月出售消费电子芯片业务相关资产后，公司同成都澜至客户重叠情况如下：

客户名称	交易内容	2018 年度	销售占比	2017 年 8-12 月	销售占比
中电器材 ^注	销售商品	301.59	0.17%	62.07	0.15%
合计		301.59	0.17%	62.07	0.15%

注：CEAC International Limited 及其受同一控制的关联方

自 2017 年 7 月出售消费电子芯片业务相关资产后，仅有中电器材一家重叠的客户，自 2017 年 8 月至 12 月及 2018 年，公司对其销售占公司营业收入的比例分别为 0.15% 及 0.17%，占比较小，其定价系市场价格。

自 2017 年 7 月出售消费电子芯片业务相关资产后，公司同成都澜至的重叠供应商共有两家，公司与该两家供应商的交易情况如下：

供应商名称	交易内容	2018 年度	采购占比	2017 年 8-12 月	采购占比
联华电子	晶圆采购	45.46	0.08%	23.21	0.10%
矽品科技	封测采购	1,343.95	2.28%	672.15	3.03%
合计		1,389.41	2.36%	695.36	3.13%

自 2017 年 7 月出售消费电子芯片业务相关资产后，仅有联华电子和矽品科技两家重叠的供应商，自 2017 年 8 月至 12 月及 2018 年，公司向其采购占公司采购总额的比例合计分别为 3.13% 及 2.36%，占比较小，其定价系市场价格。

公司及成都澜至等主体同上述重叠客户与供应商均独立合作，由于双方产品和技术工艺上具有明显差异，其销售与采购均可严格划分，并根据市场化定价，不存在代垫成本费用情形，且相关销售采购占比较小，对公司经营不构成重大影响。

四、对津逮[®]服务器平台业务面临的不确定性风险、DDR5 推出可能给发行人带来的影响等作重大事项提示

公司已在招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示（七）DDR5 技术和产品推出的不确定性风险、（八）津逮[®]服务器平台业务面临的不确定性风险”中补充披露如下：

（七）DDR5 技术和产品推出的不确定性风险

公司经过多年研发，已拥有成熟的内存接口芯片产品系列，并形成一定竞争优势。但 DDR5 新技术和新产品的研发仍存在一定不确定性，包括行业标准技术规格书的修订，内存接口芯片电路设计的高复杂度，新一代 DDR5 内存颗粒以及中央处理器等上下游合作厂商的产品研发进度等，都会影响澜起科技新一代 DDR5 内存接口芯片的研发和量产进度。预计在未来几年，DDR5 相关技术将逐步取代 DDR4，在内存接口芯片的技术迭代过程中，如果公司在 DDR5 的相关技术开发和应用上不能保持领先地位，或者某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，可能对公司的市场竞争力带来不利影响。

（八）津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险

1、相关业务面临不确定性风险。津逮®服务器平台项目具有高投入、高风险和高收益的特点。服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分，也是公司未来布局云计算、大数据、人工智能等新兴领域的重要抓手。但津逮®服务器平台技术壁垒高，独创性强，需要公司投入大量资金、人力和时间成本，且项目实施的过程中面临着技术替代、政策环境变化、市场环境变化等诸多不确定因素。尽管公司已于 2018 年底成功推出了第一代津逮®服务器平台产品，但目前还处于市场推广阶段，不是公司报告期内的主要收入来源。未来不排除因技术、市场、政策等因素的影响而导致该项业务的实际开展不及预期，从而对经营情况造成一定不利影响。

2、津逮®服务器平台业务与相关合作方的具体合作模式。津逮®服务器 CPU 是公司与清华大学、Intel 联合研发的，其产品所有权及品牌归属为澜起科技。公司已就津逮®服务器 CPU 所涉及的独立研发核心技术申请专利和集成电路布图设计专有权。在本产品上，通用 CPU 内核芯片由 Intel 提供，可重构计算处理器（RCP）的算法由清华大学提供，公司完成整体模块及其他部分芯片设计，并委托第三方进行芯片制造、封装和测试。

3、募投项目实施后公司新增关联交易对公司的影响。公司向 Intel 相关主体采购其通用 CPU 内核芯片，是基于前述背景的正常业务合作与采购。与 Intel 已发生的交易均经过关联交易决策程序，定价公允。募投项目津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目实施后，公司将根据届时的市场情况确定与 Intel 关联交易

的规模。未来将根据相关规定履行必要的审核及对外披露程序。募投项目的实施不会造成公司对 Intel 公司的重大依赖，Intel 作为公司股东无法控制公司，不会对公司的独立性产生影响。

4、Intel Capital 投资公司主要系看好公司未来盈利前景及技术水平，有意进一步加深合作，同时获取投资回报，其定价相比同期同行业一级市场可比投资估值（动态市盈率），不存在重大差异，相关定价公允。

五、提供全体股东关于确认 2019 年第一次临时股东大会决议效力的书面意见。

公司全体股东已出具关于 2019 年第一次临时股东大会决议效力的书面确认，全体股东确认对发行人 2019 年第一次临时股东大会的通知、召集和召开及表决结果无异议，确认发行人 2019 年第一次临时股东大会决议有效，确认放弃《公司法》第二十二条第二款“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”规定的撤销权，不会向相关部门和机关申请撤销发行人 2019 年第一次临时股东大会的决议。

六、请发行人、保荐机构及相关证券服务机构全面核查是否存在其他未回复或回复存在问题的情况，认真评估自身申请文件的制作质量并发表明确意见。

（一）补充披露首轮问询函问题 16 中“正在从事的研发项目”的相应人员数量

首轮问询函问题 16 要求披露“正在从事的研发项目、所处阶段及进展情况、相应人员、经费投入、拟达到的目标”，公司考虑到能让投资者了解到在研项目达到最终研发目标所需的研发人员数量，披露的数据不是指公司现有的对应人员数量，回复没有满足要求。

“正在从事的研发项目”的相应人员数量情况详见本问询函问题 12 的回复。

（二）补充披露首轮问询函问题 24 中关于报告期内成品的不良率情况

公司主要产品内存接口芯片的产品良率在报告期内始终高于 98.5%。

经核查，除上述情况及本问询函补充披露的内容外，不存在其他未回复或回复存在问题的情况。

公司已对申请文件中出现的上述问题进行了更正，后续将进一步提升申请文

件质量。

1.2 保荐机构和发行人律师的核查过程和核查结论

1、保荐机构和发行人律师已就公司改制时涉及的股东所得税事宜，与有关部门进行了确认，并查阅了相关法律、法规及规范性文件的要求，获取了发行人各股东的税务备案表、股东出具的有关纳税的声明；

2、查阅了申报前一年内发行人通过增资或股权转让引入的新股东的基本情况；

3、查阅了成都澜至、上海澜至和澜至半导体穿透后的股东情况，Montage Holding的股东名册并查阅了直接和间接股东情况；查阅了报告期内公司同成都澜至、上海澜至、澜至半导体交易及资金往来情况；

4、查阅了公司全体股东出具的关于2019年第一次临时股东大会决议效力的书面确认；

5、获得并审阅了公司主要产品良率情况的说明；全面核查首轮问询答复中是否存在其他未回复或回复存在问题的情况，并完善申请文件制作质量。

经核查，保荐机构和发行人律师认为：

1、发行人改制、历次股权转让时，除无需办理税务缴纳的股东外，发行人各股东已按照或承诺将按照相关税务法律法规的规定办理了纳税申报。

2、报告期内，公司同成都澜至、上海澜至、澜至半导体交易及资金往来存在合理商业背景，对发行人经营不构成重大不利影响。

3、全体股东已确认对发行人2019年第一次临时股东大会的通知、召集和召开及表决结果无异议，发行人2019年第一次临时股东大会决议有效。

4、经核查，各中介机构已对申请文件中出现的上述问题进行更正，并对申请文件进行全面复核。各中介机构根据科创板相关法律法规的规定，秉承勤勉尽责原则对发行人进行了全面核查。后续各中介机构将继续提升申请文件质量。

1.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、公司股东及实

际控制人的基本情况”之“（一）持有 5%以上股份的股东基本情况”和“十、发行人股本情况”之“（四）申报前一年内发行人通过增资或股权转让引入的新股东基本情况”中补充披露新股东的相关情况。

发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（七）DDR5 技术和产品推出的不确定性风险”、“（八）津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险”中补充披露：

四、特别风险提示

.....

（七）DDR5 技术和产品推出的不确定性风险

公司经过多年研发，已拥有成熟的内存接口芯片产品系列，并形成一定竞争优势。但 DDR5 新技术和新产品的研发仍存在一定不确定性，包括行业标准技术规格书的修订，内存接口芯片电路设计的高复杂度，新一代 DDR5 内存颗粒以及中央处理器等上下游合作厂商的产品研发进度等，都会影响澜起科技新一代 DDR5 内存接口芯片的研发和量产进度。预计在未来几年，DDR5 相关技术将逐步取代 DDR4，在内存接口芯片的技术迭代过程中，如果公司在 DDR5 的相关技术开发和应用上不能保持领先地位，或者某项新技术、新产品的应用导致公司技术和产品被替代，可能对公司的市场竞争力带来不利影响。

（八）津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险

1、相关业务面临不确定性风险。津逮®服务器平台项目具有高投入、高风险和高收益的特点。服务器市场既是未来数据中心市场的重要组成部分，也是公司未来布局云计算、大数据、人工智能等新兴领域的重要抓手。但津逮®服务器平台技术壁垒高，独创性强，需要公司投入大量资金、人力和时间成本，且项目实施的过程中面临着技术替代、政策环境变化、市场环境变化等诸多不确定因素。尽管公司已于 2018 年底成功推出了第一代津逮®服务器平台产品，但目前还处于市场推广阶段，不是公司报告期内的主要收入来源。未来不排除因技术、市场、政策等因素的影响而导致该项业务的实际开展不及预期，从而对经营情况造成一定不利影响。

2、津逮[®]服务器平台业务与相关合作方的具体合作模式。津逮[®]服务器 CPU 是公司与清华大学、Intel 联合研发的，其产品所有权及品牌归属为澜起科技。公司已就津逮[®]服务器 CPU 所涉及的独立研发核心技术申请专利和集成电路布图设计专有权。在本产品上，通用 CPU 内核芯片由 Intel 提供，可重构计算处理器（RCP）的算法由清华大学提供，公司完成整体模块及其他部分芯片设计，并委托第三方进行芯片制造、封装和测试。

3、募投项目实施后公司新增关联交易对公司的影响。公司向 Intel 相关主体采购其通用 CPU 内核芯片，是基于前述背景的正常业务合作与采购。与 Intel 已发生的交易均经过关联交易决策程序，定价公允。募投项目津逮[®]服务器 CPU 及其平台技术升级项目实施后，公司将根据届时的市场情况确定与 Intel 关联交易的规模。未来将根据相关规定履行必要的审核及对外披露程序。募投项目的实施不会造成公司对 Intel 公司的重大依赖，Intel 作为公司股东无法控制公司，不会对公司的独立性产生影响。

4、Intel Capital 投资公司主要系看好公司未来盈利前景及技术水平，有意进一步加深合作，同时获取投资回报，其定价相比同期同行业一级市场可比投资估值（动态市盈率），不存在重大差异，相关定价公允。

2.关于增资协议的约定

根据回复材料，Montage Holding 向 Intel Capital、SVIC No.28 Investment（以下简称上述两股东）发行 A 类优先股时，就 A 类优先股股东的相关权利义务进行了规定，主要包括一票否决权、要求 Montage Holding 回购股票等事项。2018 年 12 月，上述两股东对公司进行增资时，各方就 Intel Capital 在成为公司股东后的相关保护性事项、上述两股东的回购权事项进行了约定，相关协议在公司正式提交上市申请文件时终止。请发行人说明：（1）引入上述两股东的背景，相关投资协议的主要内容，包括但不限于签署主体、签署时间、有效期、上述两股东作为股东享有的权力、义务、退出机制及参与发行人重大事项决策方面的约定，或享有与公司其他股东差异化的其他安排；（2）上述两股东是否在股东层面、治理层面和技术层面对发行人施加重大影响，若有，请详细说明对发行人日常经营和重大决策的影响程度，如发行人开展技术研究领域和方向，选择行业内的合作伙伴等；（3）前后两次协议中，上述两股东享有的权利、义务是否存在重大差异，是否行使过一票否决权，是否对发行人的重大事项决策及控制权存在重要影响力；（4）上述两股东是否要求发行人等回购其股份或存在其他诉求，与发行人、发行人的主要股东及董事、监事、高管是否存在纠纷或潜在纠纷；（5）上述协议约定是否彻底解除，是否为附条件的终止，是否实为中止；（6）上述协议约定是否可能导致公司控制权变化，是否与市值挂钩，是否存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

请发行人模拟测算上述两股东增资入股价格与同期公允价值价差对公司经营业绩的影响，并在“发行人基本情况”之“发行人股本形成及变化情况”中予以补充披露。请发行人提供上述各协议约定及终止协议的文本。

请保荐机构、发行人律师进行核查，并发表明确意见。

2.1 发行人说明

一、引入上述两股东的背景，相关投资协议的主要内容，包括但不限于签署主体、签署时间、有效期、上述两股东作为股东享有的权力、义务、退出机制及参与发行人重大事项决策方面的约定，或享有与公司其他股东差异化的其他安排；

1、2016 年，Intel Capital、SVIC No.28 Investment 成为 Montage Holding 优先股股东

(1) 引入上述两股东的背景

Montage Holding 于 2016 年 4 月 29 日向 Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 分别发行 A 类优先股 4,067,330 股及 451,926 股。

自 2006 年及 2012 年以来，英特尔、三星电子分别与公司建立了稳定的业务合作关系。经过长期观察和尽职调查，英特尔旗下的 Intel Capital、三星电子间接控制的 SVIC No. 28 Investment 看好 Montage Holding 的发展前景，遂决定与 Montage Holding 就相关融资展开谈判，并于 2016 年与 Montage Holding 签署相关协议。

(2) 协议的主要内容

2016 年 2 月 5 日，Montage Holding 及其 9 家全资子公司与 Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 共同签署《MONTAGE TECHNOLOGY GLOBAL HOLDINGS, LTD. SERIES A PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“优先股认购协议”）。

优先股认购协议约定在认购方获得满意的尽职调查结果及各方陈述与保证真实等条件下，Montage Holding 以每股 44.255 美元的价格向 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 发行 A 类优先股 4,067,330 股及 451,926 股，并对各方的陈述与保证事项及违约责任进行了详细的约定。

优先股认购协议中有关各方陈述、保证及保密事项的约定在交割日后持续有效。

(3) Montage Holding 章程的主要内容

优先股认购协议中未对优先股股东的特殊权利义务作出详细约定，2016 年 4 月 29 日，Montage Holding 股东通过的《THE COMPANIES LAW CAP. 22 (2013 REVISION) COMPANY LIMITED BY SHARES THIRD AMENDED AND RESTATED MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF MONTAGE TECHNOLOGY GLOBAL HOLDINGS, LTD.》（以下简称“Montage Holding 章程”）正式生效。Montage Holding 章程中对于 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 作为 A 类优先股股东的相关权利义务进行了规定，其主要内容包括为：

A. 优先股股东可以依据章程的约定享受优先分红的权利，Montage Holding

如进行分红，应当优先向A类优先股股东支付相当于其投资价格年化8%利息的收益；

B. 优先股股东有权按照约定的价格选择转为普通股；

C. 如Montage Holding新发行的普通股价格低于优先股价格，优先股股东有权要求调整其转股价格；

D. 清算时优先向A类优先股股东进行分配。

Montage Holding 章程中对于 Intel Capital 作为 A 类优先股股东的特殊权利义务进行了规定，其主要内容包括为：

A. 在满足协议约定的条件下，Intel Capital 有权要求 Montage Holding 按原价回购其所持有的全部优先股股票并支付相应股息；

B. Intel Capital 就章程等文件中涉及其作为股东重要利益的事项享有一票否决权，如修改章程中有关优先股股东权利的事项、增加或减少优先股数量、修改董事数量及选举方式、公司清盘、以任何方式造成公司控制权变更、与公司股东及董事等进行关联交易。

自 2018 年 4 月公司拆除境外架构后，Montage Holding 已不再是公司股东，上述约定对公司无影响。

2、2018 年，Intel Capital、SVIC No.28 Investment 通过增资成为公司的股东

（1）引入股东的背景

2018 年上半年，公司拆除境外架构时，因 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 是通过增资方式持有 Montage Holding 的优先股股东，不同于普通股股东，所以 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 与公司协商以增资的方式成为公司股东。后经协商谈判后，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 于 2018 年 12 月对公司增资，成为公司股东。

（2）增资协议的主要内容

2018 年 11 月 23 日，Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 与公司签署增资协议（以下简称“增资协议”）。

增资协议约定在满足交割条件下，Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 共计投资 194,527.622 美元认购公司新增注册资本 112,981,400 元。增资后 Intel Capital 持股比例为 10.000%，SVIC No. 28 Investment 持股比例为 1.111%。

增资协议对过渡期（协议签署日至正式交割日期间）Intel Capital 享有的知情权、指派董事会观察员事项及保护性条款进行了约定，还就交割日后 Intel Capital 享有的相关保护性事项进行了约定，其主要内容包括：

A.财务信息知情权；

B.指派董事会观察员事项；

C.其他保护性事项，即未经 Intel Capital 同意，公司不得从事如下行为：a. 导致公司解散或清算的行为或为债权人利益提起破产、破产管理等程序；b.导致公司控制权变更的行为或全部或实质资产的出售、抵押或转让的行为；c. 根据公司章程需要经公司董事会同意的关联交易行为；d.对公司经营范围进行变更且该变更将对公司履行商业协议产生不利影响；

根据增资协议的约定，上述相关权利在公司完成上市之日终止。

（3）股东协议的主要内容

2018 年 11 月 23 日，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 与发行人及包括中电投控在内的发行人 13 名关键股东签署股东协议（以下简称“股东协议”）。

各方在股东协议中就公司治理、股份转让限制、优先购买权、共同出售权及其他方面的权利进行约定，各方还在违约补偿条款中就 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 的回购权事项进行了约定，其主要内容如下：

Intel Capital 于发生下述（i）至（iii）任一情形时、SVIC No. 28 Investment 于发生下述（i）、（iv）与（v）任一情形时均有权在中国法律法规和实践允许的最大范围内，要求发行人回购其届时持有的全部或部分公司股份：

- i. 至2021年5月6日公司仍未实现上市的情况下，在该日期后的任何期间均可行使回售权；
- ii. 于Intel Capital收到信息证明公司或公司关联方作出欺诈性、不适宜或不合法的支付，或采取其它违反任何适用的反贿赂及反腐败相关法令的行动，或违反任何出口管制法令；
- iii. 任一公司或其关联方违反商业协议且Intel Capital遵守商业协议；
- iv. 于SVIC No. 28 Investment收到信息证明（由SVIC No. 28 Investment合理判断），任一公司或公司关联方作出欺诈性、不适宜或不合法的支付，

或采取其它违反任何适用的反贿赂及反腐败相关法令的行动，或违反任何出口管制法令；

v. Intel Capital根据本条决定行使回售权。

根据股东协议的约定及协议签署各方的确认，上述股东协议已在发行人向相关审批部门正式提交上市申请文件时终止。

二、上述两股东是否在股东层面、治理层面和技术层面对发行人施加重大影响，若有，请详细说明对发行人日常经营和重大决策的影响程度，如发行人开展技术研究领域和方向，选择行业内的合作伙伴等

1、Intel Capital 作为 Montage Holding 或公司股东，其享有的包括重大事项一票否决权及回购权等权利为保护其自身的投资利益的保护性权利，无法对 Montage Holding 或公司的日常经营和重大决策施加重大影响。

SVIC No. 28 Investment 作为 Montage Holding 或公司股东，享有的少量特殊权利仅为保护其自身的投资利益的保护性权利，无法对 Montage Holding 或公司的日常经营和重大决策施加重大影响。

2、除公司董事 Brent Alexander Young 在 Intel Capital 实际控制人及关联方中任职外，无其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 存在关联关系。公司已建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，《公司章程》对股东及董事表决权等事项无特殊约定安排。公司董事会现有 11 名董事组成（其中包括 4 名独立董事），Brent Alexander Young 无法单独对董事会施加重大影响。

3、公司自 2004 年成立以来，其发明专利等核心技术均为自主研发获得，并通过自有技术与竞争对手进行竞争，其研发人员及技术均保持独立。公司依据自身研发团队技术积累及对自身产品特点、发展方向设定产品研发路线并选择合作伙伴。公司目前主要收入及利润来源为内存接口芯片，是公司自主研发的产品。同时，公司就津逮®服务器 CPU 与清华大学、Intel 合作，在该产品上，Intel 仅为公司的合作伙伴和供应商，公司不存在对 Intel 的重大技术依赖。三星电子作为公司的主要客户，与公司之间为正常的业务往来关系，且在报告期内公司对三星电子的销售金额占比未超过 30%，不存在对三星电子的重大依赖。

综上，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 均无法对公司的日常经营和重

大决策产生重大影响，且对公司开展技术研究领域和方向、选择行业内的合作伙伴无决定权。因此 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 在股东层面、治理层面和技术层面无法对公司施加重大影响。

三、前后两次协议中，上述两股东享有的权利、义务是否存在重大差异，是否行使过一票否决权，是否对发行人的重大事项决策及控制权存在重要影响力

1、前后两次协议的具体内容，详见本题第（一）部分之回复。

2、因开曼群岛与中国在公司法等相关领域的规定有所不同，2016 年 Montage Holding 的优先股认购协议及章程与 2018 年公司的增资协议及股东协议相比，Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 在 Montage Holding 和在公司所享有的权利存在一定差异，具体如下：

首先，上述两股东在 Montage Holding 享有的如下优先权利并未延续至公司层面：（1）优先股股东可以依据章程的约定享受优先分红的权利，Montage Holding 如进行分红，应当优先向 A 类优先股股东支付相当于其投资价格年化 8% 利息的收益。（2）优先股股东有权按照约定的价格选择转为普通股。（3）如 Montage Holding 新发行的普通股价格低于优先股价格，优先股股东有权要求调整其转股价格。（4）清算时优先向 A 类优先股股东进行分配。

其次，关于 Intel Capital 在 Montage Holding 享有的部分重大事项一票否决权等特殊权利，增资协议和股东协议对相关权利的具体触发条件等内容进行了缩减。

Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 在成为 Montage Holding 或公司的股东后，SVIC No. 28 Investment 未享有一票否决权，Intel Capital 未行使过一票否决权。Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 作为股东享有的特殊权利为保护其自身的投资利益的保护性权利，对 Montage Holding 或公司的重大事项决策及控制权不存在重大影响。

四、上述两股东是否要求发行人等回购其股份或存在其他诉求，与发行人、发行人的主要股东及董事、监事、高管是否存在纠纷或潜在纠纷

根据 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 的书面确认，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 未向公司提出回购其持有的股份或其他类似诉求，股东协议已在公司向相关审批部门正式提交上市申请文件终止，其与公司、公司的主要股东

及董事、监事、高级管理人员之间不存在纠纷或潜在纠纷。

五、上述协议约定是否彻底解除，是否为附条件的终止，是否实为中止

增资协议就 Intel Capital 在成为公司股东后的相关保护性事项进行了约定，根据增资协议的约定，相关权利在公司完成上市之日终止，并未附加任何其他条件，并非中止。

根据股东协议的约定，该协议于公司向相关审批部门正式提交上市申请文件时终止。根据股东协议签署各方出具的《股东协议终止确认函》：（1）股东协议在公司向上海证券交易所递交首次公开发行股票并在科创板上市申请之日彻底终止，不因任何条件而自动恢复；（2）为免歧义，如公司上市申请被撤回、失效、否决时，股东协议不自动恢复效力。因此，股东协议已彻底终止，并未附加任何其他条件，并非中止。

六、上述协议约定是否可能导致公司控制权变化，是否与市值挂钩，是否存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形

Intel Capital 持有公司 10.000% 股份，SVIC No. 28 Investment 持有公司 1.111% 股份。SVIC No. 28 Investment 作为股东，其享有的回购权等权利仅为保护其自身投资利益的消极性保护性权利，无法对公司的日常经营和重大决策施加重大影响；Intel Capital 作为公司股东，其享有的包括部分重大事项一票否决权及回购权等权利为保护其自身的投资利益的消极性保护性权利，无法对公司的日常经营和重大决策施加重大影响。

除公司董事 Brent Alexander Young 在 Intel Capital 实际控制人及关联方中任职外，无其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 存在关联关系，《公司章程》对股东及董事表决权等事项无特殊约定安排，公司董事会现有 11 名董事组成（其中包括 4 名独立董事），Brent Alexander Young 无法单独对董事会施加重大影响。

综上，Intel Capital 与 SVIC No. 28 Investment 无法对公司的日常经营决策产生支配性的影响，相关协议约定不会导致公司控制权变化。

相关协议并未与市值挂钩，增资协议涉及 Intel Capital 的保护性权利在公司

完成上市之日终止，股东协议已在公司向相关审批部门正式提交上市申请文件时终止，不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

七、请发行人模拟测算上述两股东增资入股价格与同期公允价值价差对公司经营业绩的影响，并在“发行人基本情况”之“发行人股本形成及变化情况”中予以补充披露

详见本问询回复第三题的相关答复。根据行业可比交易，在上述两股东增资公司时，公司可参考的市盈率估值区间在15.78-18.57之间，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment增资对应市盈率17.18在上述区间内，定价公允，对公司经营业绩不产生影响。

2.2 保荐机构和发行人律师的核查过程和核查结论

保荐机构及发行人律师获取并审阅了 Intel Capital、SVIC No.28 Investment 与 Montage Holding 签署的优先股认购协议、Montage Holding 公司章程；获取并审阅了 Intel Capital、SVIC No.28 Investment 与发行人及相关股东签署的增资协议及股东协议；获取并审阅了 Intel Capital、SVIC No.28 Investment、发行人及相关股东有关不存在纠纷、协议终止等事项的确认函。

经核查，保荐机构及发行人律师认为：

1、上述两股东在股东层面、治理层面和技术层面无法对发行人施加重大影响；

2、Intel Capital 及 SVIC No. 28 Investment 在成为 Montage Holding 或公司的股东后，SVIC No. 28 Investment 并未享有一票否决权，Intel Capital 从未行使过一票否决权。Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 作为股东享有的特殊权利为保护其自身的投资利益的保护性权利，对 Montage Holding 或公司的重大事项决策及控制权不存在重大影响力；

3、上述两股东未向发行人要求回购其股份或其他类似诉求，其与发行人、发行人的主要股东及董事、监事、高管不存在纠纷或潜在纠纷；

4、发行人增资协议涉及 Intel Capital 的保护性权利在发行人完成上市之日终止；发行人股东协议已在发行人向相关审批部门正式提交上市申请文件时终止；

5、上述协议约定不会导致公司控制权变化，未与市值挂钩，不存在严

重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。

2.3 补充披露情况

发行人在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化情况”之“（十）第六次增加注册资本”中补充披露如下：

2018 年 11 月 23 日，公司 2018 年第一次临时股东大会作出决议，同意 Intel Capital 以 175,074,860 美元的价格认购 101,683,250 股新增股份，SVIC No. 28 Investment 以 19,452,762 美元的价格认购 11,298,150 股新增股份，增资价格系公司与增资方协商确定。此次增资后公司注册资本由 903,851,100 元增加至 1,016,832,500 元。

本次增资的新进股东最终受益人为 Intel 和三星电子，系发行人供应商和客户，但相关股份获取与发行人获得其服务无关。

自 2006 年及 2012 年以来，英特尔、三星电子分别与公司建立了稳定的业务合作关系。经过长期观察和尽职调查，英特尔旗下的 Intel Capital、三星电子间接控制的 SVIC No. 28 Investment，看好公司原海外母公司 Montage Holding 的发展前景，遂决定与 Montage Holding 就相关融资展开谈判，并于 2016 年与 Montage Holding 签署相关协议。

2018 年 4 月，公司拆除境外架构时，因 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 是通过增资方式持有 Montage Holding 的优先股股东，不同于普通股股东，所以 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 与发行人协商以增资的方式成为发行人股东。后经协商谈判，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 于 2018 年 12 月对发行人增资，成为发行人股东。

本次增资对应的投后估值为 17.51 亿美元（约合 120 亿元人民币），对应公司 2018 年扣非后净利润的市盈率倍数为 17.18，与同期同行业一级市场相关投资估值不存在重大差异，具有公允性。

3.关于津逮®服务器

根据回复材料,津逮®服务器CPU是公司与清华大学、Intel联合研发的产品,其所有权及品牌归属为澜起科技。津逮服务器平台的整体设计由澜起科技负责,其中津逮®服务器CPU是由澜起科技与清华大学、Intel联合研发,混合安全内存模组由澜起科技独立研发,可重构处理器固件由澜起科技和清华大学联合研发,专用服务器BIOS和用于实现动态安全监控的服务管理软件由清华大学及其他合作伙伴研发并提供。

请发行人在重大事项提示和“风险因素”之“津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险”中,补充披露:(1)津逮®服务器平台业务与相关合作方的具体合作模式;(2)募投项目实施后,发行人新增与Intel关联交易的具体情况;(3)2018年12月Intel入股发行人的情况,模拟测算Intel入股价格与同期公允价值价差对公司经营业绩的影响。

请发行人补充披露:(1)津逮®服务器所有权归公司所有,但Intel在报告期内持续向公司支付研发费用补贴的原因及合理性;(2)Intel通用CPU内核芯片在津逮®服务器CPU成本中的占比情况,未来津逮®服务器CPU量产是否会导致发行人对Intel的重大依赖;(3)与Intel、清华大学及其他合作伙伴有关利益分享或支付成本费用的安排,若不存在,是否符合正常的商业惯例,报告期内相关成本、费用的支付情况,并提供与Intel、清华大学的合作协议;(4)2018年12月Intel入股后投后估值17.51亿美元,发行人本次发行预计市值不低于220.10亿人民币,Intel入股时是否已对发行人上市有明确预期,入股价格是否公允,定价较低是否与未来Intel与发行人在津逮®服务器业务的合作相关,并测算Intel入股价格与同期公允价值价差对公司经营业绩财务指标的影响;(5)报告期内,公司采购DRAM内存颗粒的最终供应商,是否为公司主要客户,未来服务器平台量产是否会导致公司对客户的依赖,是否会影响公司对客户的议价能力。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。

3.1 发行人说明

一、请发行人在重大事项提示和“风险因素”之“津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险”中,补充披露:(1)津逮®服务器平台业务与相关合作方的

具体合作模式；(2)募投项目实施后，发行人新增与 Intel 关联交易的具体情况；
(3) 2018 年 12 月 Intel 入股发行人的情况，模拟测算 Intel 入股价格与同期公允价值价差对公司经营业绩的影响。

公司已在招股说明书“重大事项提示”之“四、特别风险提示”之“（八）津逮®服务器平台业务面临的不确定性风险”中补充披露相关信息。具体内容参见本回复第一题“1.3 补充披露情况”。

二、津逮®服务器所有权归公司所有，但 Intel 在报告期内持续向公司支付研发费用补贴的原因及合理性

为了支持合作伙伴研发应用包含 Intel 技术的相关产品，2017 年 9 月公司与 Intel 签署了一次性工程费用（以下简称“NRE”）协议。根据 NRE 协议，针对相关的研发、测试、验证、发布等工作约定了具体的补贴金额和支付时间安排，Intel 根据研发项目的关键节点完成进度支付研发补贴费用。报告期内，Intel 公司根据相关协议，分别于 2017 年、2018 年支付补贴资金 784.10 万元及 157.30 万元。

根据市场公开资料，Intel 为研发项目合作伙伴提供研发费用补贴的合作案例如下：

1、深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”）的招股说明书披露，2016 年 7 月，广和通与 Intel 签署《XMM7360M.2 项目 NRE 协议》，约定 Intel 向该公司支付 NRE 费用，由广和通在 Intel®XMM™7360 解调器平台上研发一项新的产品并将其投放入市场，该费用于偿付产品开发所发生的部分 NRE 费用。

2、安徽开润股份有限公司 2016 年年度审计报告中披露，根据上海润米科技有限公司与 Intel Technology Sdn Bhd 签订的《英特尔-润米可充电智能鞋项目 NRE 协议》，Intel Technology Sdn Bhd 提供 50 万美元用于支持上海润米的研发项目。

为了支持合作伙伴研发应用包含 Intel 技术的相关产品，扩大 Intel 自身品牌及市场影响力，Intel 为研发项目合作伙伴提供研发费用补贴是 Intel 及行业的一般惯例。

综上，Intel 在报告期内向公司支付研发费用补贴系 Intel 支持合作伙伴研发应用包含 Intel 技术相关产品，具有合理性。

三、Intel 通用 CPU 内核芯片在津逮®服务器 CPU 成本中的占比情况，未来津逮®服务器 CPU 量产是否会导致发行人对 Intel 的重大依赖

津逮®服务器 CPU 在报告期内主要处于研发阶段，销售产品主要为工程样品，其中 Intel 通用 CPU 内核芯片在津逮®服务器 CPU 成本中的占比在 90%左右。

从行业现状来看，根据 DRAMeXchange 的统计数据，x86 架构解决方案 2018 年仍为服务器芯片市场主流，两大主导厂商包括 Intel 和 AMD，其中 Intel 因其综合竞争力，2018 年在服务器 CPU 中市场占有率超过 95%，在市场上具有绝对领先地位，全球 x86 服务器行业参与者均对 Intel 生产的服务器 CPU 存在一定程度的依赖。因此从行业角度在 x86 服务器领域从事研发和销售，同 Intel 进行开展合作具有合理性和现实性，公司也希望通过研发和销售津逮®服务器 CPU 及其平台，为国内 x86 服务器生态系统提供更安全的硬件解决方案。

津逮®服务器 CPU 是澜起科技推出的一系列具有预检测和动态安全监控功能的 x86 架构处理器。津逮®服务器 CPU 在英特尔 x86 处理器的基础上集成了清华大学的 DSC 技术，可与澜起科技的混合安全内存模组（HSDIMM®）搭配而组成津逮®服务器平台，为云计算服务器提供芯片级的动态安全监控功能。因此，津逮®服务器 CPU 所提供的核心功能是预检测和动态安全监控功能，同时支持国密算法的加解密、可信启动等功能。而 Intel 提供的内核 CPU 是标准化产品，两者所面向的市场需求不同，Intel 仅为公司的合作伙伴和供应商，公司不存在对 Intel 的重大技术依赖。

报告期内，津逮®服务器 CPU 平台处于研发阶段，其销售收入占公司收入比重低于 1%，对报告期内公司的经营影响较小。公司凭借在全球内存接口芯片领域逐步建立的竞争优势和话语权，在报告期内实现了持续的收入和利润增长。2018 年，公司的收入达到 17.58 亿元，净利润达到 7.37 亿元，具备了持续经营和独立发展的能力。

公司本次发行的募投项目具体情况如下：

序号	项目名称		是否与独立研发	募集资金投资额(万元)	募集资金使用比例
1	新一代内存接口芯片研发及产业化项目		是	101,785.00	44.25%
2	津逮®服务器CPU 及其平台技术升级项目	津逮®服务器CPU	同清华大学、Intel 联合研发	74,520.16	32.40%
		混合安全内存模组	是		
3	人工智能芯片研发项目		是	53,713.90	23.35%
合计				230,019.06	100.00%

其中，内存接口芯片业务是公司自主研发的结果，是报告期内公司收入和利润的主要来源，随着公司技术水平及市场占有率的不断提升，具有较强的市场竞争力，不存在对任何公司的重大依赖。

津逮®服务器 CPU 平台包括津逮®服务器 CPU 及混合安全内存模组，其中津逮®服务器 CPU 使用的 CPU 内核来源于 Intel，但也包含了公司自主研发的核心技术；混合安全内存模组产品为公司自主研发。公司对津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目的投资金额占公司本次募集资金总额的比例为 32.40%，其中部分用于津逮®服务器 CPU 的研发。该系列产品主要是为了丰富公司的产品线布局，储备未来业务的增长点，提升公司的综合竞争能力，该产品的量产仅是公司未来业务增长点之一，是增量不是存量，不会造成公司对 Intel 的重大依赖。

同时公司将凭借技术积累在人工智能芯片领域进行研发投入。

综上所述，公司向 Intel 相关主体采购其通用 CPU 内核芯片，是由 Intel 在服务器 CPU 领域的市场地位所致，双方合作系市场化的业务合作与采购，津逮®服务器 CPU 产品对其存在一定依赖，但这种合作对公司无重大不利影响。由于津逮®服务器 CPU 产品仅为公司未来发展规划中三个募投项目中“津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目”的一部分，因此未来津逮®服务器 CPU 量产不会导致发行人对 Intel 的重大依赖。

四、与 Intel、清华大学及其他合作伙伴有关利益分享或支付成本费用的安排，若不存在，是否符合正常的商业惯例，报告期内相关成本、费用的支付情况，并提供与 Intel、清华大学的合作协议

津逮®服务器 CPU 品牌、产权及销售收入均归公司所有，目前在收入层面不存在利益分享机制。

目前公司津逮®服务器平台仍处于市场推广阶段，尚未大规模销售，预计公司将采取商业上惯用的知识产权授权费方式向清华大学支付技术使用费。由于具体细节还在协商中，截至本问询回复签署日，公司与清华大学未发生利益分享或成本费用的支付。

公司同 Intel 之间合作模式系公司对通用 CPU 内核的正常商业采购，除 Intel 因支持公司与下游服务器厂商合作给予公司部分研发补贴外，公司同 Intel 之间不存在利益分成或相关成本、费用的支付约定，以上合作方式符合正常的商业惯例。

五、2018 年 12 月 Intel 入股后投后估值 17.51 亿美元，发行人本次发行预计市值不低于 220.10 亿人民币，Intel 入股时是否已对发行人上市有明确预期，入股价格是否公允，定价较低是否与未来 Intel 与发行人在津逮®服务器业务的合作相关，并测算 Intel 入股价格与同期公允价值价差对公司经营业绩财务指标的影响

自 2006 年及 2012 年以来，英特尔、三星电子分别与公司建立了稳定的业务合作关系。经过长期观察和尽职调查，英特尔旗下的 Intel Capital、三星电子间接控制的 SVIC No. 28 Investment，看好公司原海外母公司 Montage Holding 的发展前景，遂决定与 Montage Holding 就相关融资展开谈判，并于 2016 年与 Montage Holding 签署相关协议。

2018 年 4 月，公司拆除境外架构时，因 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 是通过增资方式持有 Montage Holding 的优先股股东，不同于普通股股东，所以 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 与发行人协商以增资的方式成为发行人股东。后经协商谈判，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 于 2018 年 12 月对发行人增资，成为发行人股东。

2018 年 Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 与公司启动谈判时，公司还未进行股改，并无明确的上市时间表。Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 对公司短期内上市不存在明确预期，但基于其投资退出机制的行业惯例，其在同公司

的股东协议中约定了如果公司 2021 年 5 月未完成上市，上述股东有权要求公司按其投资成本回购股份。双方于 2018 年 10 月完成谈判，公司于 2018 年 10 月召开董事会审议通过相关增资议案，并同意提交股东大会审议。在此时点，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 对公司在短期内上市不存在明确预期。

本次增资对应的投后估值为 17.51 亿美元（约合 120 亿元人民币），对应公司 2018 年扣非后净利润的市盈率倍数为 17.18，与同期同行业一级市场可比投资估值（市盈率 15.78-18.57 倍）不存在重大差异，具有公允性。具体参考如下：

1) 上市公司收购同行业公司估值水平

参考四维图新收购杰发科技 100%股权和东软载波收购上海海尔 100%股权等同行业上市公司收购市盈率，其行业平均动态市盈率为 18.57，由于上述收购为收购控制权的兼并，其估值水平中包含了一定的溢价。

项目	杰发科技	上海海尔
动态市盈率	19.20	17.94

2) Intel Capital 投资同行业其他项目估值水平

参考 Intel Capital 投资的同行业其他项目估值的公开资料，其对应的行业平均动态市盈率约为 15.78。

	乐鑫科技	卓易科技
Intel Capital 投资时间	2018 年 3 月 18 日	2016 年 9 月 6 日
投后估值	15.82 亿	4.21 亿
动态市盈率	16.85	14.71

本次发行预计市值系公司保荐机构根据二级市场同行业可比公司的平均估值进行测算，其估值背景及估值逻辑与前述增资存在较大差异，且是在前述增资完成后进行的，两者之间不具有参考性和可比性。同时按照相关规范，结合公司最新一轮融资价格，保荐机构已对本次发行的预计市值进行了更新，为不低于 120 亿元。

综上所述，Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 投资公司主要系看好公司未来盈利前景及技术水平，有意进一步加深合作，同时获取投资回报，其定价相

比同期同行业一级市场可比投资估值（动态市盈率），不存在重大差异，相关定价公允，不形成对客户和供应商的激励或补偿，不构成股份支付，不存在对公司经营业绩的影响。

六、报告期内，公司采购 DRAM 内存颗粒的最终供应商，是否为公司主要客户，未来服务器平台量产是否会导致公司对客户的依赖，是否会影响公司对客户的议价能力

公司津逮®服务器平台中使用的混合安全内存模组系公司自主研发且拥有知识产权的产品，结合了 Mont-ICMT®（Montage, Inspection & Control on Memory Traffic）内存监控技术，可实现对内存数据的保护功能。公司按照需求和产品工艺要求向 DRAM 厂商的经销商采购内存颗粒，并结合公司定制开发的内存接口芯片，由代工厂商代工生产混合安全内存模组。

DRAM 内存颗粒作为服务器、计算机等设备的核心元器件，其市场体量巨大且为通用大宗商品，其销售价格相对公开透明。

报告期内，公司主要通过三星电子和海力士的经销商采购 DRAM 内存颗粒，虽然三星电子和海力士是公司的主要客户，但由于 DRAM 内存颗粒有充足的经销商货源可供公司选择，不会导致公司对单一客户的依赖，也不会影响公司对客户的议价能力。

3.2 保荐机构的核查过程和核查结论

保荐机构获取并审阅了发行人与 Intel 签署的 NRE 协议；获取了发行人公司同 Intel、清华大学签署的有关津逮®服务器的合作备忘录；通过公开渠道获取了广和通的招股说明书和安徽开润股份有限公司 2016 年年度审计报告并整理了 Intel 与上述公司的 NRE 协议研发补贴的具体内容；访谈了 Intel 相关销售负责人；获取并审阅了 Intel 通用 CPU 内核芯片在津逮®服务器 CPU 成本中的占比情况；收集服务器 CPU 行业相关数据及研究报告；收集并分析了集成电路行业相关并购案例及投资案例，对集成电路行业估值水平进行了分析；获取并审阅了公司采购 DRAM 内存颗粒的最终供应商情况。

经核查，保荐机构认为

1、Intel 在报告期内向公司支付研发费用补贴系 Intel 支持合作伙伴研发应用包含 Intel 技术相关产品的行业惯例，具有商业合理性；

2、公司向 Intel 采购其通用 CPU 内核芯片，是由 Intel 在服务器 CPU 领域的市场地位所致，双方合作系市场化的业务合作与采购，津逮®服务器 CPU 产品对其存在一定依赖，但上述合作对公司无重大不利影响，未来津逮®服务器 CPU 量产不会导致发行人对 Intel 的重大依赖；

3、公司同 Intel 之间合作模式系公司对通用 CPU 内核的正常商业采购，除 Intel 因支持公司与下游服务器厂商合作给予公司部分研发补贴外，公司同 Intel 之间不存在利益分成或相关成本、费用的支付约定；截至本问询函回复签署日，公司与清华大学尚未约定具体的利益分享或支付成本费用的安排；

4、Intel Capital、SVIC No. 28 Investment 投资公司，其定价相比同期同行业一级市场可比投资估值（动态市盈率），不存在重大差异，相关定价公允，不存在对公司经营业绩的影响；

5、公司采购 DRAM 内存颗粒系用于研发及推广混合安全内存模组的正常采购行为，但由于 DRAM 内存颗粒有充足的经销商货源可供公司选择，不会导致发行人对单一客户的重大依赖，不会影响公司对客户的议价能力。

3.3 补充披露情况

发行人在招股说明书“第七节 公司治理及独立性”之“八、关联方、关联关系和关联交易”之“（二）关联交易”中补充披露如下：

（4）同 Intel 之间的津逮®服务器 CPU 开发项目款项

2017 年，公司同 Intel 签署相关合作协议，作为津逮®服务器 CPU 的合作伙伴，Intel 同公司联合开发服务于客户的津逮®服务器 CPU 相关产品，由 Intel 向公司提供研发支持，合计金额为 210 万美元。

报告期内，公司因合作开发补贴产生的关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Intel Semiconductor	研发费用补贴	157.30	784.10	-

(US) LLC				
合计		157.30	784.10	-

为了支持合作伙伴研发应用包含 Intel 技术的相关产品，2017 年 9 月公司与 Intel 签署了一次性工程费用（以下简称“NRE”）协议。根据 NRE 协议，针对相关的研发、测试、验证、发布等工作约定了具体的补贴金额和支付时间安排，Intel 根据研发项目的关键节点完成进度支付研发补贴费用。报告期内，Intel 公司根据相关协议，分别于 2017 年、2018 年支付补贴资金 784.10 万元及 157.30 万元。

2018 年来自 Intel 的研发费用补贴较 2017 年有一定程度下降，主要系公司与 Intel 签订的相关协议中，约定了研发费用的补贴条件系根据津逮®服务器平台达成具体研发进度时发放。根据协议，触发相关研发补贴的主要节点均发生在 2017 年，因此在 2017 年中确认的研发费用补贴较高。

发行人在招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“三、本次募集资金投资项目的具体情况介绍”之“（二）津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目”中补充披露如下：

5、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

基于公司自有的内存数据安全管理和保护技术，结合我国对自主知识产权的安全、可信、可控服务器平台的迫切需求，公司联合清华大学和英特尔共同开发基于 x86 架构的服务器 CPU 及其平台，满足我国数据中心市场对高安全性、可扩展性和高可靠性服务器的需求。

6、未来津逮®服务器 CPU 量产不会导致公司对 Intel 的重大依赖

津逮®服务器 CPU 及其平台包括津逮®服务器 CPU 及混合安全内存模组，其中津逮®服务器 CPU 使用的内核 CPU 来源于 Intel，但也包含了公司自主研发的核心技术；混合安全内存模组产品为公司自主研发。公司对津逮®服务器 CPU 及其平台技术升级项目的投资金额占公司本次募集资金总额的比例为 32.40%，其中部分用于津逮®服务器 CPU 的研发。该系列产品主要是为了丰富公司的产品线布局，储备未来业务的增长点，提升公司的综合竞争能力，该产品的量产仅是

公司未来业务增长点之一，是增量不是存量，不会造成公司对 Intel 的重大依赖。

发行人在招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发情况”之“（一）公司的核心技术情况”中补充披露如下：

2、津逮®服务器平台的具体架构、公司的技术体现及利益分享机制

津逮服务器平台具体架构包括如下方面：在硬件层面，包括津逮®服务器 CPU、混合安全内存模组；在固件层面，包括专用服务器 BIOS 和可重构处理器固件；在软件层面，用于实现动态安全监控的服务管理软件等。

服务器平台的整体设计由澜起科技负责，其中津逮®服务器 CPU 是由澜起科技与清华大学、Intel 联合研发，混合安全内存模组由澜起科技独立研发，可重构处理器固件由澜起科技和清华大学联合研发，专用服务器 BIOS 和用于实现动态安全监控的服务管理软件由清华大学及其他合作伙伴研发并提供。

津逮®服务器 CPU 品牌、产权及销售收入均归公司所有，目前在收入层面不存在利益分享机制。目前公司津逮®服务器平台仍处于市场推广阶段，尚未大规模销售，预计公司将采取商业上惯用的知识产权授权费方式向清华大学支付技术使用费。截至本招股说明书签署日，具体细节还在协商中，报告期内公司与清华大学未发生利益分享或成本费用的支付。公司同 Intel 之间合作模式系正常的商业采购，除 Intel 因支持公司与下游服务器厂商合作给予公司部分研发补贴外，公司同 Intel 之间不存在相关成本、费用的支付约定，以上合作方式符合正常的商业惯例。

发行人在招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务”之“（二）主要经营模式”中补充披露如下：

（6）混合安全内存模组的采购情况

公司津逮®服务器平台中使用的混合安全内存模组系公司自主研发且拥有知识产权的产品。公司按照需求和产品工艺要求向 DRAM 厂商的经销商采购内存颗粒，并结合公司定制开发的内存接口芯片，由代工厂商代工生产混合安全内存模组。DRAM 内存颗粒作为服务器、计算机等设备的核心元器件，其市场体量

巨大且为通用大宗商品，其销售价格相对公开透明。

报告期内，公司主要通过向主要客户的经销商采购 DRAM 内存颗粒，但由于 DRAM 内存颗粒有充足的经销商货源可供公司选择，不会导致公司对单一客户的依赖，也不会影响公司对客户的议价能力。

4.关于关联交易

根据回复材料, Intel、SVIC 在发行人申报前进行增资, 分别取得发行人 10%、1.111% 的股份, 发行人与 Intel、三星电子存在交易, 招股说明书未将与三星电子的交易认定为关联交易。

请发行人比照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号—科创板公司招股说明书》关于关联交易的信息披露要求, 补充披露与三星电子、Intel 的交易情况。

请发行人说明: (1) 报告期各期, 发行人与三星电子、Intel 交易的交易金额、占比、价格, 请结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等, 说明相关交易是否公允; (2) 报告期内, 发行人与三星电子、Intel 交易履行的决策程序, 关联股东是否回避表决, 独立董事是否发表明确意见。

请保荐机构、发行人律师进行核查, 说明核查方式、过程、依据, 并发表明确意见。

回复:

4.1 发行人说明

一、报告期各期, 发行人与三星电子、Intel 交易的交易金额、占比、价格, 请结合可比市场公允价格、第三方市场价格、关联方与其他交易方的价格等, 说明相关交易是否公允;

1、报告期公司与三星电子的交易情况

截至本招股说明书签署日, 公司股东 SVIC No. 28 Investment 持有发行人 1.11% 的股份, 其关联方三星电子为公司主要客户之一。

报告期内, 公司向其销售产品为内存接口芯片, 且销售金额随着公司销售收入的增加逐年上升, 2018 年公司对其销售收入超过 4 亿元。

公司根据市场情况, 针对不同型号的产品同其进行协商议价, 相关交易均履行了公司经营管理的决策程序。公司向三星电子及其关联方的销售单价同其他第三方客户销售单价相比不存在重大差异, 其销售的定价原则、定价依据等未因

SVIC No. 28 Investment 投资公司发生改变，相关定价公允。

2、报告期公司与 Intel 的交易情况

Intel 作为全球最大的 CPU 厂商，在 x86 处理器领域占有主要的市场地位。报告期内，公司同 Intel 进行合作，并于 2018 年开始采购其通用 CPU 内核芯片用于研发，预计随着公司津逮®服务器平台的研发成功，公司将持续采购其通用 CPU 内核芯片。同时 Intel 向公司采购混合安全内存模组等用于其自身的研发、实验生产等，具有必要性、合理性。

报告期内的交易情况具体如下：

（1）采购商品

报告期内，公司向 Intel 及其关联方采购的情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
采购金额	2,708.58	-	-
占公司总采购的比例	3.68%	-	-

公司同 Intel 进行合作，并于 2018 年开始采购其 CPU 用于研发，2018 年公司向 Intel 采购的金额为 2,708.58 万元，占 2018 年度总采购金额的比例为 3.68%，占比较小。由于 Intel 向第三方销售价格是 Intel 的商业机密，因此公司无法获取。Intel 入股公司前后，公司向 Intel 采购的服务器 CPU 单价和定价方式，不存在重大变化，相关交易定价公允。

（2）销售商品

报告期内，公司向 Intel 及其关联方销售的情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
销售金额	560.93	757.56	15.06
占公司营业收入的比例	0.32%	0.62%	0.02%

报告期内，公司根据 Intel 采购需求，主要是向其销售混合安全内存模组样品等产品，销售价格为双方协商按公允价格销售。2016 年、2017 年及 2018 年销售金额分别为 15.06 万元、757.56 万元及 560.93 万元，占公司营业收入比分别为

0.02%，0.62%及 0.32%，销售金额占比较小。相关混合安全内存模组为工程样品，不属于量产销售，销售价格同公司销售给第三方价格不存在重大差异，相关交易定价公允。

二、报告期内，发行人与三星电子、Intel 交易履行的决策程序，关联股东是否回避表决，独立董事是否发表明确意见；

2018 年 10 月 28 日，公司召开创立大会暨 2018 年第一次股东大会，审议通过了《关于澜起科技股份有限公司关联交易制度的议案》。

2018 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议并审议通过了《关于公司与英特尔公司 2018 年日常关联交易预计的议案》，独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见如下“公司拟与英特尔公司开展的关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，同意相关议案。”；同日，该议案经公司第一届监事会第一次会议审议通过。

2019 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第四次会议并审议通过了《关于确认公司 2016、2017、2018 年度各项关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事就该议案基于独立判断的立场发表意见如下“公司 2016、2017、2018 年度各项关联交易，均按照公允、合理的原则进行定价，不存在损害公司及股东合法利益的情形，同意相关议案。”；同日，该议案经公司第一届监事会第二次会议审议通过；2019 年 3 月 5 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司 2016、2017、2018 年度各项关联交易的议案》，关联股东回避表决。

报告期内，公司与上述企业及其他关联方进行的关联交易已履行了必要的决策程序，关联股东已回避表决，独立董事已发表明确意见。

公司与三星电子的交易是公司正常经营交易，均履行了经营管理层的内部决策程序。

4.2 保荐机构和发行人律师的核查过程和核查结论

保荐机构及发行人律师获取并审阅了报告期各期公司同 Intel 及三星电子的销售及采购订单；获取了发行人收入明细表并对公司的主要销售客户单价情况进行分析；对 Intel 的销售业务负责人进行了现场访谈，详细了解了 Intel 向公司销

售定价的公允性情况；获取了发行人采购明细表并对公司同 Intel 的采购定价的公允性进行分析；获取了公司有关关联交易的决策文件以及独立董事发表的事前认可意见和独立意见；

经核查，保荐机构及发行人律师认为发行人同 Intel 及三星电子的交易定价公允；报告期内，公司与上述企业的交易均已履行了必要的决策程序，其中针对 Intel 的关联交易决策程序，关联股东已回避表决，独立董事已发表明确意见。

4.3 补充披露情况

发行人在招股说明书“第七节 公司治理及独立性”之“九、其他交易”中补充披露如下：

截至本招股说明书签署日，公司股东 SVIC No. 28 Investment 持有发行人 1.11% 的股份，其关联方三星电子为公司主要客户之一。

报告期内，公司向其销售产品为内存接口芯片，且销售金额随着公司销售收入的增加逐年上升，2018 年公司对其销售收入超过 4 亿元。

公司根据市场情况，针对不同型号的产品同其进行协商议价，相关交易均履行了公司经营管理的决策程序。公司向三星电子及其关联方的销售单价同其他第三方客户销售单价相比不存在重大差异，其销售的定价原则、定价依据等未因 SVIC No. 28 Investment 投资公司发生改变，相关定价公允。

5.关于业务重组

根据申请及回复材料，发行人2016年同一控制下合并澜起开曼，支付对价45.24亿元，当时业务包括内存接口芯片、消费电子芯片两部分，2017年发行人将消费电子芯片业务出售给关联方，包含资产、负债、人员、合同等的转移，对价为2.5亿元。消费电子芯片业务2016年及2017年终止经营前净利润分别为-9,500.52万元、3,010.29万元，成都澜至购买消费电子芯片业务后2017年、2018年实现净利润分别为3,784.11万元、-3,301.09万元。

请发行人进一步说明：（1）结合收购股权及出售业务相关主体的经营业绩、账面资产金额及占比等情况说明上述两项交易价格差异巨大的原因；（2）出售的消费电子芯片业务是否应视为一项整体业务出售，采用资产基础法而非收益法进行评估是否恰当，是否存在价值低估的情况，是否损害发行人的利益；（3）出售消费电子芯片业务是否构成同一控制下的业务重组，若构成，发行人对于上述交易的会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定；若不构成，请提供相关依据；（4）消费电子芯片业务2016年及2017年业绩存在巨大差异的原因及合理性，成都澜至购买消费电子芯片业务后2018年经营亏损的原因，与发行人消费电子芯片业务终止经营前该业务的成本费用金额及占比情况对比说明是否存在为发行人代垫成本费用的情形；（5）发行人出售消费电子芯片业务的原因，成本费用的分摊原则，资产切割的原则，转让的资产与发行人是否彻底切割清楚，是否存在资产共用、专利等技术共享或相互授权、人员交叉、渠道混同、客户供应商重叠、平台共用的情况，该业务是否真实转让剥离，上述情况是否导致发行人主营业务重大变化或者管理混乱、人员动荡等影响持续经营能力的情形；（6）发行人以“澜起有限聚焦于服务器芯片领域、成都澜至聚焦于消费电子芯片领域”划分不存在同业竞争的措施是否有效，发行人未来是否存在收购成都澜至全部或部分股权的意图。

请保荐机构、发行人律师、申报会计师进行核查，并发表明确意见。

回复：

5.1 发行人说明

一、结合收购股权及出售业务相关主体的经营业绩、账面资产金额及占比等情况说明上述两项交易价格差异巨大的原因；

2016 年 5 月公司收购澜起开曼的对应价格为 45.24 亿元；2017 年 7 月公司转让消费电子芯片业务资产的对应价格为 2.48 亿元，2016 年收购股权和 2017 年出售业务的交易价格差异原因如下：

公司 2016 年同一控制下合并澜起开曼，澜起开曼是 Montage Holding 当时在境外的主要经营资产，包括内存接口芯片业务和消费电子芯片业务，该次收购股权主要是为了将原 Montage Holding 下属的境外经营资产装入公司体内。2017 年公司将消费电子芯片业务相关资产出售给关联方，只包括消费电子芯片业务。

澜起开曼 2016 年 1-5 月及公司 2017 年 1-7 月的经营业绩、账面资产金额及对应消费电子芯片业务相关指标占比情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-7 月/2017 年 7 月 31 日			2016 年 1-5 月/2016 年 5 月 31 日		
	消费电子芯片业务金额	公司合并报表金额	占比	消费电子芯片业务金额	澜起开曼合并报表金额	占比
毛利	3,311.24	36,708.14	9.02%	1,435.28	11,811.24	12.15%
净利润	-2,488.51	19,815.20	--	-18.22	8,069.53	--
资产账面金额	18,451.64	152,537.10	12.10%	7,487.03	66,945.61	11.18%

注：资产账面金额为消费电子芯片业务涉及的存货、固定资产、应收账款等的账面价值；2017 年 1-7 月合并报表金额是公司剔除 2017 年 7 月 31 日转让消费电子相关资产影响后的数据，2016 年 1-5 月合并报表数据为澜起开曼的数据。

2016 年 1-5 月消费电子芯片业务的毛利占比为 12.15%且净利润为负，2016 年 5 月 31 日消费电子芯片业务对应资产的账面金额占比为 11.18%，因此 2016 年收购澜起开曼的交易估值的主要部分是针对内存接口芯片业务。

2017 年 1-7 月消费电子芯片业务毛利占比由 12.15%下降到 9.02%，经营亏损有所扩大，相关资产的估值有所下降具有合理性。

2016 年 5 月公司收购澜起开曼的对应价格为 45.24 亿元；2017 年 7 月公司转让消费电子芯片业务资产的对应价格为 2.48 亿元，2017 年出售消费电子芯片相关资产的估值与 2016 年收购澜起开曼估值之比为 5.48%，与其相关业务在整个公司中的毛利占比和盈利情况基本匹配。

综上所述，2016 年收购澜起开曼的交易估值的主要部分是针对内存接口芯

片业务，2017 年消费电子芯片业务的毛利占比下降且持续亏损，2017 年转让消费电子芯片业务相关资产的交易价格低于 2016 年收购澜起开曼的交易价格具有合理性。

二、出售的消费电子芯片业务是否应视为一项整体业务出售，采用资产基础法而非收益法进行评估是否恰当，是否存在价值低估的情况，是否损害发行人的利益；

1、出售的消费电子芯片业务是否应视为一项整体业务出售

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其应用指南、讲解的规定，业务是指企业内部某些生产经营活动或资产负债的组合，该组合具有投入、加工处理和产出能力，能够独立计算其成本费用或所产生的收入。业务通常具备“投入”、“加工处理过程”和“产出”三个要素。有关资产或资产、负债的组合是否构成一项业务，应结合所取得资产、负债的内在联系及加工处理过程等进行综合判断。

发行人转让的消费电子芯片业务相关资产、负债、合同和人员，具备开展业务活动所需的员工、知识产权和其他投入，以及可运用于这些投入的加工处理过程。通过实施具备产出能力的计划，可以赢得客户来购买其产出的产品、服务，并且公司可以独立计算其产生的收入。因此，发行人出售的消费电子芯片业务在会计处理上应视为一项整体业务出售。

2、采用资产基础法而非收益法进行评估是否恰当，是否存在价值低估的情况，是否损害发行人的利益；

资产评估采用收益法必须具备以下前提条件：1）被评估资产的未来预期收益可以预测且可以用货币衡量；2）资产所有者获得预期收益所承担的风险也可以预测并可以用货币衡量；3）被评估资产预期获利年限可以预测。

考虑到消费电子芯片业务在报告期出现亏损，且未来可持续经营能力具有不确定性，因此被评估资产预期获利年限无法合理预测，无法采用收益法对消费电子芯片整体业务进行评估。后续的经营情况也证实其业务目前仍处于亏损状态。

公司消费电子芯片业务 2017 年度盈利主要是转让消费电子芯片业务相关资产所产生的资产处置收益造成的。剔除上述因素，2017 年 1-7 月发行人消费电子芯片业务经营业绩亏损 2,488.51 万元，其利润总额和净利润均是负数，具体情况

如下：

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年 1-7 月		
		2017 年 1-7 月合计	其中：2017 年 7 月 31 日资产处置	其中：2017 年 1-7 月日常经营情况
营业收入	28,661.79	28,525.05	15,621.38	12,903.67
毛利	8,088.18	3,936.68	625.44	3,311.24
利润总额	-10,338.24	3,481.28	6,057.10	-2,575.82
净利润	-9,500.52	3,010.29	5,498.80	-2,488.51

成都澜至 2017 年度和 2018 年度的经营业绩情况如下表：

单位：万元

项目	2017 年度	2018 年度
营业收入	12,017.74	27,167.32
毛利	2,517.21	7,825.03
营业利润	-8,179.88	-6,928.13
营业外收入	12,444.42	170.00
净利润	3,784.11	-3,301.09

注：成都澜至报表未经审计，其成立于 2017 年 3 月。

成都澜至 2017 年盈利 3,784.11 万元为收到大额政府补助计入营业外收入所致，其 2017 年营业利润为-8,179.88 万元。2018 年营业利润为-6,928.13 万元，成都澜至受让消费电子芯片业务后的经营活动一直处于亏损的状态。

因此，由于转让时消费电子芯片经营状况不满足采用收益法估值的前提条件，公司采用资产基础法而非收益法进行评估是恰当的。

公司聘请专业的评估机构对消费电子芯片业务相关资产进行了评估。参考评估报告，消费电子芯片业务的相关资产在本次转让中总计增值 6,050.79 万元，增值率 31.52%。因此，相关评估作价公允，不存在价值低估和损害发行人的利益的情形。

三、出售消费电子芯片业务是否构成同一控制下的业务重组，若构成，发行人对于上述交易的会计处理是否符合《企业会计准则》的相关规定；若不构成，请提供相关依据；

1、出售消费电子芯片业务是否构成同一控制下的业务重组

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》第五条的规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

2017 年公司与消费电子芯片业务受让方成都澜至、澜至半导体和 Montage Group 均受同一母公司 Montage Holding 控制，因此 2017 年公司出售消费电子芯片业务构成同一控制下的业务重组。

2、发行人对出售消费电子芯片业务的会计处理

对于同一控制下的业务重组转让，企业会计准则并没有对应的规定。鉴于公司处置消费电子芯片业务相关资产对价公允，公司作为资产处置方将处置资产的公允价值与账面价值的差额确认为处置损益，如实反映了消费电子芯片业务出售的情况，并无不当，符合《企业会计准则——基本准则》第十二条“企业应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、计量和报告，如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息，保证会计信息真实可靠、内容完整。”之规定。

鉴于出售的消费电子芯片业务符合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》和《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》中对“终止经营”的定义，即“该组成部分代表一项独立的主要业务，是能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别”，因此公司已经按照企业会计准则对终止经营披露的相关要求，在申报财务报表及其附注中披露了相关的信息。

综上，公司对于上述交易的会计处理符合《企业会计准则》的相关规定。

四、消费电子芯片业务 2016 年及 2017 年业绩存在巨大差异的原因及合理性，成都澜至购买消费电子芯片业务后 2018 年经营亏损的原因，与发行人消费电子芯片业务终止经营前该业务的成本费用金额及占比情况对比说明是否存在为发行人代垫成本费用情形；

1、消费电子芯片业务 2016 年及 2017 年业绩存在巨大差异的原因及合理性
消费电子芯片业务 2016 年及 2017 年 1-7 月的经营业绩情况如下表所示：

单位：万元

项目	2016 年度	2017 年 1-7 月
----	---------	--------------

		2017 年 1-7 月合计	其中：2017 年 7 月 31 日资产处置	其中：2017 年 1-7 月日常经营情况
营业收入	28,661.79	28,525.05	15,621.38	12,903.67
毛利	8,088.18	3,936.68	625.44	3,311.24
利润总额	-10,338.24	3,481.28	6,057.10	-2,575.82
净利润	-9,500.52	3,010.29	5,498.80	-2,488.51

剔除 2017 年 7 月 31 日处置消费电子芯片相关资产处置收益 5,498.80 万元，2017 年 1-7 月公司消费电子芯片业务日常经营的净利润为-2,488.51 万元，2016 年度公司消费电子芯片业务的净利润为-9,500.52 万元，经营业绩存在差异主要系 2017 年 1-7 月经营时间短于 2016 年度所致。

综上，消费电子芯片业务 2016 年及 2017 年业绩存在巨大差异的主要原因是 2017 年公司消费电子芯片业务经营时间较短和 2017 年 7 月 31 日处置消费电子芯片相关资产产生处置收益 5,498.80 万元所致，具有合理性。

2、成都澜至购买消费电子芯片业务后 2018 年经营亏损的原因，与发行人消费电子芯片业务终止经营前该业务的成本费用金额及占比情况对比说明是否存在为发行人代垫成本费用的情形；

2016 年、2017 年 1-7 月公司消费电子芯片业务及 2017 年、2018 年成都澜至经营情况对比如下表：

单位：万元

项目	公司消费电子芯片业务				成都澜至			
	2016 年度		2017 年 1-7 月		2017 年度		2018 年度	
	金额	占当期 营业收入 比例	金额	占当期 营业收入 比例	金额	占当期 营业收入 比例	金额	占当期 营业收入 比例
营业收入	28,661.79	--	12,903.67	--	12,017.74	--	27,167.32	--
营业成本	20,573.61	71.78%	9,592.44	74.34%	9,500.53	79.05%	19,342.30	71.20%
毛利	8,088.18	28.22%	3,311.24	25.66%	2,517.21	20.95%	7,825.03	28.80%
期间费用	17,441.00	60.85%	5,212.46	40.40%	8,348.80	69.47%	13,992.81	51.51%
营业利润	-10,628.04	--	-2,557.76	--	-8,179.88	--	-6,928.13	--

注：公司消费电子芯片业务终止经营前 2017 年 1-7 月经营数据为剔除 2017 年 7 月 31 日转让消费电子相关资产影响后的合并报表数据。成都澜至数据未经审计。

2017 年 1-7 月公司消费电子芯片业务净利润为正系 2017 年 7 月 31 日转让相关资产获取了处置收益所致，剔除处置消费电子芯片相关资产处置收益，2017 年 1-7 月公司消费电子芯片业务日常经营的营业利润为-2,557.76 万元。成都澜至 2017 年盈利 3,784.11 万元为收到大额政府补助计入营业外收入所致，其 2017 年营业利润为-8,179.88 万元。

报告期内消费电子芯片业务在公司体内的营业利润分别为-10,628.04 万元、-2,557.76 万元；成都澜至购买消费电子芯片业务相关资产后，其营业利润分别为-8,179.88 万元、-6,928.13 万元，该业务经营业绩始终处于亏损状态。究其原因，报告期内消费电子芯片业务处于转型升级期，研发投入较大且均当期费用化，这也是 2018 年成都澜至经营亏损的主要原因。

2016 年公司消费电子芯片业务营业成本占营业收入的比例为 71.78%，成都澜至受让消费电子芯片业务资产后，2017 年和 2018 年其营业成本占营业收入比例分别为 79.05%和 71.20%，2018 年成本占比与 2016 年基本一致，2017 年成都澜至成本占比略有上升主要系公司向成都澜至转让的消费电子芯片存货根据评估有所增值，导致成都澜至相关产品的成本略有上升所致。

2016 年公司消费电子芯片业务的期间费用为 17,441.00 万元，2017 年消费电子芯片业务的期间费用（模拟合并公司体内的消费电子芯片业务和成都澜至）合计为 13,561.26 万元，2018 年成都澜至的期间费用为 13,992.81 万元。消费电子芯片业务 2017 年期间费用（模拟合并）较 2016 年下降主要系相关主体采取了降本增效措施。2018 年成都澜至期间费用和 2017 年消费电子芯片业务期间费用（模拟合并）基本一致。

同时，报告期内公司除消费电子芯片业务外的期间费用分别为 12,380.80 万元、25,686.24 万元和 51,669.60 万元，与业务收入的增长趋势一致。

综上所述，报告期内成都澜至营业成本占营业收入的比重与公司消费电子芯片业务营业成本占营业收入的比重不存在重大差异，2018 年成都澜至期间费用和 2017 年消费电子芯片业务期间费用（模拟合并）基本一致，且公司除消费电子芯片业务以外的期间费用在报告期内逐年上升，成都澜至不存在为公司代垫成本费用情形。

五、发行人出售消费电子芯片业务的原因，成本费用的分摊原则，资产切割的原则，转让的资产与发行人是否彻底切割清楚，是否存在资产共用、专利等技术共享或相互授权、人员交叉、渠道混同、客户供应商重叠、平台共用的情况，该业务是否真实转让剥离，上述情况是否导致发行人主营业务重大变化或者管理混乱、人员动荡等影响持续经营能力的情形；

1、出售消费电子芯片业务的原因

Montage Group 自成立以来，一直保持了持续的运营及研发，发展出内存接口芯片及消费电子芯片两条产品线，消费电子芯片应用于家庭和移动终端，而内存接口芯片应用于云端数据中心。由于原消费电子芯片业务分散在 Montage Group 各个子公司内，2017 年管理层及股东为优化资源配置、提升运营效率、提高团队自主性及积极性，决定公司聚焦于服务器芯片领域，成都澜至聚焦于消费电子芯片领域，让不同业务在不同的主体内独立发展，因此决定进行资产重组。2017 年 7 月 31 日，Montage Holding 作出董事会决议，同意将澜起有限所持有的消费电子芯片业务相关资产出售给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group。同时，原服务于消费电子芯片业务的澜起有限员工的劳动关系转移至澜至半导体。

此次公司出售消费电子芯片业务是公司原境外母公司 Montage Holding 为实现业务聚焦，提升运营效率而主动做出的决策。在出售相关资产前，公司内存接口芯片及消费电子芯片即分属两个不同的事业部，且相关技术、产品、生产工艺等均完全不同，均具有独立的销售、市场以及研发人员，仅共享财务、人事、行政等后台保障部门。从产品发展方面，内存接口芯片随着公司技术能力的提升市场占有率逐年上升，收入规模上升迅速，需要紧跟国际先进研发技术水平，保持市场竞争地位；消费电子芯片则属于相对成熟市场，收入规模保持稳定，整体业务需要挖掘新的增长点，两项业务在产品发展阶段上存在一定的差异。因此为获得更多的资源，提升各自团队的研发积极性，两个团队均有独立运作的希望。而从后台运营角度，针对两块业务不同的运营和管理标准也给公司的整体运营造成了一定压力。因此经过公司董事会及管理层决策，决定将两块业务独立经营，并由公司将消费电子芯片业务资产进行出售。

2、成本费用的分摊原则及资产切割的原则

2017 年 7 月公司将消费电子芯片业务资产进行转让，对成本费用及相关资产按产品进行分割，主要事项包括资产转让、未履约合同及人员转移，具体情况如下：

1) 资产转让情况

2017 年 7 月 31 日，Montage Holding 董事会通过书面决议，同意澜起有限及其子公司出售其消费电子芯片业务相关资产给成都澜至、澜至半导体及 Montage Group。交易价格以 2017 年 5 月 31 日的评估价值为基础，同时结合交割日的实际情况确定，其中境内资产交易价格为 17,145.06 万元，境外资产交易价格 1,130.99 万美元。

公司同成都澜至按照产品及业务进行了资产划分，其中资产包括消费电子芯片业务相关原材料、委托加工物资及存货均按照评估价格根据交割日进行了相关调整，定价公允。与在产消费电子芯片产品的相关的无形资产均按照评估价值进行转让。自 2017 年 7 月相关资产转让后，公司体内不存在消费电子芯片相关产品的存货及在使用的无形资产等，公司也不再从事消费电子芯片业务的销售和研发工作，转让的资产与发行人已彻底切割清楚，不存在资产共用、专利等技术共享或相互授权的情形。

2) 未履约合同情况

公司在资产转让时存在部分消费电子业务未履行完毕的合同，其中主要未履行完毕的合同由消费电子芯片业务资产的受让方承接。未履行完毕的销售订单，与客户沟通协商后，由客户重新下订单给受让方，并取消与公司未履行完毕的销售订单。未完成的采购订单，经与供应商协商后，由受让方重新下采购订单给供应商，并取消与公司未履行完毕的采购订单。受让人在销售和采购订单完成后负责回收和支付相应的款项。相关成本费用及合同履行均切割清楚，不存在互相承担成本费用的情形。

3) 人员转移情况

在转让消费电子芯片业务相关资产前，公司内存接口芯片及消费电子芯片相关人员分属两个事业部，其销售、研发、市场等部门均相互独立，仅有财务、人

事等后台部门存在重合的情况，因此此次人员转移中，原消费电子芯片业务销售、研发、市场等部门员工及部分后台服务于消费电子芯片业务员工均自 2017 年 8 月 1 日起均转移至澜至半导体，并与澜至半导体签订了新的劳动合同，相关转移人员后续的所有薪资及福利待遇均由澜至半导体承担，相关人员转移后不再为公司提供服务。公司董事长杨崇和先生曾在成都澜至、上海澜至、澜至半导体担任董事，但从未在上述公司领取薪酬，且目前已不再担任上述公司董事职务。除上述情况外，2017 年 7 月消费电子芯片业务资产转让后，公司同成都澜至、上海澜至、澜至半导体间不存在人员互相兼职的情形，不存在互相承担成本费用的情形。

截至本问询函回复签署日，成都澜至法定代表人、执行董事为 XIAOMIN SI（斯笑岷），其经营管理层基本情况如下：

斯笑岷先生现担任成都澜至法定代表人、执行董事。斯先生是澜起科技的创始人之一，2004 年 5 月至 2017 年 3 月曾先后担任澜起科技技术总监、消费电子芯片事业部研发副总裁。斯先生拥有逾 24 年的模拟、射频及数模混合信号的集成电路设计经验。

刘锦湘博士现担任成都澜至总经理。2014 年 8 月至 2017 年 3 月，刘博士曾先后任职澜起科技市场副总裁、消费电子芯片事业部总经理。刘博士在半导体集成电路行业拥有逾 25 年的产品规划、销售、市场营销以及工程管理经验。

成都澜至主要部门负责人包括：张家祯（研发）、刘学工（软件工程）、文俊（运营）、徐吟（人力资源与行政）、张健（财务）。

自 2017 年 8 月 1 日公司转让消费电子芯片业务资产后，上述人员和澜起科技不存在劳动关系，亦未在澜起科技领取薪酬，澜起科技和成都澜至管理层不存在重合的情况。

4) 转让后双方情况

由于相关专利、资产、人员等均通过转让的方式实现了分离，且两项业务在产品、技术、销售渠道上均有显著差异，自相关转让后，公司同成都澜至、上海澜至、澜至半导体不存在资产共用、专利等技术共享或相互授权、人员交叉、渠

道混同、平台共用的情况。

公司同成都澜至仅存在个别客户和供应商重叠，自 2017 年 7 月出售消费电子芯片业务相关资产后，公司同成都澜至客户重叠情况如下：

单位：万元

客户名称	交易内容	2018 年度	销售占比	2017 年 8-12 月	销售占比
中电器材	销售商品	301.59	0.17%	62.07	0.15%
合计		301.59	0.17%	62.07	0.15%

自 2017 年 7 月出售消费电子芯片业务相关资产后，仅有中电器材一家重叠的客户，自 2017 年 8-12 月及 2018 年，公司对其销售占公司营业收入的比例分别为 0.15% 及 0.17%，占比较小，其定价系市场价格。

自 2017 年 7 月出售消费电子芯片业务相关资产后，公司同成都澜至的重叠供应商共有两家，公司与该两家供应商的交易情况如下：

单位：万元

供应商名称	交易内容	2018 年度	采购占比	2017 年 8-12 月	采购占比
联华电子	晶圆采购	45.46	0.08%	23.21	0.10%
矽品科技	封测采购	1,343.95	2.28%	672.15	3.03%
合计		1,389.41	2.36%	695.36	3.13%

自 2017 年 7 月出售消费电子芯片业务相关资产后，仅有联华电子和矽品科技两家重叠的供应商，自 2017 年 8-12 月及 2018 年，公司向其采购占公司采购总额的比例合计分别为 3.13% 及 2.36%，占比较小，其定价系市场价格。

公司及成都澜至等主体同上述重叠客户与供应商均独立合作，由于双方产品和技术工艺上具有明显差异，其销售与采购均可严格划分，并根据市场化定价，不存在代垫成本费用情形，且相关销售与采购占比均较小，对公司经营不构成重大影响。

3、资产转让对公司经营的影响

此次公司出售消费电子芯片业务是公司原境外母公司 Montage Holding 为实现业务聚焦，提升运营效率而主动做出的决策，是真实的基于商业目的的转让。自 2017 年 7 月公司将消费电子芯片业务资产转让后，公司不再从事消费电子业

务。

消费电子芯片业务资产占公司整体业务规模比例较小，同时不是公司未来业务发展方向的核心重点，公司将该部分资产进行转让，不会导致公司主营业务重大变化。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均保持稳定，收入规模及盈利能力持续上升，上述资产转让并未导致公司管理混乱、人员动荡等影响持续经营能力的情形。

六、发行人以“澜起有限聚焦于服务器芯片领域、成都澜至聚焦于消费电子芯片领域”划分不存在同业竞争的措施是否有效，发行人未来是否存在收购成都澜至全部或部分股权的意图

目前公司主要产品为内存接口芯片，成都澜至主要从事消费电子芯片业务，两项业务在产品、客户销售渠道、技术及未来发展方向上均存在显著差异，双方不存在同业竞争，具体情况如下：

对比维度	具体内容	消费电子芯片业务	内存接口芯片业务
产品线与产成品	产品应用	机顶盒芯片+软件——机顶盒	内存接口芯片——内存条——计算机/服务器
	产成品类型	调谐器、解调器、接收器、解码器、Soc 芯片等机顶盒芯片	DDR2/DDR3/DDR4 等内存接口芯片
	产成品用途	机顶盒核心器件与配套软件，作用是优化机顶盒的信号处理性能和接收性能	内存条核心器件，作用是协助中央处理器存取内存数据，提升内存数据访问速度及稳定性
	功能模块	主要功能模块含射频调谐器，基频解调器，解压缩器，音视频处理器，高安处理和嵌入式 CPU	主要功能模块含高速接口，时钟同步/分配，接口校准与信号完整性优化
	产品认证	高安认证	CPU、内存、服务器厂商认证
销售渠道与客户	销售渠道	代销为主	直销为主，代销为辅
	直接客户	主要通过机顶盒芯片代销商淇诺科技、虹日科技等销售至大部分机顶盒制造厂商	主要客户包括三星电子、海力士、美光科技等
	最终用户	使用机顶盒的普通消费者	云计算及人工智能服务商

核心技术 与知识产 权	技术标准	机顶盒芯片设计技术，遵循机顶盒芯片技术标准，即广播模式下的机顶盒声音标准和影像标准，应用于广播电视的接收与影音处理，主要传输标准为DVB标准(国际通用广播模式标准)，例如DVB-C（有线），DVB-S/S2（卫星/高清卫星），DVB-T（地面波）等；主要音视频压缩标准为MPEG2/4，AVS1/2，H.264/265等（解压缩标准）	内存接口芯片技术，遵循内存接口芯片技术标准，主要为JEDEC之DDR标准，例如DDR2,DDR3,DDR4,DDR5等，应用于云计算服务器领域
	技术架构	自射频载波中提取所需频段，经模数转换后以DSP技术获得接收信号，再经解压缩还原音视频信号	自CPU获得命令和地址，完整地发送到多个内存芯片 在CPU和内存芯片之间，以较好的信号完整性执行数据的双向读写
	使用工艺	所用工艺以低功耗（LP）和低漏电（LL）工艺为主	所用工艺以高性能（G/HP）为主
业务发展 方向	业务发展 方向	主要目标为完善产品符合国际高安方案如Verimatrix，Irdeto，Conax，Nagra，NDS等进而提升产品价值	主要目标为巩固公司的市场领先地位，在未来三年完成第一代DDR5内存接口芯片的研发和产业化

综上所述，公司同成都澜至不存在同业竞争。公司致力于为云计算及人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，与成都澜至目前无业务交集。

公司目前不存在收购成都澜至全部或部分股权的意图；在本届董事会任期内，董事会亦不会发起任何收购成都澜至全部或部分股权的动议。

5.2 保荐机构、发行人律师、申报会计师的核查过程和核查结论

核查过程：

1、访谈发行人管理层和成都澜至管理层，检查发行人2016年收购澜起开曼股权和2017年消费电子芯片业务转让的决策和说明性文件，以判断两次估值存在差异的原因及合理性；

2、检查发行人消费电子芯片业务资产转让相关的评估报告、会计记录和发

行人原境外母公司 **Montage Holding** 董事会决议文件，检查评估基准日与转让资产交割日评估值的调整情况及依据，评价资产评估报告所采用的评估方法的恰当性、分成率和折现率等主要参数的合理性，从而判断资产转让定价的公允性；

3、访谈成都澜至运营人员，了解关于未完成订单及相关债权债务的承接情况，检查消费电子芯片业务相关资产、合同及人员转移，判断其是否构成业务，及相关的会计处理是否适当；

4、检查消费电子芯片业务受让方成都澜至等公司的财务报表，分析其业绩变化的原因，并与发行人消费电子芯片业务终止经营前该业务的成本费用金额及占比情况进行对比；

5、访谈了成都澜至总经理、研发工程副总裁及财务总监，对公司的主营业务和业务规模进行充分的了解，并就成都澜至的历史沿革、资产、人员、技术、主营业务等方面与发行人之间的关系进行访谈，获取并审阅了发行人与成都澜至签署的相关文件，获取并审阅了双方签署的一系列资产转让协议；获取并审阅了发行人报告期内的销售及客户明细和采购及供应商明细；

6、获取并审阅了发行人主营业务相关的核心技术名称、性质、取得方式、用途、使用情况；访谈了发行人及成都澜至相关技术人员；通过公开渠道对产品信息、行业信息等进行收集整理。获得了公司董事会出具的在本届董事会任期内不存在收购成都澜至意向的说明。

核查结论：

经核查，保荐机构、发行人律师、申报会计师认为

1、发行人收购股权及出售业务两项交易价格差异较大具有合理性；

2、出售的消费电子芯片业务应视为一项整体业务出售，采用资产基础法而非收益法进行评估是恰当的，评估价格公允，不存在价值低估和损害发行人的利益的情形；

3、出售消费电子芯片业务构成同一控制下的业务重组，发行人相关会计处理符合《企业会计准则》的相关规定；

4、消费电子芯片业务2016年及2017年业绩存在差异的原因合理，成都澜至购买消费电子芯片业务后2018年经营亏损的主要原因是研发费用的大额支出，经与发行人消费电子芯片业务终止经营前该业务的成本费用金额及占比情况对比，中介机构未发现成都澜至为发行人代垫成本费用的情形；

5、发行人出售消费电子芯片业务的相关成本费用及资产按照产品进行分摊，转让的资产与发行人已经彻底切割清楚，不存在资产共用、专利等技术共享或相互授权、人员交叉、渠道混同、平台共用的情况，该业务系真实转让，上述情况不会导致发行人主营业务重大变化或者管理混乱、人员动荡等影响持续经营能力的情形；

6、发行人同成都澜至不存在同业竞争。发行人致力于为云计算及人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，与成都澜至目前无业务交集。发行人本届董事会不存在收购成都澜至全部或部分股权的意图。

6.关于营业收入

根据问题 32 的回复，报告期内发行人营业收入快速增长，内存接口芯片随着技术迭代平均销售单价在报告期内逐步上升。

请发行人补充披露：（1）结合报告期内不同产品价格、销量情况量化分析内存接口芯片销售单价持续上升的原因，是否与竞争对手的产品价格变动趋势一致；（2）量化分析 2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价的原因，以及晶圆原材料、消费电子芯片产品等不同因素对其他业务收入单价的具体影响；（3）内存接口芯片收入持续快速增长与同行业可比公司、下游客户出货量变动趋势是否一致；（4）量化分析与主要客户销量或合同订单完成量等业务执行数据与收入确认数据的一致性；（5）结合客户情况、毛利贡献进一步分析在菲律宾地区销售大幅增长的原因及未来可持续性。

请发行人进一步说明：（1）结合产品类型对内存接口芯片在收入、成本、毛利、毛利率项下予以进一步细分，说明报告期各期各个项目变化的原因；（2）报告期内税金及附加逐年下降与收入等相关财务数据的匹配关系；（3）富昌电子的基本情况，包括成立时间、注册资本、股权结构、实际控制人或主要股东、规模、经营状况等；（4）结合内存接口芯片、消费电子芯片各自的销售模式构成，说明招股说明书中“消费电子芯片采取代销为主的销售模式，而内存接口芯片采取直销为主的销售模式”的表述与 2018 年代销收入仍然占比 20.95% 的事实是否存在矛盾。

请保荐机构、申报会计师进行核查并发表明确意见，并对首轮问询第 32 问题所列事项完整发表核查意见。

回复：

6.1 发行人说明

一、结合报告期内不同产品价格、销量情况量化分析内存接口芯片销售单价持续上升的原因，是否与竞争对手的产品价格变动趋势一致；

报告期内，公司内存接口芯片不同产品类型销量、价格情况量化分析如下表所示：

年度	产品类型		销量指数	单价指数
2016 年	DDR3 及其他		100.00	100.00
	DDR4	Gen1.0	582.47	55.15
		Gen1.5	1,123.57	58.26
		Gen2.0	125.24	111.32
		Gen2plus	-	-
		小计	1,831.28	60.87
2017 年	DDR3		75.60	102.00
	DDR4	Gen1.0	120.22	51.80
		Gen1.5	1,515.82	52.86
		Gen2.0	1,138.82	95.67
		Gen2plus	2.19	165.00
		小计	2,777.05	70.44
2018 年	DDR3		27.59	33.28
	DDR4	Gen1.0	134.45	58.95
		Gen1.5	741.67	48.73
		Gen2.0	4,154.97	78.09
		Gen2plus	73.25	150.37
		小计	5,104.34	74.37

注：以 2016 年的销售数量和平均单价为基数，基准指数为 100，报告期内各产品类型的销量指数和单价指数体现为对应 2016 年基数的增长或下降情况

由上表可知，随着技术更新和产品迭代，DDR4 世代中 Gen1.0、Gen1.5、Gen2.0、Gen2plus 产品因技术和性能升级，各子代产品平均销售单价不断提升；同时在每一子代的生命周期里，随着时间推移，销售单价逐年降低。

随着单价较高的新产品销售占比逐渐提升，报告期内内存接口芯片的平均销售单价逐年上升。其中，单价较高的 DDR4 Gen 2.0 子代产品销售数量及占比逐年上升，对报告期内内存接口芯片平均销售单价提升的影响最大。

相关数据变动异常的原因：1) 2018 年 DDR3 产品单价大幅下降主要系当年 DDR3 世代接近产品生命周期尾声且细分产品结构有所变化所致；2) 2018 年 DDR4 Gen1.0 子代产品的单价上升，主要系当年销售的产品为根据客户需求定制的产品。

由于公司无法获取竞争对手产品销售单价信息，因此无法就竞争对手的产品价格变动趋势进行有效分析。但随着技术迭代，新产品因技术先进而导致每子代产品平均销售单价有所提高符合行业惯例。

二、量化分析 2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价的原因，以及晶圆原材料、消费电子芯片产品等不同因素对其他业务收入单价的具体影响；

2017 年公司主营业务收入单价为 10.88 元，其他业务收入单价为 13.37 元。其他业务收入主要来自于公司转让消费电子芯片业务相关资产中涉及半成品、原材料的转让收入，以及房租转租收入。其他业务收入具体销售情况如下：

项目		销售金额（万元）	销售数量	销售单价（元）
半成品（颗）		1,376.96	2,425,618.00	5.68
原材料	辅料（颗）	662.58	2,980,472.00	2.22
原材料	晶圆（片）	4,791.88	3,297.00	14,534.06
房租		402.63	1	-
合计		7,234.04	5,409,388.00	13.37

由此可见，2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价主要原因是：原材料晶圆以整片销售，销售单价较高，此外房租转租收入的销售数量按照 1 计量。

三、内存接口芯片收入持续快速增长与同行业可比公司、下游客户出货量变动趋势是否一致；

1、同行业公司收入变动趋势情况如下：

公司名称	项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
Rambus	memory product(千美元)	36,400	20,300	12,900
	增长率	79.31%	57.36%	--
IDT	Memory interface products(千美元)	270,975	221,233	187,361
	增长率	22.48%	18.08%	--
公司	内存接口芯片收入（万元）	174,865	93,467	55,833
	增长率	87.09%	67.41%	--

注：IDT 的收入数据系公司根据 IDT 财年季度收入按照日历年度汇总计算所得；memory

product、Memory interface products 为引用相关公司财报分类。

同行业公司未披露销量或出货量数据，因此选取同类产品的销售金额变动情况进行比较。由于 2016 年 IDT 的内存接口芯片相关产品销售规模基数较大，2017 年和 2018 年销售同比增长率分别为 18.08%和 22.48%，增长相对平缓；Rambus 于 2017 年和 2018 年的内存接口芯片相关产品销售同比增长率分别为 57.36%和 79.31%。

公司 2017 年和 2018 年内存接口芯片销售收入增长率分别为 67.41%和 87.09%，增长率高于 Rambus 和 IDT，主要系公司凭借在 DDR4 世代内存接口芯片的技术先进性、可靠性和良好口碑，市场份额持续提升，因此报告期内公司内存接口芯片销售额快速提升。

综上所述，公司内存接口芯片收入持续快速增长与同行业可比公司销售额变动趋势基本一致。

2、下游客户销售额变动如下：

公司名称	项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
海力士	DRAM（百万韩元）	32,370,936	22,887,259	12,340,767
	增长率	41.44%	85.46%	--
美光科技	DRAM（千美元）	21,232,000	12,963,000	7,207,000
	增长率	63.79%	79.87%	--
三星电子	Semi-conductor（百万韩元）	86,290,962	74,255,595	51,157,002
	增长率	16.21%	45.15%	--
公司	内存接口芯片收入（万元）	174,865.26	93,466.80	55,832.67
	增长率	87.09%	67.41%	--

注：DRAM、Semi-conductor 为相关公司财报分类。

由于无法获取下游客户出货量详细数据，公司选取下游客户销售额进行分析，报告期内下游主要客户销售额均增长较快，2017 年海力士和美光科技 DRAM 的销售增长率分别为 85.46%和 79.87%，2018 年海力士和美光科技 DRAM 的销售增长率分别为 41.44%和 63.79%，均保持了较高速的增长，同公司内存接口芯片产品收入增长趋势总体保持一致。三星电子由于年报披露口径同其他公司存在差异且整体销售体量较大，增长相对平缓，但整体销售额保持增长趋势。

四、量化分析与主要客户销量或合同订单完成量等业务执行数据与收入确认数据的一致性；

报告期内主要客户销量与收入金额变动情况如下表所示：

客户	项目	2018 年	2017 年	2016 年
客户 A	销售收入（万元）	47,335.46	29,245.46	23,456.88
	收入变动比例	61.86%	24.68%	-
	销量增长比例	44.67%	18.37%	-
客户 B	销售收入（万元）	44,462.00	21,680.19	13,645.89
	收入变动比例	105.08%	58.88%	-
	销量增长比例	83.63%	57.56%	-
客户 C	销售收入（万元）	36,518.00	27,733.52	7,576.79
	收入变动比例	31.67%	266.03%	-
	销量增长比例	49.37%	222.62%	-

如上表所示，报告期内公司对主要客户的销售收入增速和销量增速基本保持一致，通常为销售收入增速略快于销量增速，主要原因是公司内存接口芯片平均销售单价在报告期内逐年上升。

其中，2017 年和 2018 年公司向客户 A 的销售收入同比增长率分别为 24.68% 和 61.86%，公司向客户 A 的产品销量同比增长率分别为 18.37% 和 44.67%，收入增长率略高于销量增长率，主要系产品单价逐年上升所致；2017 年和 2018 年公司向客户 B 的销售收入同比增长率分别为 58.88% 和 105.08%，公司向客户 B 的产品销量同比增长率分别为 57.56% 和 83.63%，收入增长率略高于销量增长率，也是由于产品单价逐年上升所致；2017 年和 2018 年公司向客户 C 的销售收入同比增长率分别为 266.03% 和 31.67%，公司向客户 C 的产品销量同比增长率分别为 222.62% 和 49.37%，2017 年收入增长率高于销量增长率主要系产品单价上升，2018 年收入增长率低于销量增长率主要是客户 C 的采购产品的结构占比有所变化，导致其采购产品的平均单价较 2017 年有所降低。

综上所述，公司向主要客户销售产品的数量与收入确认数据具有一致性。

五、结合客户情况、毛利贡献进一步分析在菲律宾地区销售大幅增长的原

因及未来可持续性。

报告期内公司在菲律宾地区的销售主要来源于客户 SFA semicon Philippines Corporation（为三星电子在菲律宾的委外加工厂），对该客户报告期内销售情况如下表所示：

年度	销售收入（万元）	毛利贡献率
2018 年度	13,760.43	7.49%
2017 年度	1,623.96	1.06%
2016 年度	116.89	0.10%

报告期内公司来自菲律宾地区的销售持续增长，主要系三星电子将其部分代工产能转移到菲律宾地区所致。

该地区销售在未来是否有可持续性，主要取决于三星电子对委外代工厂产能的全球布局及相关安排。公司只是根据客户的要求将产品销售到其指定区域内的委外加工厂，具体区域的变化对公司的销售无实质影响。

六、结合产品类型对内存接口芯片在收入、成本、毛利、毛利率项下予以进一步细分，说明报告期各期各个项目变化的原因；

报告期内公司内存接口芯片收入逐年上升，由于技术升级相关产品平均销售单价逐年上升造成产品平均毛利率也逐年上升。同时在每一子代的生命周期里，其销售单价逐年降低导致其毛利率逐年下降。

2016 年至 2018 年 DDR3 及其他产品收入分别为 4,595.54 万元、3,543.60 万元和 422.06 万元，DDR4 产品合计收入分别为 51,237.13 万元、89,923.20 万元和 174,443.20 万元，主要系报告期内 DDR4 世代产品已基本取代了 DDR3 世代产品所致。

同时，根据技术迭代周期，DDR4 世代中 Gen 2.0 子代产品销售收入逐年上升，分别为 6,406.75 万元、50,062.28 万元、149,127.94 万元，成为公司报告期内收入增长的主要来源，且其毛利率维持高位，分别为 73.87%、72.54%、72.33%。因此，报告期内公司的内存接口芯片特别是 DDR4 世代产品平均毛利率逐年上升。

2016年至2018年DDR3及其他产品毛利率分别为67.51%、65.90%和53.02%，毛利率逐年下降，主要系在DDR3世代具体产品生命周期进入成熟阶段后，其销售单价逐年下降所致；2016年至2018年DDR4世代产品毛利率分别为62.60%、65.84%和70.87%，毛利率逐年上升，主要系DDR4世代中各子代具体产品更新换代，新子代产品的毛利率较上一代产品更高，且单价较高的新子代产品销售收入占比逐年上升所致。

七、报告期内税金及附加逐年下降与收入等相关财务数据的匹配关系；

报告期内税金及附加详细情况如下：

单位：万元

项目	2018年	2017年	2016年
城市维护建设税	0.60	155.96	-
教育费附加	0.25	66.84	-
地方教育费附加	0.17	44.56	-
印花税	81.21	40.47	478.50
合计	82.23	307.83	478.50

公司境内主体向境外提供技术开发服务适用零税率，提供特许权使用免征增值税，向境外销售芯片产品执行出口免抵退。

公司在2016年缴纳增值税0元，2016年税金及附加478.50万元主要为2016年公司增资、收购澜起开曼所缴纳的印花税；

2017年公司境内主体应缴城市维护建设税、教育费附加(含地方)合计267.35万元，是因为公司2017年将消费电子芯片相关资产转让给成都澜至及其关联方，需要缴纳的增值税及附加。

2018年税金及附加82.23万元主要是公司因增资缴纳印花税。

公司合并口径的销售收入主要来源于境外子公司，其在境外经营时不需要缴纳增值税及附加。

综上所述，公司报告期内税金及附加逐年下降具有合理性。

八、富昌电子的基本情况，包括成立时间、注册资本、股权结构、实际控

制人或主要股东、规模、经营状况等；

报告期内与公司交易的富昌电子相关主体包括以下两家公司：

1、Future Electronics Inc.(Distribution) PTE Ltd.，其成立于 1992 年，注册资本：5,200 万新加坡元，其主要股东为 Future Electronics Inc；

2、Future Electronics Inc，其成立于 1968 年，是一家非公众公司，也是全球领先的电子元器件分销商，Future Electronics Inc 的总部设在加拿大蒙特利尔，主要股东是 Robert Miller(与公司无关联关系)，经营业务遍布全球 44 个国家 169 个办事处，全球员工数约 6500 人，2018 年收入约 65 亿美元。

九、结合内存接口芯片、消费电子芯片各自的销售模式构成，说明招股说明书中“消费电子芯片采取代销为主的销售模式，而内存接口芯片采取直销为主的销售模式”的表述与 2018 年代销收入仍然占比 20.95%的事实是否存在矛盾。

报告期内，公司分主要产品及销售模式的具体情况如下：

单位：万元

产品类别	销售模式	2018 年度		2017 年度		2016 年度	
		收入	占比	收入	占比	收入	占比
内存接口芯片	直销	138,045.67	78.94%	65,650.52	70.24%	48,036.29	86.04%
	代销	36,819.58	21.06%	27,816.28	29.76%	7,796.39	13.96%
	经销	-	-	-	-	-	-
	合计	174,865.26	100.00%	93,466.80	100.00%	55,832.67	100.00%
消费电子芯片	直销	-	-	12,492.88	58.68%	6,057.65	21.27%
	代销	-	-	8,795.66	41.31%	19,001.96	66.72%
	经销	-	-	2.48	0.01%	3,422.56	12.02%
	合计	-	-	21,291.01	100.00%	28,482.17	100.00%
津逮®津逮服务器平台	直销	901.20	100.00%	759.64	100.00%	-	-
	代销	-	-	-	-	-	-
	经销	-	-	-	-	-	-
	合计	901.20	100.00%	759.64	100.00%	-	-
合计	直销	138,946.87	79.05%	78,903.04	68.30%	54,093.94	64.16%

	代销	36,819.58	20.95%	36,611.94	31.69%	26,798.35	31.78%
	经销	0.00	0.00%	2.48	0.00%	3,422.56	4.06%
	合计	175,766.45	100.00%	115,517.46	100.00%	84,314.85	100.00%

公司内存接口芯片在报告期内的直销收入占比始终超过 70%，其中 2018 年直销收入占比 78.94%，采用直销为主的销售模式。

招股说明书中“消费电子芯片采取代销为主的销售模式，而内存接口芯片采取直销为主的销售模式”的表述与 2018 年代销收入仍然占比 20.95% 的事实不存在矛盾。

6.2 保荐机构和申报会计师的核查过程和核查结论

（一）对营业收入相关问题核查过程及核查结论

1、取得报告期内发行人产品的销售明细表，对比分析不同类型产品的销售收入、销量和价格变动及原因，询问管理层了解产品定价政策，并结合同行业主要竞争对手的情况，分析变动趋势合理性；

2、通过访谈发行人管理层和查询公开信息，了解发行人行业、主要竞争对手和产品的情况，了解发行人的行业地位、市场占有率等与发行人业务有关的情况；

3、检查发行人其他业务收入的相关合同和明细表，对比分析 2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价的原因；

4、申报会计师查询发行人适用的增值税缴纳政策，取得税务机关出具的合规证明，并根据财务数据，检查报告期内发行人是否按照税法规定申报并交纳相关的增值税、附加税和印花税等；

5、根据发行人的销售方式，检查对应的收入确认的时点是否符合会计准则的规定，采取抽样检查的方式检查销售收入对应的合同、订单、发货单、签收单、海关单据、代销商的代销清单、发票情况；

6、函证并实地走访主要代销客户、直销客户及终端客户，了解客户合作背景、销售模式、主要合同条款等情况，通过公开信息数据查询主要客户的基本信

息，确认其基本情况有无异常。

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

- 1、随着产品迭代，内存接口芯片产品的平均销售单价在报告期内稳中有升，具有合理性；
- 2、因 2017 年其他业务收入中包含消费电子芯片晶圆和房租单价高的影响，2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价，具有合理性；
- 3、发行人内存接口芯片收入持续快速增长与同行业可比公司、下游客户销售额变动趋势基本一致；
- 4、发行人收入确认数据与主要客户销量等业务执行数据一致；
- 5、发行人在菲律宾地区销售大幅增长的原因具有合理性，该地区销售在未来是否有可持续性，主要取决于三星电子对委外代工厂产能的全球布局及相关安排；
- 6、报告期内发行人内存接口芯片各代产品的收入、成本、毛利和毛利率的变化具有合理性；
- 7、发行人披露的富昌电子的基本情况真实、准确；
- 8、发行人内存接口芯片 2018 年直销收入占比 78.94%，采用直销为主的销售模式，与招股说明书中“消费电子芯片采取代销为主的销售模式，而内存接口芯片采取直销为主的销售模式”的表述不存在矛盾。

（二）对于首轮问询第 32 问题所列事项核查过程及核查意见

保荐机构和申报会计师对首轮问询第 32 题所列事项执行了以下核查程序：

- 1、了解并检查发行人销售相关的流程和内部控制，对发行人的销售相关的关键环节控制执行穿行测试，检查发行人销售相关的内部控制制度是否健全有效；
- 2、对发行人报告期内的主要代销客户、直销客户及终端客户执行函证程序和实地走访，了解客户合作背景、销售模式、主要合同条款等情况，通过公开信息数据查询主要客户的基本信息，确认其基本情况有无异常。

3、通过访谈发行人管理层和查询公开信息，了解发行人行业、主要竞争对手和产品的情况，了解发行人的行业地位、市场占有率等与发行人业务有关的情况；

4、检查发行人其他业务收入的相关合同和明细表，对比分析 2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价的原因；

5、根据发行人的销售方式，检查对应的直销和代销模式收入确认的时点是否符合会计准则的规定，采取抽样检查的方式检查销售收入对应的合同、订单、发货单、签收单、海关单据、代销商的代销清单、发票情况，检查客户的期后回款情况，不存在第三方回款的情形，检查会计期末前后的出入库单、运输单据等业务单据，对收入和存货进行截止性检查；

6、取得报告期内发行人产品的销售明细表，对收入进行分析性复核程序，对比分析不同销售模式、不同产品的销售收入、销量和价格变动及原因，询问管理层了解产品定价政策，并结合同行业主要竞争对手的情况，分析变动趋势合理性；

7、对比分析报告期内发行人不同地区收入变化及其原因，不同产品销量及收入变动趋势及原因，分析发行人各个季度收入金额及变动，判断收入是否存在季节性波动，分析前五名客户收入金额及占比，询问管理层对单一客户是否构成重大依赖及原因。

经核查，保荐机构和申报会计师认为：

1、报告期内发行人由于产品迭代，销售单价持续上升具有合理性；

2、因 2017 年其他业务收入中包含消费电子芯片晶圆和房租单价高的影响，2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价，具有合理性；

3、报告期内发行人不同产品销量、价格变动和营业收入变动趋势一致，其中，内存接口芯片中销量增长对内存接口芯片营业收入变动影响大，消费电子芯片业务中价格下降对消费电子芯片营业收入影响大；

4、报告期内发行人披露的直销、代销、经销收入及占主营业务收入的比例

情况与中介机构了解的情况一致；

5、发行人采用代销模式具有合理的原因，披露的代销商基本情况、代销协议的有关规定与中介机构了解的情况一致；因 2018 年末，经美光科技与发行人、富昌电子协商确定，后续由发行人直销给美光科技，从而结束代销，代销业务的会计处理原则及符合企业会计准则的规定；

6、发行人韩国地区销售收入在报告期内先下降再大幅增长的原因具有合理性；

7、发行人收入确认数据与主要客户销量、订单完成量等业务执行数据一致，未发现报告期内经销商和发行人存在关联关系等异常情况；

8、发行人一季度销售金额相对其它季度较低，下半年销售金额比上半年销售金额相对较高，主要原因是受下游行业周期性及季节性需求波动影响；

9、2018 年，公司前五大客户中任一客户占公司营业总收入的比重均未超过 30%，不存在对单一大客户重大依赖的情形，发行人不存在严重依赖少数客户的情况的表述准确。

6.3 补充披露情况

发行人在招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司销售情况”之“（二）销量及价格变动情况”进行补充披露：

随着技术更新和产品迭代，DDR4 世代中 Gen1.0、Gen1.5、Gen2.0、Gen2plus 产品因技术和性能升级平均销售单价有所提高；同时在每一子代的生命周期里，随着时间推移，销售单价逐年降低。

随着单价较高的新产品销售占比逐渐提升，报告期内内存接口芯片的平均销售单价逐年上升。其中，单价较高的 DDR4 Gen 2.0 子代产品销售数量占比逐年上升，对报告期内内存接口芯片平均销售单价提升的影响最大。

发行人在招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、公司销售情况”之“（二）销量及价格变动情况”中补充披露如下：

2017 年公司主营业务收入单价为 10.88 元，其他业务收入单价为 13.37 元。

其他业务收入主要来自于公司转让消费电子芯片业务相关资产中涉及半成品、原材料的转让收入，以及房租转租收入。其他业务收入具体销售情况如下：

项目		销售金额（万元）	销售数量	销售单价（元）
半成品（颗）		1,376.96	2,425,618.00	5.68
原材料	辅料（颗）	662.58	2,980,472.00	2.22
原材料	晶圆（片）	4,791.88	3,297.00	14,534.06
房租		402.63	1	-

由此可见，2017 年其他业务收入的单价高于主营业务收入单价主要原因是：原材料晶圆以整片销售，销售单价较高，此外房租转租收入的销售数量按照 1 计量。

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析”之“（一）营业收入结构及趋势分析 4、营业收入国家和地区分布”中补充披露如下：

公司在菲律宾地区的销售主要来源于客户 SFA semicon Philippines Corporation，该客户为三星电子在菲律宾的委外加工厂。

7.关于成本

根据回复材料,由于技术架构及工艺不同,公司的内存接口芯片成本构成中封装测试占比较大,消费电子芯片成本构成中晶圆占比较大。2017 年 7 月公司转让消费电子芯片业务后晶圆等直接材料的成本占比呈下降趋势,封装测试的成本占比呈上升趋势。

请发行人在问题 27 回复及相关信息披露之报告期内晶圆、封装测试采购前五名供应商情况表中增加“占该类产品采购总额比例”一列,并补充披露 2018 年向供应商 H 集中采购晶圆、向供应商 L 集中采购封装测试的原因及合理性,充分揭示晶圆、封装测试供应商高度集中的风险。

请发行人进一步说明:(1)内存接口芯片、消费电子芯片的成本要素构成情况,分别量化分析报告期内生产成本中直接材料、封装测试、制造费用的变动情况与产品销量的匹配性,结合各自的封装测试成本量化分析报告期内封装测试成本占比逐期上升的原因及合理性;(2)内存接口芯片、消费电子芯片产量与各期采购及消耗原材料数量的匹配关系。

请保荐机构、申报会计师进行核查,并发表明确意见。

回复:

7.1 发行人说明

一、请发行人在问题 27 回复及相关信息披露之报告期内晶圆、封装测试采购前五名供应商情况表中增加“占该类产品采购总额比例”一列,并补充披露 2018 年向供应商 H 集中采购晶圆、向供应商 L 集中采购封装测试的原因及合理性,充分揭示晶圆、封装测试供应商高度集中的风险。

1、报告期内晶圆采购前五名供应商情况

单位:万元

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	占晶圆采购总额比例
2018 年度	供应商 H	17,532.17	29.68%	90.16%
	供应商 I	1,868.21	3.16%	9.61%
	供应商 R	45.46	0.08%	0.23%

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	占晶圆采购总额比例
	小计	19,445.85	32.92%	100.00%
2017 年度	供应商 H	14,944.85	25.29%	63.30%
	供应商 Q	5,713.91	9.67%	24.20%
	供应商 R	2,668.49	4.52%	11.30%
	供应商 I	283.51	0.48%	1.20%
	小计	23,610.77	39.96%	100.00%
2016 年度	供应商 Q	15,938.22	32.18%	59.94%
	供应商 H	10,143.39	20.48%	38.15%
	供应商 R	316.03	0.64%	1.19%
	供应商 I	192.91	0.39%	0.73%
	小计	26,590.55	53.68%	100.00%

注：上述晶圆采购金额不包括流片费用，报告期内公司合作的晶圆厂仅有富士通电子、联华电子、台积电、中芯国际（以上按拼音首字母排序）四家

2、报告期内封装测试采购前五名供应商情况

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	占封装测试采购总额比例
2018 年度	供应商 L	28,358.35	48.01%	95.46%
	供应商 K	1,343.95	2.28%	4.52%
	供应商 S	7.14	0.01%	0.02%
	小计	29,709.44	50.30%	100.00%
2017 年度	供应商 L	20,376.03	34.48%	84.74%
	供应商 K	3,612.85	6.11%	15.02%
	供应商 T	53.89	0.09%	0.22%
	供应商 U	4.27	0.01%	0.02%
	供应商 V	0.90	0.00%	0.00%
	小计	24,047.95	40.70%	100.00%
2016 年度	供应商 L	12,127.82	24.48%	65.10%
	供应商 K	6,501.00	13.12%	34.90%
	小计	18,628.81	37.61%	100.00%

注：报告期内公司合作的封测厂包括 Raytek Semiconductor, Inc、深圳市小瑞科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、星科金朋、矽品科技、中芯长电半导体（江阴）有限公司（以上按拼音首字母排序）

2018 年向供应商 H 集中采购晶圆主要由于：（1）由于公司转让了消费电子芯片业务相关资产，晶圆采购总额减少，同时 2018 年公司与原先仅为消费电子芯片提供晶圆代工的供应商不再进行交易，因此集中度有所上升；（2）晶圆制造企业投入巨大，除了 IDM 企业能够自建晶圆生产线自用之外，全球仅有少数企业具备实力建设用于代工的晶圆生产线，因此晶圆采购集中具有行业普遍性和商业合理性；（3）供应商 H 的晶圆加工在全球居于领先地位，拥有先进的晶圆生产线，制造工艺满足公司对晶圆代工的要求；（4）公司与供应商 H 自 2006 年开始合作，已经建立深厚的合作关系；（5）为实现规模经济效益，公司向供应商 H 进行集中采购。

2018 年向供应商 L 集中采购封装测试的原因：（1）由于公司转让了消费电子芯片业务相关资产，2018 年公司与原先仅为消费电子芯片提供封装测试的供应商不再进行交易，因此集中度有所上升；（2）封装测试同晶圆制造一样均为资本与技术密集型产业，需要投入大量资源建设，因此封装测试采购集中具有行业普遍性和商业合理性；（3）公司对封装要求较高，供应商 L 为国际领先的封测供应商，封测工艺满足公司需求；（4）公司与供应商 L 自 2006 年开始合作，建立了良好的合作关系；（5）为实现规模经济效益，公司向供应商 L 进行集中采购。公司的主要供应商均为国际领先的晶圆代工及封测供应商，与公司保持了良好的合作关系，具备稳定性及可持续性，且公司晶圆代工及封装测试供应商至少各保持两家及以上，可以根据公司需求切换供应商，不会对个别供应商产生依赖。对其中部分供应商采购金额较为集中主要是在供应链安全的前提下，通过规模采购提升议价能力，降低采购成本，提升规模经济效益。

同时，发行人也在不断认证新的合格供应商，降低供应商集中度较高的潜在风险。

公司在招股说明书“第四节 风险因素”之“二、经营风险”之“（二）供应商风险”中补充披露：

此外，晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。报告期内，公司晶圆代工主要委托富士通电子和台积电进行，公司封装测试主要委托星科金朋和矽品科技进行，供应商集中度较高。如果上述供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能

紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

二、内存接口芯片、消费电子芯片的成本要素构成情况，分别量化分析报告期内生产成本中直接材料、封装测试、制造费用的变动情况与产品销量的匹配性，结合各自的封装测试成本量化分析报告期内封装测试成本占比逐期上升的原因及合理性；

1、报告期内主要产品生产成本中的直接材料、封装测试、制造费用变动情况与产品销量匹配性如下表所示：

产品类型	项目		2018 年	2017 年	2016 年
内存接口芯片	销量（万颗）		9,641.88	5,359.57	3,628.48
	销量变动比例		79.90%	47.71%	-
	直接材料	金额（万元）	19,948.15	12,110.51	7,778.72
		变动比例	64.72%	55.69%	-
	封装测试	金额（万元）	28,979.03	17,851.17	12,330.07
		变动比例	62.34%	44.78%	-
	制造费用	金额（万元）	2,093.88	1,967.09	548.52
		变动比例	6.45%	258.62%	-
消费电子芯片	销量（万颗）		-	5,256.34	5,004.00
	销量变动比例		-	5.04%	-
	直接材料	金额（万元）	-	13,276.43	15,466.14
		变动比例	-	-14.16%	-
	封装测试	金额（万元）	-	3,910.04	4,398.14
		变动比例	-	-11.10%	-
	制造费用	金额（万元）	-	167.87	529.71
		变动比例	-	-68.31%	-

根据上表所示，2017 年和 2018 年内存接口芯片的销量同比增长率分别为 47.71%和 79.90%，生产成本中直接材料增长率分别为 55.69%和 64.72%，封装测试增长率分别为及 44.78%和 62.34%，生产成本中的直接材料和封装测试变动情况与产品销量变动情况基本一致，2017 年制造费用增长 258.62%，主要原因系公司为节约成本，自 2017 年开始将部分产品检测由委外改为公司租用设备自己检

测所致，2018 年公司制造费用同 2017 年相比基本保持稳定；

消费电子芯片生产成本中直接材料、封装测试、制造费用与销量变动比例有所差异，主要因 2017 年 7 月公司出售消费电子业务相关资产，其中包括销售已计提存货跌价准备的产品，导致相关成本因转销而冲回。如果模拟加回相关转销成本，相关匹配性情况如下：

产品类型	项目		2017 年	2016 年
消费电子芯片	销量（万颗）		5,256.34	5,004.00
	销量变动比例		5.04%	-
	直接材料	金额（万元）	16,224.18	15,466.14
		变动比例	4.90%	-
	封装测试	金额（万元）	4,646.98	4,398.14
		变动比例	5.66%	-

由上表可知，剔除转销造成的影响，2017 年公司消费电子芯片相关成本变动情况与产品销量基本匹配。

2、报告期内封装测试成本占比逐期上升的原因及合理性

单位:万元

产品类别	项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
内存接口芯片	封装测试	28,979.03	17,851.17	12,330.07
	内存接口芯片成本	51,021.05	31,928.76	20,657.30
	占比	56.80%	55.91%	59.69%
消费电子芯片	封装测试	-	3,910.04	4,398.14
	消费电子芯片成本	-	17,354.33	20,393.99
	占比	-	22.53%	21.57%
合计	封装测试	28,979.03	21,761.21	16,728.21
	主营业务成本	51,773.40	49,861.19	41,051.29
	占比	55.97%	43.64%	40.75%

由上表可知，2016 年至 2018 年内存接口芯片封装测试成本占比分别为 59.69%、55.91%和 56.80%，2016 年和 2017 年消费电子芯片封装测试成本分别为 21.57%和 22.53%，总体保持稳定。由于产品技术和工艺要求不同，相比消费

电子芯片，内存接口芯片的封装测试成本占比相对较高。随着内存接口芯片收入和销售占比的不断提升，封装测试成本在报告期内占比 40.75%、43.54% 和 55.97%，逐期上升，具有合理性。

三、内存接口芯片、消费电子芯片产量与各期采购及消耗原材料数量的匹配关系。

产品类型	项 目	2018 年	2017 年	2016 年
内存接口芯片	芯片产量（颗）	91,217,015	57,808,563	34,932,458
	变动比例	57.79%	65.49%	-
	晶圆采购量指数	262.96	198.34	100.00
	变动比例	32.58%	98.34%	-
	晶圆耗用量指数	241.18	195.99	103.43
	变动比例	23.05%	89.50%	-
消费电子芯片	芯片产量（颗）	-	34,185,166	50,463,384
	变动比例	-	-32.26%	-
	晶圆采购量指数	-	138.13	290.64
	变动比例	-	-52.47%	-
	晶圆耗用量指数	-	148.63	293.22
	变动比例	-	-49.31%	-

注：以 2016 年的晶圆采购量为基数，基准指数为 100，报告期内各产品的晶圆采购量指数和晶圆耗用量指数体现为对应 2016 年基数的增长或下降情况

公司芯片产品的主要原材料为晶圆，由于芯片生产制造需要一定周期，从晶圆采购、消耗到完成芯片封测存在一定的时间差，但基本变动趋势一般应保持一致。

2017 年和 2018 年公司内存接口芯片对应的晶圆采购数量增长率为 98.34% 和 32.58%，晶圆耗用数量增长率分别为 89.50% 和 23.05%，芯片产量增长率分别为 65.49% 和 57.79%，内存接口芯片采购及消耗晶圆数量与内存接口芯片产量保持同向增长趋势。

2017 年消费电子芯片对应的晶圆采购量同比下降 52.47%，晶圆耗用量同比下降 49.31%，芯片产量下降 32.36%，采购及消耗晶圆数量与消费电子芯片产量保持均呈现下降趋势，主要系公司于 2017 年 7 月出售消费电子芯片相关资产后

不再进行消费电子芯片相关的采购和生产所致。

7.2 保荐机构和申报会计师的核查过程和核查结论

核查过程：

1、获取发行人报告期内各年度的采购明细，对报告期发行人对供应商包括前五名供应商的采购数量及金额进行函证，重点关注前五名供应商的变化及其原因，询问管理层与供应商合作的稳定性及可持续性，并与会计记录进行比对，询问管理层是否对前五大供应商形成依赖及判断原因；

2、抽取样本核查主要供应商的采购合同、采购订单、采购发票、付款凭证等原始单据，了解采购的内容及主要产品的采购价格；

3、通过公开信息查询发行人供应商的基本信息，重点关注股东结构、规模及成立时间，检查是否与发行人存在关联关系。现场走访发行人的主要供应商，与中介机构了解的与发行人的合作历史、合作内容、定价原则及结算条款、是否存在关联交易、是否存在潜在的利益安排等情形进行核对；

4、获取发行人不同产品的销量和成本变动的分析，结合产品销售数量、成本构成情况分析变动趋势是否合理；

5、获取发行人存货生产情况，结合存货采购、生产、销售情况分析变动趋势是否合理；

核查结论：

经核查，保荐机构和申报会计师认为，发行人披露的与采购相关的内容与中介机构了解的情况一致；发行人对个别供应商采购集中具有行业普遍性和商业合理性，晶圆、封装测试供应商高度集中的风险已在招股书“第四节 风险因素”之“二、经营风险”之“（二）供应商风险”中补充披露；报告期内生产成本中直接材料、封装测试、制造费用的变动情况与产品销量相匹配；报告期内，随着内存接口芯片收入和销售占比的不断提升，封装测试成本占比在报告期内逐期上升，具有合理性；内存接口芯片、消费电子芯片产量与各期采购及消耗原材料数量匹配。

7.3 补充披露情况

发行人在招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、公司采购情况”之“（二）报告期内前五大供应商采购情况”进行补充披露：

报告期内，发行人晶圆和封装测试供应商情况如下：

1、报告期内晶圆采购前五名供应商情况

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	占晶圆采购总额比例
2018 年度	供应商 H	17,532.17	29.68%	90.16%
	供应商 I	1,868.21	3.16%	9.61%
	供应商 R	45.46	0.08%	0.23%
	小计	19,445.85	32.92%	100.00%
2017 年度	供应商 H	14,944.85	25.29%	63.30%
	供应商 Q	5,713.91	9.67%	24.20%
	供应商 R	2,668.49	4.52%	11.30%
	供应商 I	283.51	0.48%	1.20%
	小计	23,610.77	39.96%	100.00%
2016 年度	供应商 Q	15,938.22	32.18%	59.94%
	供应商 H	10,143.39	20.48%	38.15%
	供应商 R	316.03	0.64%	1.19%
	供应商 I	192.91	0.39%	0.73%
	小计	26,590.55	53.68%	100.00%

注：上述晶圆采购金额不包括流片费用，报告期内公司合作的晶圆厂仅有富士通电子、联华电子、台积电、中芯国际（以上按拼音首字母排序）四家

2、报告期内封装测试采购前五名供应商情况

单位：万元

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	占封装测试采购总额比例
2018 年度	供应商 L	28,358.35	48.01%	95.46%
	供应商 K	1,343.95	2.28%	4.52%
	供应商 S	7.14	0.01%	0.02%
	小计	29,709.44	50.30%	100.00%

年度	供应商名称	采购金额	占采购总额比例	占封装测试采购总额比例
2017 年度	供应商 L	20,376.03	34.48%	84.74%
	供应商 K	3,612.85	6.11%	15.02%
	供应商 T	53.89	0.09%	0.22%
	供应商 U	4.27	0.01%	0.02%
	供应商 V	0.90	0.00%	0.00%
	小计	24,047.95	40.70%	100.00%
2016 年度	供应商 L	12,127.82	24.48%	65.10%
	供应商 K	6,501.00	13.12%	34.90%
	小计	18,628.81	37.61%	100.00%

注：报告期内公司合作的封测厂包括 Raytek Semiconductor, Inc、深圳市小瑞科技股份有限公司、通富微电子股份有限公司、星科金朋、矽品科技、中芯长电半导体（江阴）有限公司（以上按拼音首字母排序）

2018 年向供应商 H 集中采购晶圆主要由于：（1）由于公司转让了消费电子芯片业务相关资产，晶圆采购总额减少，同时 2018 年公司与原先仅为消费电子芯片提供晶圆代工的供应商不再进行交易，因此集中度有所上升；（2）晶圆制造企业投入巨大，除了 IDM 企业能够自建晶圆生产线自用之外，全球仅有少数企业具备实力建设用于代工的晶圆生产线，因此晶圆采购集中具有行业普遍性和商业合理性；（3）供应商 H 的晶圆加工在全球居于领先地位，拥有先进的晶圆生产线，制造工艺满足公司对晶圆代工的要求；（4）公司与供应商 H 自 2006 年开始合作，已经建立深厚的合作关系；（5）为实现规模经济效益，公司向供应商 H 进行集中采购。

2018 年向供应商 L 集中采购封装测试的原因：（1）由于公司转让了消费电子芯片业务相关资产，2018 年公司与原先仅为消费电子芯片提供封装测试的供应商不再进行交易，因此集中度有所上升；（2）封装测试同晶圆制造一样均为资本与技术密集型产业，需要投入大量资源建设，因此封装测试采购集中具有行业普遍性和商业合理性；（3）公司对封装要求较高，供应商 L 为国际领先的封测供应商，封测工艺满足公司需求；（4）公司与供应商 L 自 2006 年开始合作，建立了良好的合作关系；（5）为实现规模经济效益，公司向供应商 L 进行集中采购。

公司在招股说明书“第四节 风险因素”之“二、经营风险”之“（二）供

应商风险”中补充披露：

此外，晶圆制造、封装测试均为资本及技术密集型产业，因此相关行业集中度较高，是行业普遍现象。报告期内，公司晶圆代工主要委托富士通电子和台积电进行，公司封装测试主要委托星科金朋和矽品科技进行，供应商集中度较高。如果上述供应商发生不可抗力的突发事件，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

8.关于存货

报告期内，发行人存货规模逐期减少，存货跌价准备计提比例逐期上升。

请发行人补充披露：（1）结合不同产品的生产周期、交货周期，分析报告期内营业收入快速增长同时存货规模逐期减少的原因及合理性；（2）2018 年发出商品大幅减少的原因及合理性，是否存在提前确认收入情形；（3）根据主要具体产品的更新换代周期、各类存货的构成及库龄情况、内存接口芯片各代产品的库存及市场需求情况等，分析计提存货跌价准备的原因，目前存货跌价准备计提政策是否适当，对比当期计提情况以及期后转回情况，说明存货跌价准备计提是否充分；（4）结合发行人产品销售周期、委托加工下单和加工周期，说明委托加工物资跌价准备余额较大且逐期大幅增长的原因及合理性。

请发行人进一步说明：（1）内存接口芯片各代产品在报告期内的产销量情况；（2）报告期内报废产品的金额及占比，以及相关会计处理方式。

请保荐机构、申报会计师进行核查，并发表明确意见。

回复：

8.1 发行人说明

一、结合不同产品的生产周期、交货周期，分析报告期内营业收入快速增长同时存货规模逐期减少的原因及合理性

报告期内，公司主要产品系内存接口芯片和消费电子芯片，采取 Fabless 的生产模式，公司的委外供应商是晶圆制造商和封装测试商，晶圆制造约 2-3 个月，封装测试约 2-3 周。

公司交货周期较快，一般客户下单后一个月交货，但为保证供货的稳定性，客户会提前向公司提供最近六个月的采购预测数据，以方便公司提前备货。

1、各报告期末，公司分产品类别的存货规模情况如下：

单位：万元

产品类型	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
内存接口芯片	18,259.40	21,739.32	17,814.67
消费电子芯片	-	-	16,317.21
津逮®服务器平台	1,884.31	23.10	-

产品类型	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
合计	20,143.71	21,762.42	34,131.88

2、报告期内存货周转率情况如下：

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
存货周转率	4.09	2.94	1.61

2016 年和 2017 年，公司存货期末余额分别为 34,131.88 万元和 21,762.42 万元，2017 年较 2016 年下降 12,369.46 万元，其主要原因系公司将消费电子芯片业务相关的存货转让给成都澜至及其关联方，2016 年底消费电子芯片存货金额合计 16,317.21 万元。同时，公司内存接口芯片业务增长迅速，公司积极备货，2017 年内存接口芯片存货余额 21,739.32 万元较 2016 年内存接口芯片存货余额 17,814.67 万元增加了 3,924.65 万元。

2018 年，公司存货期末余额为 20,143.71 万元，2018 年末较 2017 年末存货余额下降 1,618.71 万元，主要系公司根据产品的生产周期和交货周期对存货进行优化管理。公司会根据客户采购预测数据和实际订单情况制定备货计划，在满足按时向客户交货的同时，通过加强存货管理，控制库存，从而提高存货周转率。同时，公司 2018 年下半年销售收入为 104,853.37 万元，同比增长 103.62%，对库存消耗较大。综合上述两个原因，从而导致内存接口芯片业务相关存货期末金额下降。

综上所述，报告期内公司营业收入快速增长同时存货规模逐期减少具备合理性。

二、2018 年发出商品大幅减少的原因及合理性，是否存在提前确认收入情形

公司发出商品系代销模式下公司已发给代销商，但代销商未销售至最终客户的存货部分。2016 年、2017 年和 2018 年，公司各期末发出商品金额分别为 2,349.50 万元、2,211.10 万元和 62.11 万元。公司 2018 年末发出商品金额大幅下降主要原因如下：

2018 年，公司内存接口芯片业务的主要代销商为富昌电子，富昌电子是最终客户美光科技指定的与公司合作的代销商（买方代理）。经过多年合作，公司已成为美光科技合格供应商。2018 年末美光科技经与公司、富昌电子协商确定，后续由公司直销给美光科技，从而结束与富昌电子的代销关系。因此，2018 年末开始，公司直接将内存接口芯片发货给美光科技，公司不再向代销商富昌电子继续发货，且存

放在富昌电子的产品基本已经销售给美光科技，导致公司 2018 年末发出商品大幅下降。综上，发出商品金额大幅减少具有合理性。

在代销模式下，公司严格按照代销商将产品销售给最终客户并取得代销清单后才确认收入，不存在提前确认收入的情况。

三、根据主要具体产品的更新换代周期、各类存货的构成及库龄情况、内存接口芯片各代产品的库存及市场需求情况等，分析计提存货跌价准备的原因，目前存货跌价准备计提政策是否适当，对比当期计提情况以及期后转回情况，说明存货跌价准备计提是否充分

公司按照存货成本与可变现净值孰低的方法确认期末存货跌价准备金额。在具体计算减值时，公司是用预计未来售价减去可对外进行销售的最终产品成本。预计未来售价主要是参考报告期次月的实际对外销售售价、销售订单约定价格、市场询价等。

报告期内，公司产品为内存接口芯片、消费电子芯片和津逮®服务器平台。公司消费电子芯片和内存接口芯片迭代周期较短，时间一般为 18-24 个月，该类型产品计提存货跌价准备主要系更新迭代后，老一代产品销量和售价下降，公司对其计提跌价准备。津逮®服务器平台系公司于 2018 年底研发成功，报告期内存货主要为工程品，存货成本高于可变现净值，故对其进行减值。

1、报告期内，公司各类存货的构成和库龄情况如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日											
	6 个月以内			6-12 个月			12-18 个月			18 个月以上		
	存货余额	跌价准备	计提比例	存货余额	跌价准备	计提比例	存货余额	跌价准备	计提比例	存货余额	跌价准备	计提比例
内存接口芯片	12,103.63	1,935.26	15.99%	155.57		0.00%	1,603.67	1,492.66	93.08%	4,396.54	4,389.04	99.83%
消费电子芯片	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
津逮®服务器平台	1,884.31	259.40	13.77%				-	-	-	-	-	-
合计	13,987.94	2,194.66	15.69%	155.57		0.00%	1,603.67	1,492.66	93.08%	4,396.54	4,389.04	99.83%
项目	2017 年 12 月 31 日											
	6 个月以内			6-12 个月			12-18 个月			18 个月以上		
	存货余额	跌价准备	计提比例	存货余额	跌价准备	计提比例	存货余额	跌价准备	计提比例	存货余额	跌价准备	计提比例
内存接口芯片	15,664.97	2,887.94	18.44%	645.22	241.62	37.45%	518.42	472.46	91.13%	4,910.71	4,909.10	99.97%
消费电子芯片		-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
津逮®服务器平台	23.1	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	15,688.07	2,887.94	18.41%	645.22	241.62	37.45%	518.42	472.46	91.13%	4,910.71	4,909.10	99.97%

项目	2016 年 12 月 31 日											
	6 个月以内			6-12 个月			12-18 个月			18 个月以上		
	存货余额	跌价准备	计提比例	存货余额	跌价准备	计提比例	存货余额	跌价准备	计提比例	存货余额	跌价准备	计提比例
内存接口芯片	9,340.36	282.69	3.03%	899.23	2.53	0.28%	4,221.14	881.52	20.88%	3,353.94	3,353.94	100.00%
消费电子芯片	8,369.64	-	0.00%	3,198.89	3.98	0.12%	821.39	76.05	9.26%	3,927.28	3,924.23	99.92%
津逮®服务器平台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	17,710.00	282.69	1.60%	4,098.12	6.51	0.16%	5,042.53	957.57	18.99%	7,281.22	7,278.18	99.96%

报告期内，公司基于产品 18-24 个月的迭代周期，对库龄超过 18 个月的存货基本全额计提跌价准备。对 18 个月以内的存货根据各代产品的市场预期和售价变化，对可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。

(1) 2016 年、2017 年和 2018 年，库龄 12-18 个月的存货计提比例分别是 18.99%、91.13%和 93.08%，主要是由于 2016 年 DDR4 Gen1.0 子代和 DDR4 Gen1.5 子代产品仍在生命周期内，计提比例较低，2017 年和 2018 年随着产品迭代，引起 DDR4 Gen1.0 子代和 DDR4 Gen1.5 子代产品销量和可变现净值大幅下降，从而存货跌价准备计提比例逐年提高。

(2) 2016 年、2017 年和 2018 年，公司库龄 6-12 月的存货计提比例 0.16%、37.45%和 0.00%。其中，2017 年计提比例较大主要系 2017 年库龄 6-12 月存货中 DDR4 Gen1.0 子代产品较多，而销量及可变现净值下降，计提比例较高。

(3) 2016 年、2017 年和 2018 年，公司库龄 6 个月以内的存货计提比例分别为 1.60%、18.41%和 15.69%，一般该库龄存货计提比例较低，但 2017 年和 2018 年存在部分 DDR4 Gen1.0 子代和 DDR4 Gen1.5 子代产品存货，因以上两子代产品逐步进入生命周期末端，其销量迅速减少且单价迅速降低，可变现净值较低，因此对其计提了跌价准备。

2、内存接口芯片各代产品的库存数量与市场需求（销量）的匹配情况如下：

年度	产品型号		销量/库存
2016 年	DDR3 及其他		1.92
	DDR4	Gen1.0	0.41
		Gen1.5	1.77
		Gen2.0	0.75
		Gen2plus	
		小计	0.83
2017 年	DDR3		2.59
	DDR4	Gen1.0	0.1
		Gen1.5	1.14
		Gen2.0	1.48
		Gen2plus	0.13

年度	产品型号		销量/库存
		小计	0.83
2018 年	DDR3		0.93
	DDR4	Gen1.0	0.13
		Gen1.5	1.16
		Gen2.0	2.16
		Gen2plus	0.31
		小计	1.32

公司报告期内，当年主要销售产品销量库存比普遍较高，2016 年主要销售产品为 Gen1.5，销量库存比 1.77；2017 年主要销售产品为 Gen1.5 和 Gen2.0，其销售库存比分别为 1.14、1.48；2018 年主要销售产品为 Gen2.0，其销售库存比为 2.16。随着技术迭代，上一代产品销量逐渐下降，相关销量库存比下降。这时，公司会根据具体产品可变现净值是否低于成本，计提相应跌价准备。

3、报告期内，公司内存接口芯片各代产品期末存货跌价准备计提情况分析

报告期内，公司内存接口芯片各代产品的库存金额及跌价准备具体情况如下：

单位：万元

产品型号	2018 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日			2016 年 12 月 31 日		
	库存金额	跌价准备	存货跌价比例	库存金额	跌价准备	存货跌价比例	库存金额	跌价准备	存货跌价比例
DDR3 及其他	1,059.68	888.06	83.80%	1,051.23	807.38	76.80%	1,633.30	1,075.23	65.83%
Gen 1.0	4,197.52	4,197.52	100.00%	6,538.17	6,000.63	91.78%	9,002.06	3,357.58	37.30%
Gen 1.5	2,731.01	2,731.01	100.00%	7,123.15	1,702.88	23.91%	5,769.95	87.86	1.52%
Gen 2.0	8,755.70	0.36	0.00%	6,904.32	0.24	0.00%	1,409.35	-	0.00%
Gen 2plus	1,515.50	-	0.00%	122.45	-	0.00%	-	-	-
DDR4 小计	17,199.72	6,928.89	40.28%	20,688.08	7,703.74	37.24%	16,181.37	3,445.44	21.29%
合计	18,259.40	7,816.97	42.81%	21,739.32	8,511.12	39.15%	17,814.67	4,520.68	25.38%

2016 年、2017 年和 2018 年，公司 DDR3 及其他产品、DDR4 Gen 1.0 子代和 DDR4 Gen 1.5 子代的存货跌价计提比例逐年上升，主要系技术迭代，相关产品接近生命周期尾声，公司根据市场情况对滞销产品计提了充分的存货跌价准备。

2016 年、2017 年和 2018 年，公司 DDR4 Gen 2.0 子代和 DDR4 Gen 2plus 子代产品是公司的新产品，目前处于上升期，市场需求量较大，销量较好，不需要计提存货跌价准备。

4、报告期内，公司存货跌价准备计提及期后转回情况

报告期内，公司存货跌价准备计提情况以及期后转回情况如下所示：

单位：万元

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	计提	转回	计提	转回	计提	转回
消费电子芯片	-	-	-	3,684.69	2,005.65	443.01
内存接口芯片	899.01	2,121.27	4,896.10	358.15	3,520.21	467.39
津逮®服务器平台	235.10	-	-	-	-	-
合计	1,134.11	2,121.27	4,896.10	4,042.84	5,525.86	910.40

2016 年、2017 年和 2018 年，公司计提的存货跌价准备金额分别为 5,525.86 万元、4,896.10 万元和 1,134.11 万元，公司计提的存货跌价准备报告期内逐渐下降，主要是因公司已根据市场情况对因技术迭代而滞销商品计提了充分的存货跌价准备，因此报告期内计提金额不断下降。

公司存货跌价准备的转回是由于销售转回造成的，存货跌价准备在 2017 年度转销 4,042.84 万元，金额较大，主要是由于 2017 年消费电子芯片业务相关存货全部销售给成都澜至等公司，公司将该业务相关的存货跌价准备在 2017 年全部转回所致。

2016 年、2017 年和 2018 年，内存接口芯片的转回金额分别是 467.39 万元、358.15 万元及 2,121.27 万元，其中 2016 和 2017 年金额较小，且变化不大。2018 年转回 2,121.27 万元，是因为客户由于特殊定制需求采购了部分库龄较长的 DDR4 Gen1.0 子代、DDR4 Gen1.5 子代的产品（相关产品已计提存货跌价准备，转回金额合计 2,121.02 万元）所致，因此公司存货跌价准备的转回具备合理性。

综合考虑上述因素，公司制定的存货跌价准备计提政策适当，报告期期末公司按照规定的存货跌价准备计提政策计提存货跌价准备，在确认可变现净值时充分考虑了产品销售及库龄等因素的影响，计提充分。

四、结合发行人产品销售周期、委托加工下单和加工周期，说明委托加工物资跌价准备余额较大且逐期大幅增长的原因及合理性。

公司从晶圆代工厂采购的晶圆作为原材料核算，原材料发往封装测试厂进行封装测试服务后到产成品产出前计入委托加工物资核算。

报告期内，公司采取 Fabless 的生产模式，公司的委外供应商是晶圆制造商和封装测试商，晶圆制造约 2-3 个月，封装测试约 2-3 周。公司客户会提前向公司提供最近六个月的采购预测数据，公司一般根据客户采购预测数和客户订单来制定晶圆制造和封装测试的委托加工计划。

报告期内委托加工物资跌价准备主要为 DDR4 Gen1.0 子代和 DDR4 Gen1.5 子代，其具体情况如下表所示：

单位：万元

DDR4 子代	项目	2018 年	2017 年	2016 年
Gen1.0	委托加工物资金额	1,517.33	1,817.46	1,861.83
	跌价准备	1,517.33	1,640.87	-
	跌价准备占比	100.00%	90.28%	
Gen1.5	委托加工物资金额	1,654.53	3,590.39	474.55
	跌价准备	1,654.53	814.61	-
	跌价准备占比	100.00%	22.69%	
上述子代合计跌价准备金额		3,171.86	2,455.48	-
委托加工物资总跌价准备金额		3,171.86	2,455.48	183.44
上述子代占委托加工物资总跌价准备比例		100.00%	100.00%	0.00%

2016 年、2017 年和 2018 年，公司各期末委托加工物资跌价准备余额分别为 183.44 万元、2,455.48 万元和 3,171.86 万元。其中 DDR4 Gen1.0 子代和 DDR4 Gen1.5 子代委托加工物资合计跌价准备为 0.00 万元、2,455.48 万元和 3,171.86 万元，占总委托加工物资跌价准备比例为 0.00%、100.00%和 100.00%。

公司产品迭代周期一般为 18-24 个月，各代产品在生命末端的销量会呈现大幅下降趋势，因此公司会根据各代产品的生命周期，足额计提减值准备。DDR4 Gen1.0 子代、DDR4 Gen1.5 子代产品在报告期内逐步进入生命周期末端，其销量迅速减少且单价迅速降低，故公司在 2017 年和 2018 年对 DDR4 Gen1.0 子代、

DDR4 Gen1.5 子代产品的委托加工物资足额计提了存货跌价准备。因此，委托加工物资跌价准备余额逐期增大。

五、内存接口芯片各代产品在报告期内的产销量情况

年度	产品类型		产量指数	销量指数	产销比
2016 年	DDR3 及其他		75.48	100.00	1.32
	DDR4	Gen1.0	372.72	582.47	1.56
		Gen1.5	1,221.51	1,123.57	0.92
		Gen2.0	189.58	125.24	0.66
		Gen2plus	-	-	-
		小计	1,783.81	1,831.28	1.03
2017 年	DDR3		77.63	75.60	0.97
	DDR4	Gen1.0	18.70	120.22	6.43
		Gen1.5	1,675.55	1,515.82	0.90
		Gen2.0	1,302.61	1,138.82	0.87
		Gen2plus	2.40	2.19	0.91
		小计	2,999.26	2,777.05	0.93
2018 年	DDR3		19.72	27.59	1.4
	DDR4	Gen1.0	68.59	134.45	1.96
		Gen1.5	537.76	741.67	1.38
		Gen2.0	4,129.00	4,154.97	1.01
		Gen2plus	100.01	73.25	0.73
		小计	4,835.35	5,104.34	1.06

注：以 2016 年 DDR3 及其他产品的销售数量为基数，基准指数为 100，报告期相关产品的产量和销量指数体现为对应 2016 年基数的增长或下降情况；产销比=当期销量/当期产量

2016 年、2017 年和 2018 年，公司内存接口芯片产销比分别为 1.04、0.93 和 1.06，内存接口芯片产品销量与产量基本匹配。

2016 年、2017 年和 2018 年，公司 DDR3 产销比分别为 1.32、0.97 和 1.40。公司 DDR4 产销比分别为 1.03、0.93 和 1.06。由于产品更新换代，DDR3 代产量和销量逐步下降，DDR4 代产量和销量逐步上升，公司根据各代产品的市场需求情况，合理的安排生产计划，各代内存接口芯片产品的销量与产量基本匹配。

六、报告期内报废产品的金额及占比，以及相关会计处理方式

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
报废产品成本	26.22	242.02	89.02
营业成本	51,773.40	57,095.23	41,230.91
占比	0.05%	0.42%	0.22%

2016 年、2017 年和 2018 年，公司报废产品成本分别为 89.02 万元、242.02 万元和 26.22 万元，分别占当期营业成本 0.22%、0.42%和 0.05%。公司的报废产品的金额和占比很小，主要是退货等出现质量问题的产品报废所致。在会计处理上，公司将相关产品报废后，直接计入营业成本。

8.2 保荐机构和申报会计师的核查过程及核查意见

保荐机构及申报会计师进行了一下核查程序：

- 1、了解并评价与采购及存货相关的内部控制制度的涉及及执行；
- 2、取得并检查发行人的在手订单和期后销售情况统计表；
- 3、检查存货跌价准备的计提政策是否符合会计准则规定，复核发行人的存货减值测试表，分析计提存货跌价准备的原因及与存货库龄的匹配情况；
- 4、对期末存货盘点执行监盘程序并对委外厂商仓库进行函证，现场访谈委外供应商，了解其与发行人合作的具体情况，并与发行人实际情况核对。

经核查，保荐机构及申报会计师认为，发行人营业收入快速增长同时存货规模逐期减少具有合理性；2018 年末发行人结束与富昌电子的代销关系，导致 2018 年发出商品大幅减少，具有合理性，发行人不存在提前确认收入情形；由于产品更新迭代，发行人计提存货跌价准备，目前发行人存货跌价准备计提政策谨慎，计提充分；部分老一代产品由于销量下降，造成发行人委托加工物资跌价准备余额较大且逐期大幅增长，具有合理性；发行人披露报告期内存货项目的明细情况及金额占比，存货的采购、生产和销售周期与我们了解情况基本一致，内存接口芯片产量与销量基本匹配。

8.3 补充披露情况

发行人在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“七、资产质量分析（二）流动资产分析 5、存货”进行补充披露：

各报告期末，公司分产品类别的存货规模情况如下：

单位：万元

产品类型	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
内存接口芯片	18,259.40	21,739.32	17,814.67
消费电子芯片			16,317.21
津逮®服务器平台	1,884.31	23.10	
合计	20,143.71	21,762.42	34,131.88

2016 年和 2017 年，公司存货期末余额分别为 34,131.88 万元和 21,762.42 万元，2017 年较 2016 年下降 12,369.46 万元，其主要原因系公司将消费电子芯片业务相关的存货转让给成都澜至及其关联方，2016 年底消费电子芯片存货金额合计 16,317.21 万元。同时，公司内存接口芯片业务增长迅速，公司积极备货，2017 年内存接口芯片存货余额 21,739.32 万元较 2016 年内存接口芯片存货余额 17,814.67 万元增加了 3,924.65 万元。

2018 年，公司存货期末余额为 20,143.71 万元，2018 年末较 2017 年末存货余额下降 1,618.71 万元，主要系公司根据产品的生产周期和交货周期对存货进行优化管理。公司会根据客户采购预测数据和实际订单情况制定备货计划，在满足按时向客户交货的同时，通过加强存货管理，控制库存，从而提高存货周转率。同时，公司 2018 年下半年销售收入为 104,853.37 万元，同比增长 103.62%，对库存消耗较大。综合上述两个原因，从而导致内存接口芯片业务相关存货期末金额下降。

.....

公司从晶圆代工厂采购的晶圆作为原材料核算，原材料发往封装测试厂进行封装测试服务后到产成品产出前计入委托加工物资核算。

报告期内委托加工物资跌价准备主要为 DDR4 Gen1.0 子代和 DDR4 Gen1.5 子代。2016 年、2017 年和 2018 年，公司各期末委托加工物资跌价准备余额分别为 183.44 万元、2,455.48 万元和 3,171.86 万元。其中 DDR4 Gen1.0 子代和

DDR4 Gen1.5 子代委托加工物资合计跌价准备为 0.00 万元、2,455.48 万元和 3,171.86 万元, 占总委托加工物资跌价准备比例为 0.00%、100.00%和 100.00%。

DDR4 Gen1.0 子代、DDR4 Gen1.5 子代产品在报告期内逐步进入生命周期末端, 其销量迅速减少且单价迅速降低, 故公司在 2017 年和 2018 年对 DDR4 Gen1.0 子代、DDR4 Gen1.5 子代产品的委托加工物资足额计提了的存货跌价准备。因此, 委托加工物资跌价准备余额逐期增大。

发行人在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“六、经营成果分析（一）营业收入结构及趋势分析 2、主营业务收入的销售模式构成”进行补充披露：

公司发出商品系代销模式下公司已发给代销商, 但代销商未销售至最终客户的存货部分。2016 年、2017 年和 2018 年, 公司各期末发出商品金额分别为 2,349.50 万元、2,211.10 万元和 62.11 万元。公司 2018 年末发出商品金额大幅下降主要原因如下：

2018 年, 公司内存接口芯片业务的主要代销商为富昌电子, 富昌电子是最终客户美光科技指定的与公司合作的代销商（买方代理）。经过多年合作, 公司已成为美光科技合格供应商。2018 年末美光科技经与公司、富昌电子协商确定, 后续由公司直销给美光科技, 从而结束与富昌电子的代销关系。因此, 2018 年末开始, 公司直接将内存接口芯片发货给美光科技, 公司不再向代销商富昌电子继续发货, 且存放在富昌电子的产品基本已经销售给美光科技, 导致公司 2018 年末发出商品大幅下降。综上, 发出商品金额大幅减少具有合理性。

9.关于费用

(1) 2018 年由于业绩完成良好管理费用中职工薪酬费用大幅增长,但销售费用中职工薪酬费用增幅显著偏低的原因及合理性;(2) 结合研发人员人数变动情况,进一步说明 2018 年研发人员薪酬费用大幅增长的原因及合理性,是否存在将应归属于成本或其他费用的支出多计入研发费用核算的情形;(3) 与境外销售服务代理机构合作的必要性,其为发行人提供的具体服务内容,报告期内主要代理机构 ILDO Korea Co., Ltd 和 First Source of Idaho, Inc.销售佣金具体计提比例的约定,分别协助公司实现销售的对应客户、销售金额以及和佣金的匹配性;(4) 充分分析报告期内历次增资及股权转让是否构成股份支付,涉及员工及其亲属获得股份的,认定“与其是否为公司提供服务无关”是否恰当,历次增资及股权转让的定价依据,并结合入股时间阶段、业绩基础与变动预期等充分论证入股价格是否公允。

请保荐机构、申报会计师进行核查,并发表明确意见。

回复:

9.1 发行人说明

一、2018 年由于业绩完成良好管理费用中职工薪酬费用大幅增长,但销售费用中职工薪酬费用增幅显著偏低的原因及合理性

2018 年销售费用中职工薪酬的增幅较管理费用中的职工薪酬增幅偏低主要原因为:(1) 因消费电子芯片业务下游客户分散且数量较多,所需的销售人员较多,2017 年 7 月公司转让消费电子芯片相关资产后,销售人员减少幅度大于管理人员;(2) 公司董事长、总经理因超额完成 2018 年经营业绩,公司董事会决定向其发放的 3,078.91 万元奖金计入管理费用,从而导致管理费用中的职工薪酬增幅较大。

假设剔除 2017 年 1-7 月消费电子芯片业务销售、管理人员的薪酬,以及董事长、总经理 2018 年超额完成业绩奖金,公司 2017 年、2018 年公司销售费用、管理费用中的薪酬职工薪酬情况如下:

年份	费用类别	薪酬总额(万元)	薪酬总额涨幅
----	------	----------	--------

2017 年	销售费用	2,238.15	-
	管理费用	2,697.13	-
2018 年	销售费用	4,354.40	94.55%
	管理费用	5,696.07	111.19%

由此可见，剔除上述影响后，2018 年管理费用中职工薪酬较 2017 年涨幅为 111.19%，2018 年销售费用中职工薪酬较 2017 年涨幅为 94.55%，增长趋势及幅度基本一致。

二、结合研发人员人数变动情况，进一步说明 2018 年研发人员薪酬费用大幅增长的原因及合理性，是否存在将应归属于成本或其他费用的支出多计入研发费用核算的情形

1、2018 年研发人员薪酬费用大幅增长的原因及合理性

2017 年、2018 年公司研发人员薪酬分别为 9,973.58 万元和 17,659.63 万元。2018 年研发人员薪酬大幅度增长的主要原因是：（1）公司 2018 年经营业绩较好，为激励现有研发团队，公司提高了研发人员薪酬待遇，为研发人员购买了 8,432.00 万元企业年金；（2）为加大研发力度，公司引进新的研发人员，公司 2018 年新增研发人员 42 人，较 2017 年期末研发人员增长 30%。

2、是否存在将应归属于成本或其他费用的支出多计入研发费用核算的情形

公司研发费用中的主要项目、核算内容及 2018 年占比情况如下：

项目	主要核算内容	占 2018 年 研发费用比例
职工薪酬	包括研发人员的基本薪酬和奖金等	63.82%
工程费用	相关 Mask、wafer、封测等费用	13.64%
协作开发费	委托对外技术开发服务	5.67%
工具费	研发工具采购	5.59%
许可证费	IP 授权的许可费摊销	4.57%
IT 软硬件费	研发活动发生的软硬件费和摊销	2.73%
折旧费	为研发活动购置的固定资产的折旧费用	1.70%
专业服务及咨询费	研发过程所需的专业服务及技术咨询费	0.57%
差旅费	研发人员发生的与研发项目相关的差旅食宿费用	0.32%
其他	研发过程中发生的其他费用	1.39%

研发费用合计		100.00%
--------	--	---------

公司按研发项目归集研发费用，其具体核算内容如下：

（1）职工薪酬仅核算研发部、市场应用技术部、运营部相关员工的薪酬，包括在职研发人员的工资、奖金、津贴、补贴、社会保险费、住房公积金等人工费用。公司研发人员均专职从事研发工作，不存在与其他部门工作重叠的情况。财务部根据人力资源部提供的含有部门信息的薪资报表，按照部门属性将研发部、市场应用技术部、运营部等研发人员的薪酬计入研发费用。

（2）工程费用包括流片费用、中间试验品和试制模具、工艺设备开发及制造费用、设备调整及检验费、测试机使用费和相关的运输费等。其中，流片费用的产生主要受研发项目的进度影响，一旦达到流片阶段就需列支工程费用。

（3）协作开发费核算的是研发过程中需要外部机构协助开发产生的外协服务费用。

（4）工具费核算研发过程中需要的各种电子元器件的采购费用。

（5）许可证费核算期间固定费用模式的 IP 授权许可费在合同约定的受益期内的摊销。例如研发所用 EDA 工具、各种其他类型 IP 授权许可使用费的摊销。

（6）IT 软硬件费核算研发活动所需的 IT 硬件设备如电脑显示器，以及软件使用费及其摊销。

（7）折旧费核算为研发活动购置的固定资产的折旧费。例如示波器、误码仪等设备的折旧。

（8）专业服务及咨询费核算研发过程所需的专业服务费及技术咨询服务费。

（9）差旅费核算研发人员发生的与研发项目相关的差旅食宿费用等。

（10）其他项目中核算其他与研发活动直接相关的费用，包括会议费、办公费、培训费、维修费等。

报告期内，公司研发费用中的各项目有清晰明确的归集范围。公司研发部门及研发人员职责清晰、与其他部门划分明确，不存在与其他部门职责重叠的情形。在核算过程中，严格执行相关制度，不存在将应归属于成本或其他费用的支出多

计入研发费用核算的情形。

三、与境外销售服务代理机构合作的必要性，其为发行人提供的具体服务内容,报告期内主要代理机构 **ILDO Korea Co., Ltd** 和 **First Source of Idaho, Inc.** 销售佣金具体计提比例的约定，分别协助公司实现销售的对应客户、销售金额以及佣金的匹配性

1、与境外销售服务代理机构合作的必要性，为发行人提供的具体服务内容

境外销售服务机构为公司与客户之间信息沟通、合作协调和技术对接的重要桥梁，其主要工作包括以下内容：

- (1) 支持、推进公司与客户的价格协商过程；
- (2) 为双方工程师反馈产品的使用状况和技术参数信息；
- (3) 跟进产品的个性化技术需求，协调解决方案；
- (4) 及时为客户提供产品工程和技术变动信息；
- (5) 依托与客户的高层次合作关系，帮助公司与客户开展及时有效的技术会议、商业会议；
- (6) 促进公司与客户建立健康、稳定、长期的商业合作、技术合作关系。

经过多年发展，集成电路行业已经比较成熟，在设计、晶圆代工、封装、测试及销售代理等细分领域分工明确。公司属于集成电路设计企业，在境外销售方面与境外销售服务代理机构合作，主要是为利用境外销售服务代理机构的专业能力和销售渠道，推动销售的增长，并且可以将自身的主要精力放在产品的研发上，与境外销售服务代理机构合作的模式属于行业惯例。因此，与境外销售服务代理机构合作的模式具备必要性。

2、报告期内主要代理机构 **ILDO Korea Co., Ltd** 和 **First Source of Idaho, Inc.** 销售佣金具体计提比例的约定，分别协助公司实现销售的对应客户、销售金额以及佣金的匹配性

ILDO Korea Co., Ltd 主要为公司内存接口芯片提供销售支持服务，主要面向

总部在韩国的客户。根据公司与其签订的合同，按其协助公司实现的销售金额计算佣金，对其当年实现的销售按一定比例计提，对超过上一年的销售额增量给予额外佣金奖励。ILDO Korea Co., Ltd 协助实现销售的客户包括三星电子、海力士、海太半导体、Hanyang Digitech Co., Ltd 和 SFA Semicon Philippines Corporation。

First Source of Idaho, Inc. 主要为公司内存接口芯片提供销售支持服务，主要面向总部在美国的客户。根据公司与其签订的合同，按其协助公司实现的销售金额计算佣金，对其当年实现的销售按一定比例计提。First Source of Idaho, Inc 协助实现销售的客户为美光科技。

报告期内，公司对主要代理机构 ILDO Korea Co., Ltd 和 First Source of Idaho, Inc. 发生的销售佣金为按照合同条款约定的计提比例、根据实际实现销售金额计算得出，实际发生的销售佣金与实现销售金额具备匹配性。

四、充分分析报告期内历次增资及股权转让是否构成股份支付，涉及员工及其亲属获得股份的，认定“与其是否为公司提供服务无关”是否恰当，历次增资及股权转让的定价依据，并结合入股时间阶段、业绩基础与变动预期等充分论证入股价格是否公允。

1、报告期内历次增资及股权转让是否构成股份支付，历次增资及股权转让的定价依据，并结合入股时间阶段、业绩基础与变动预期等充分论证入股价格是否公允

公司的股份暂未在资本市场流通，不存在公开市场上的公允价值，公司采用估值技术确认权益工具的公允价值。股权定价考虑以下三个维度：①以引入外部机构或战略投资者相对公允的价格作为参照依据。从参考时效上，通常考虑六个月之内的股权交易，并考虑近期公司业务是否有重大变化。②引入专业的资产评估机构进行评估，比如首选现金流折现法；③以相同或类似行业市盈率、市净率，作为衡量公允价值的校对依据。双方考虑上述因素后，经协商确定最终定价。

报告期内，公司共有三次增资及一次股权转让。具体情况如下：

（1）第四次增加注册资本及变更出资币种

2016 年 3 月 17 日，澜起有限股东作出股东决定，同意：1）公司变更出资

方式，注册资本由 1,000 万美元变更为人民币 78,370,200 元；2) 公司注册资本由 78,370,200 元增加至 757,031,775 元，新增注册资本 678,661,575 元由 Montage HK 出资 4,524,382,992 元认购，增资款项与新增注册资本的差额计入公司资本公积。此次增资为原股东增资，不涉及员工、客户及供应商，不构成股份支付，不存在入股价格不公允的情形。

(2) 第五次增加注册资本

2017 年 8 月，澜起有限拟进行增资，故委托评估机构以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日对澜起有限股东全部权益价值进行评估。评估机构经过必要的评估程序，于 2017 年 11 月 24 日出具了相关的评估报告。2017 年 11 月 30 日，澜起有限股东决定，同意由臻石一号、臻石二号、臻石三号、Theon Investment、珠海融扬、珠海融英共六方以不低于上述评估报告的评估值作为公司投前估值对澜起有限进行现金增资，合计认购澜起有限新增注册资本 146,819,325 元。后经过协商谈判，本次增资投前估值约 43.0 亿元，投后估值约 51.3 亿元，投后估值对应 2017 年扣除非经常性损益后的净利润市盈率为 18.71 倍，属于市场公允价格。在确定增资估值时，澜起有限股权暂未在资本市场流通，不存在公开市场上的公允价值，因此澜起有限采用专业评估机构评估的评估价值作为澜起有限权益工具的公允价值具有合理性。虽然本次增资方穿透后的投资人中存在公司部分员工或其亲属，但其获取该次投资机会与其未来是否为公司提供服务无关，且相关投资协议未对其未来是否为公司服务做出任何限制性约束，因此不构成股份支付。

(3) 第二次股权转让

2018 年 1 月，Montage Holding 董事会决议同意 Montage HK 将其所持的全部澜起有限的股权转让给 Montage Holding 的普通股股东的指定主体，股权转让价款参考第五次增资价格，转让估值对应 2017 年扣除非经常性损益后的净利润市盈率为 18.71 倍，属于市场公允价格，不构成股份支付。

(4) 第六次增加注册资本

2018 年 12 月，Intel Capital, SVIC No.28 Investment 对发行人增资。公司凭借在内存接口芯片领域的技术竞争优势，收入及净利润均保持了快速增长，其中

2018 年净利润较 2017 年净利润上涨 109.44%。本次增资投后估值为 17.51 亿美元，约合 120 亿人民币，对应 2018 年扣非后净利润市盈率为 17.18 倍，与第五次增加注册资本的市盈率倍数基本一致，且与同期同行业一级市场可比投资估值（市盈率 15.78-18.57 倍）不存在重大差异，具有公允性。本次增资穿透后股东为公司的客户或供应商，但增资协议不存在对相关客户或供应商的激励或补偿，且在本次增资前后，公司与相关客户或供应商的采购、销售协议中关于产品定价、采购/供货量、信用政策、收付款政策等主要条款并不存在变化，且增资定价公允，不形成对客户和供应商的激励或补偿，不构成股份支付。

综上所述，前述增资及股权转让定价公允，不存在对员工、客户和供应商的激励或补偿，不构成股份支付。

2、涉及员工及其亲属获得股份的，认定“与其是否为公司提供服务无关”是否恰当

报告期内，涉及员工及其近亲属获得股份的，属于间接投资，相关投资定价公允，其获取该次投资机会与其未来是否为公司提供服务无关，且相关投资协议未对其未来是否为公司服务做出任何限制性约束，不构成对员工的补偿或激励。因此将表述修改为“涉及员工及其亲属获得股份的，获取股份的对价公允，且与其未来是否为公司提供服务无关。”

9.2 保荐机构和申报会计师的核查过程及核查意见

保荐机构及申报会计师执行了以下核查程序：

1、了解发行人职工薪酬相关的内部控制的设计及运行情况，对相关内部控制执行情况进行检查。

2、检查职工薪酬的核算方法和会计处理，检查归集范围是否清晰明确，获取报告期内员工名单和工资表、抽查发行人的员工薪酬发放记录并进行分析性复核。对比报告期内发行人的员工平均薪酬，并结合同行业可比上市公司的情况，分析薪酬的变化及合理性；

3、检查给予董事长、总经理绩效奖金的董事会决议文件，发放依据和发放记录；检查发行人购买年金的总经理办公会议纪要、与年金资产管理人签订的协议

条款，获取并检查员工分配名单和相关的银行回单。

4、获取研发部门人员名单，对比报告期内员工人数变化，核实研发费用中职工薪酬变化及其合理性，根据发行人研发费用的归集范围和核算方法，检查研发费用中是否存在成本或其他费用的支出。

5、通过访谈发行人相关负责人员，对发行人与境外销售服务机构的合作情况进行了解，关注合作的历史、商业理由和必要性；

6、检查与境外销售服务代理机构签订的合同，根据合同条款测算销售佣金计算的准确性，检查相关发票及销售佣金的计提与支付情况；

7、对报告期内发行人主要销售代理机构执行函证程序，并进行现场访谈，重点关注合作历史、合作背景和是否存在关联关系等情形。

8、查阅了发行人股东调查表，穿透核查了相关股东的最终受益人，并通过公开信息核对了发行人股东的相关信息，检查最终受益人是否存在发行人员工、供应商和客户的情况；

9、检查 Intel Capital, SVIC No.28 Investment 入股后发行人董事会及股东构成情况，判断其是否对发行人的生产经营和独立性产生重大影响；检查 Intel 和三星电子的采购、销售合同及订单中关于产品定价、采购/供货量、信用政策、收付款政策、返利政策等主要条款在入股前后是否发生变化，检查发行人销售和采购记录，判断其与其他供应商、客户是否一致，与其他供应商、客户的价格进行对比，分析 Intel 和三星电子采购/销售价格的公允性，是否存在潜在利益安排；

10、访谈管理层关于历次增资及股权转让的定价依据和考虑因素，对相关的评估报告进行复核，分析估值变化的原因，判断报告期内增资及股权转让的定价依据是否合理，转让定价是否公允；

11、根据企业会计准则中关于股份支付的相关规定，检查报告期内增资及股权转让是否构成股份支付，发行人相关会计处理是否符合企业会计准则的规定。

经核查，保荐机构及申报会计师认为：

报告期内，发行人管理费用中职工薪酬费用增幅显著高于销售费用中职工薪

酬费用增幅的原因具有合理性；因公司提高了研发人员薪酬待遇，引进了新的研发人员，2018 年研发人员薪酬费用大幅增长，具有合理性；发行人严格按照研发费用的归集范围和核算方法核算研发费用，不存在将应归属于成本或其他费用的支出多计入研发费用核算的情形。

报告期内，发行人与境外销售服务代理机构的合作具有合理的商业需求和背景，具备必要性。发行人与相关境外销售服务代理机构签订了规范的代理服务合同。报告期内，发行人支付给主要代理机构 **ILDO Korea Co., Ltd** 和 **First Source of Idaho, Inc.** 的佣金金额与其协助公司实现销售的对应客户、销售金额以及佣金的计提比例相匹配。

报告期内，发行人历次增资及股权转让，虽涉及发行人员工、客户和供应商，但定价公允，不存在对其激励或补偿，不构成股份支付；涉及员工及其亲属获得股份的，认定“与其是否为公司提供服务无关”的表述修改为：“涉及员工及其亲属获得股份的，获取股份的对价公允，且与其未来是否为公司提供服务无关”；发行人报告期内历次增资及股权转让的定价依据合理，入股价格公允。

10.关于销售和采购返利

请发行人说明销售和采购过程中是否涉及返利事宜,是否符合行业惯例及差异原因。若存在销售返利和采购返利,进一步说明报告期内销售返利和采购返利的结算周期、具体结算方式(冲抵销售或采购款/支付现金等),结算周期和计算方式是否符合行业惯例及差异原因,报告期各期各种结算方式所对应的销售返利和供应商返利金额及相关会计处理,报告期各期支付的销售返利和收到的供应商返利在现金流量表中的具体体现或者所对应的具体项目,以及相关金额存在差异的原因。

请保荐机构、申报会计师进行核查,并发表明确意见。

回复:

10.1 发行人说明

报告期内公司在销售和采购过程中不涉及返利事宜,公司与客户和供应商之间的商业合作均基于公平的商业原则,并在实际经营中,严格依照合同或订单执行,相关合同或订单不存在返利条款,公司与客户和供应商实际运营中亦不存在返利事宜。

一家公司是否涉及返利事宜,是其与客户及供应商协商的结果,并且通过查询可比上市公司兆易创新和汇顶科技申请发行上市的招股说明书及以后期间的年报,也未发现其存在销售返利及采购返利的情形,因此公司在报告期内不存在返利事宜符合行业惯例。

10.2 保荐机构和申报会计师的核查过程及核查意见

关于发行人销售和采购返利,申报会计师执行了以下核查程序:

1、检查发行人与客户、供应商签订的合同和订单,核实其是否存在有关销售返利的条款;

2、检查发行人报告期内主要客户和供应商的销售和采购记录、存货的出入库记录和银行的收付款记录,核实其是否存在现金返利和实物退货的情形;

3、对报告期内主要客户和供应商进行函证和走访,核实其采购和销售的金

额，现场访谈确认其是否存在返利的情形；

4、通过公开数据查询可比上市公司招股说明书及年报，核实其是否存在返利的情形，核实是否与发行人的做法存在差异。

经核查，申报会计师认为，报告期内发行人在销售和采购过程中不涉及返利事宜，公司与客户和供应商签订的合同、订单及实际运营中均不存在返利事宜，符合行业惯例。

11.关于 IP 授权许可费

根据问题 39 的回复，发行人向 Synopsys 等多方采购 EDA 工具等 IP 授权，并作为无形资产核算。集成电路设计行业中，IP 授权许可费通常存在期间固定费用模式和变动费用模式两种核算模式，发行人申报及回复材料中仅提及固定 IP 授权许可费。请发行人进一步说明：（1）IP 授权许可费的具体核算模式，是否符合芯片设计行业惯例及差异原因；（2）报告期内不同核算模式下支付给各 IP 授权方的许可费，各期 IP 授权许可费占营业成本的比重及变化情况，以及与同行业可比公司的差异情况分析；（3）报告期内 IP 授权许可费是否区分期间固定费用模式和变动费用模式（产品销量挂钩模式或类似模式），若存在变动费用模式，进一步说明与 IP 授权方关于变动 IP 授权许可费的对账机制，是否曾经发生分歧及其解决情况，结合报告期各期变动 IP 授权许可费的量化计算过程，说明变动 IP 授权许可费与相关产品销量的匹配性及差异原因；（4）结合 IP 授权和 EDA 设计工具对发行人产品研发生产销售的重要性、发行人与主要 IP 专利授权方的合作年限及稳定性、发行人寻找替代供应商的难度，说明发行人对 IP 授权方是否存在重大依赖、是否存在授权期限届满后不能续签的风险，并进行风险提示；（5）是否对记入无形资产的 IP 授权进行减值测试并计提减值准备，是否存在应计提减值准备而未计提的情况。

请保荐机构、申报会计师进行核查，说明对 IP 授权许可费的核查方法、范围、内容、过程、结论并发表明确意见。

回复：

11.1 发行人说明

一、IP 授权许可费的具体核算模式，是否符合芯片设计行业惯例及差异原因

报告期内，根据公司与 IP 授权方签订的合同，公司的 IP 授权许可使用费的核算方式分为期间固定费用模式和变动费用模式，其中主要核算模式为期间固定费用模式。

报告期内，公司期间固定费用模式核算的 IP 授权许可费在核算时按照其购

入成本计入无形资产或待摊费用（其中使用年限超过一年计入无形资产，低于一年计入待摊费用），并根据 IP 授权使用期限摊销入研发费用。

公司变动费用模式核算的 IP 授权许可费系消费电子芯片产品所购买的 IP 授权许可费，核算时根据与该 IP 授权相关芯片产品累计销量的一定比例计算，由于该 IP 授权使用费是履行销售合同必然发生的直接相关成本，根据“财政部会[2016]18 号”会计科目和主要账务处理的相关规定，公司将该 IP 授权使用费直接计入营业成本。

公司查阅了同行业公司的 IP 授权许可费的核算模式，公司 IP 授权许可费的核算模式符合行业惯例。

二、报告期内不同核算模式下支付给各 IP 授权方的许可费，各期 IP 授权许可费占营业成本的比重及变化情况，以及与同行业可比公司的差异情况分析

1、报告期内不同核算模式下支付的 IP 授权许可费

报告期内不同核算模式下公司支付的 IP 授权许可费情况如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
计入无形资产的期间固定费用模式支付的 IP 授权许可费	1,897.63	4,299.23	121.15
计入待摊费用的期间固定费用模式支付的 IP 授权许可费	389.05	755.35	654.77
变动费用模式下支付的 IP 授权许可费	-	85.15	185.91

报告期内，公司在固定费用模式下主要支付 IP 授权许可费的对象包括：Synopsys International Limited、Cadence Design Systems (Ireland) Limited 和 Mentor Graphics (Ireland) Ltd.等 EDA 工具供应商及 ARM Limited 等技术授权方。

变动费用模式核算的 IP 授权许可费主要系消费电子芯片业务所需的 IP 授权许可，报告期内逐年下降主要系公司于 2017 年 7 月 31 日转让了消费电子芯片业务相关资产，公司不再从事消费电子芯片相关业务。

2、IP 授权许可费占营业成本的比重及变化情况

期间固定费用模式核算的 IP 授权许可费为研发活动购买，计入无形资产或

待摊费用核算，其摊销计入研发费用。变动费用模式的 IP 授权许可费是履行销售合同必然发生的直接相关成本，直接计入主营业务成本。

因此，IP 授权许可费在营业成本中的占比情况：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
IP 授权许可费-变动费用模式	-	85.15	185.91
主营业务成本	51,773.40	49,861.19	41,051.29
占比	0.00%	0.17%	0.45%

2016 年、2017 年和 2018 年，变动费用模式核算的 IP 授权许可费分别为 185.91 万元、85.15 万元和 0 万元，分别占营业成本 0.45%、0.17% 和 0.00%。变动费用模式核算的 IP 授权许可费是消费电子芯片业务产品销售所需。2017 年，变动费用模式核算的 IP 授权许可费降低主要系 2017 年 7 月 31 日消费电子芯片业务相关资产转让时，公司将此项 IP 授权作为转让资产的一部分转让给成都澜至。2018 年公司不再从事消费电子芯片业务，变动费用模式核算的 IP 授权许可费为零。

公司查阅了同行业公司的 IP 授权许可费核算模式，公司在 IP 授权许可费的核算方式上与同行业可比公司无差异。

三、报告期内 IP 授权许可费是否区分期间固定费用模式和变动费用模式(产品销量挂钩模式或类似模式)，若存在变动费用模式，进一步说明与 IP 授权方关于变动 IP 授权许可费的对账机制，是否曾经发生分歧及其解决情况，结合报告期各期变动 IP 授权许可费的量化计算过程，说明变动 IP 授权许可费与相关产品销量的匹配性及差异原因

报告期内，公司存在变动费用模式核算的 IP 授权许可费。

1、变动费用模式的对账机制，是否曾经发生分歧及其解决情况

2016 年至 2017 年 7 月，公司为消费电子芯片业务的研发从 MIPS Technologies Inc 购入的 IP 授权的收费模式为收取期间固定费用加相关产品销量和销售金额挂钩的变动费用的模式。根据合同，当使用期限内累计销售数量超过 500 万颗后，按照相关产品销售收入总额的 1.50% 计算 IP 授权许可费用，其对账机制为：

公司在每季度末将本季度已实现销售的芯片销量和销售金额数据通过邮件发送给授权方，授权方核对确认无误后，编制《特许权使用费报表》，计算出本季度的变动 IP 授权许可费，并开具发票。

报告期内，公司与 MIPS Technologies Inc 未曾就 IP 许可使用费事项发生过分歧或纠纷。

2、变动 IP 授权许可费的量化计算过程，结合变动 IP 授权许可费与相关产品销量的匹配性及差异原因

报告期内发生的变动 IP 授权许可费与相关产品销量匹配性情况如下：

单位：万元

项目	销售数量	销售金额	计提比例	变动 IP 授权许可费
2016 年度	1,350.96	12,393.79	1.50%	185.91
2017 年度	594.13	5,676.74	1.50%	85.15

2016 年和 2017 年，公司与 MIPS Technologies Inc 的变动 IP 授权许可费根据相关产品销售数量区间确定费用比例后，相关产品销售金额乘以费用比例计算得出，其计算过程与相关产品销量和销售金额相匹配。此项 IP 授权许可于 2017 年 7 月转让给成都澜至后相关费用不再发生。

四、结合 IP 授权和 EDA 设计工具对发行人产品研发生产销售的重要性、发行人与主要 IP 专利授权方的合作年限及稳定性、发行人寻找替代供应商的难度，说明发行人对 IP 授权方是否存在重大依赖、是否存在授权期限届满后不能续签的风险，并进行风险提示

报告期内，公司的 IP 授权主要包括公司研发设计所需使用的电子设计自动化（EDA）工具以及技术许可。

其中，EDA 工具授权许可供应商主要包括 Synopsys International Limited、Cadence Design Systems (Ireland) Limited 和 Mentor Graphics (Ireland) Ltd.，均为全球主流 EDA 工具供应商。EDA 工具为芯片设计的辅助软件工具。利用 EDA 工具，设计工程师可以从概念、算法、协议等开始设计电子系统，通过计算机完成 IC 设计的实现、仿真和验证。EDA 工具的重要性在于保障 IC 设计的准确性，

提高产品各项性能指标，减少设计周期和产品测试验证周期。

由于主要的 3 家 EDA 供应商相关产品功能比较类似，具有相互替代性，公司可根据自身需求，自主选择相关 IP 授权供应商。公司自成立以来即开始与上述 3 家供应商展开合作，长期保持良好、稳定的合作关系，且历史上未发生过纠纷。因此，公司对此类 IP 授权方不存在重大依赖，授权期限届满后不能续签的风险较低。

此外，公司在报告期内采购金额比较大的 IP 授权还包括对 ARM Limited 公司技术授权的采购。公司采购此项 IP 授权主要是为了满足当时消费电子芯片相关业务的研发需求，但自公司于 2017 年 7 月将消费电子芯片业务相关资产转让后，目前已不再需要此项 IP 授权。因此，公司对该项 IP 授权方不存在重大依赖。

五、是否对记入无形资产的 IP 授权进行减值测试并计提减值准备，是否存在应计提减值准备而未计提的情况

对于外购的 IP 授权，公司在各年末对尚在授权使用期内的 IP 授权进行减值测试。报告期内公司计入无形资产的 IP 授权均在正常使用，无减值迹象，无须计提减值准备。

综上，经过减值测试，公司对记入无形资产的 IP 授权不存在应计提减值准备而未计提的情况。

11.2 保荐机构和申报会计师的核查过程及核查意见

针对期末 IP 授权许可费，保荐机构及申报会计师执行了以下主要程序：

1、检查购买 IP 授权的审批，了解 IP 授权许可费的核算方法和过程，检查是否符合企业会计政策和企业会计准则的规定；

2、询问发行人管理层，了解不同 IP 授权的用途，发行人与主要 IP 授权方的合作历史，发行人是否对 IP 授权方构成依赖等；

3、检查 IP 授权的相关合同，查看合同中关键条款，包括授权使用年限、收费方法，重新计算企业支付的 IP 授权许可费是否与合同规定的一致，金额是否准确，对合同约定的支付事项，会计记录和银行单据进行比对检查；

4、对计入无形资产的固定费用模式的 IP 授权，了解与授权相关产品的生命周期，判断 IP 授权的预计可使用年限，以判断外购 IP 授权是否在其授权使用年限以及预计可使用年限孰短期间进行摊销；对计入成本的 IP 授权许可费与销售数据的匹配情况进行检查，复核公司制作的按量计提的 IP 授权使用费的计算过程；

5、询问管理层是否与变动费用模式下的 IP 授权方存在纠纷，并从公开渠道查询是否存在或曾经存在 IP 授权许可费相关的诉讼或纠纷；

6、检查发行人对 IP 授权使用许可的减值测算过程，复核发行人计入无形资产的 IP 授权许可不存在减值的理由是否适当。

经核查，保荐机构及申报会计师认为，发行人报告期内 IP 授权许可费存在期间固定费用模式和变动费用模式两种核算模式，符合芯片设计行业惯例；发行人披露的报告期内不同核算模式下支付给各 IP 授权方的许可费，各期 IP 授权许可费占营业成本的比重及变化情况与中介机构了解的情况一致，与同行业公司不存在重大差异；报告期内，未发现发行人与变动 IP 授权许可费的授权方发生分歧或纠纷，发行人变动 IP 授权许可费与相关产品销量相匹配；发行人与主要 IP 授权方的合作稳定，市场上也存在多个可以替换的同类型的 EDA 工具的供应商，发行人对 IP 授权方不存在重大依赖，在授权期限届满后不能续签的风险较低；发行人对记入无形资产的 IP 授权进行减值测试，IP 授权无减值迹象和风险，不存在应计提减值准备而未计提的情况。

12.关于研发项目

根据回复材料，澜起科技和GMT合作开发电源管理芯片（PMIC）、温度传感器（TS）。

请发行人修改问题16回复及相关信息披露中“正在从事的研发项目”的相应人员数量，如实披露目前在研项目所对应的研发人员数量，并补充披露未参加在研项目的研发人员所从事的具体工作。

请发行人说明和GMT合作开展上述研发项目的背景及原因，目前的研发进度、取得的研发成果、存在的潜在风险、预计投产时间，相关产品与发行人主营业务的关系，是否可能对发行人未来业务格局及业绩产生重大影响。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。

回复：

12.1 发行人说明

一、请发行人修改问题 16 回复及相关信息披露中“正在从事的研发项目”的相应人员数量，如实披露目前在研项目所对应的研发人员数量，并补充披露未参加在研项目的研发人员所从事的具体工作。

根据要求已将“研发所需相应人员”修正为“目前在研项目所对应的研发人员数量”。

截至本问询函回复日，公司正在从事的主要研发项目具体情况如下：

序号	项目名称	研发目标	所处阶段及进展情况	目前在研项目所对应的研发人员数量
1	Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片	可应用于 DDR5 RDIMM 和 LRDIMM,符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	34 人
2	Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片	可应用于 DDR5 LRDIMM，符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	35 人
3	Gen2.0 津逮®处理器	为服务器平台的核心计算引擎，从而为数据中心市	可行性研究	45 人

		场提供安全可控服务器 CPU 解决方案。		
4	Gen2.0 DDR4 混合安全内存模组及所需的 RCD/DB 芯片	基于澜起 M88HS26SA 架构研发的 128GB 大容量混合安全内存模组。新架构可支持大容量内存颗粒架构。	可行性研究	17 人
5	Gen2.0 DDR4 精简混合安全内存模组及所需的 RCD 芯片	基于澜起 M88SC26HA 的架构，提升内存读写速度及数据实时保护速度达到 DDR4 3200MT/s。	可行性研究	12 人
6	高能效比可编程 AI 处理器及 SoC 芯片系列	可编程 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。AI 处理器的超大计算能力可支持多种神经网络模型。	可行性研究	15 人
7	用于数据中心的 AI 处理器芯片	AI 处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。	可行性研究	30 人

公司主要研发部门包括市场应用技术部、研发部以及运营部，各部门之间相互配合，相互协作。除上述参与具体研发项目的人员外，公司其他研发技术人员不超过 10 人，分别从事通用技术平台的研发设计、技术文档的撰写等相关工作。

二、请发行人说明和 GMT 合作开展上述研发项目的背景及原因，目前的研发进度、取得的研发成果、存在的潜在风险、预计投产时间，相关产品与发行人主营业务的关系，是否可能对发行人未来业务格局及业绩产生重大影响

1、研发项目的背景及原因：公司计划在 DDR5 阶段开发与 DDR5 内存模组相关的芯片集合及解决方案，增强公司在该领域的产品覆盖力度和市场主导能力。其中，电源管理芯片（PMIC）、温度传感器（TS）等芯片是 DDR5 内存模组上重要的配套芯片。为缩短产品开发周期，减少开发过程中的不确定性，公司对该部分芯片采取与 GMT 联合开发的模式。GMT 成立于 1996 年，是一家专注于为国际知名集成电路厂商提供 IC 设计和专业服务的台湾地区上市公司。

2、目前的研发进度、取得的研发成果：截至本问询函回复签署日，产品处于设计优化阶段，其中电源管理芯片的第一代工程样品大部分性能指标已初步满足 JEDEC 规范的要求。公司与 GMT 将根据 JEDEC 相关标准进行设计优化，以

争取早日进入量产认证阶段。

3、存在的潜在风险：由于该产品是公司与合作伙伴联合开发，存在着开发失败的风险，此外即使开发成功还需要经过一定的测试认证和市场推广才能获得订单，因此公司能否通过该产品获得相关收入存在不确定性。

4、预计投产时间，相关产品与公司主营业务的关系，是否可能对公司未来业务格局及业绩产生重大影响：具体投产时间将依赖于 DDR5 内存颗粒以及中央处理器等上下游厂商的产品研发进度和市场需求等因素，目前预计量产时间为 2021-2022 年。电源管理芯片（PMIC）、温度传感器（TS）等芯片是 DDR5 内存模组的配套芯片之一，而公司的主要产品内存接口芯片是内存模组的核心芯片之一，相关芯片均是内存模组的组成部分。研发电源管理芯片（PMIC）、温度传感器（TS）等芯片，有望丰富公司的产品组合，进一步提高公司在 DDR5 内存模组市场上可销售产品的规模，从而有望为公司提供新的收入增长点。电源管理芯片（PMIC）、温度传感器（TS）等作为 DDR5 内存模组配套芯片之一，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。

12.2 保荐机构的核查过程和核查结论

核查过程：

1、保荐机构查阅了发行人在研项目资料、对应当前研发人员和研发进度情况，与公司核心技术人员就在研项目及研发相关部门及人员的分工情况进行了访谈。

2、取得了发行人与 GMT 合作研发的相关协议，就合作背景及原因，目前的研发进度、取得的研发成果、存在的潜在风险、预计投产时间、相关产品与发行人主营业务的关系、对未来业务格局及业绩影响等具体情况取得了发行人说明文件。

核查结论：

经核查，保荐机构认为：

1、发行人正在从事的研发项目进展均符合预期，发行人已投入相应的研发

人员。

2、发行人和 GMT 的合作开展具有合理商业背景，目前相关合作进度及研发成果均符合预期。其合作研发产品是发行人现有主要产品内存接口芯片的配套产品，可进一步提高公司在 DDR5 内存模组市场上可销售产品的规模。

12.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、公司的技术与研发情况”之“（二）研发项目及进展情况”中补充披露：

1、研发项目基本情况

截至本招股说明书签署日，公司正在从事的主要研发项目分别处于可行性研究和设计优化过程中，具体情况如下：

序号	项目名称	研发目标	所处阶段及进展情况	目前在研项目所对应的研发人员数量
1	Gen 1.0 DDR5 寄存时钟驱动器芯片	可应用于 DDR5 RDIMM 和 LRDIMM，符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	34 人
2	Gen 1.0 DDR5 数据缓冲器芯片	可应用于 DDR5 LRDIMM，符合 JEDEC DDR5 标准，支持速率高达 4800MT/s。	设计优化	35 人
3	Gen2.0 津逮®处理器	为服务器平台的核心计算引擎，从而为数据中心市场提供安全可控服务器 CPU 解决方案。	可行性研究	45 人
4	Gen2.0 DDR4 混合安全内存模组及所需的 RCD/DB 芯片	基于澜起 M88HS26SA 架构研发的 128GB 大容量混合安全内存模组。新架构可支持大容量内存颗粒架构。	可行性研究	17 人
5	Gen2.0 DDR4 精简混合安全内存模组及所需的 RCD 芯片	基于澜起 M88SC26HA 的架构，提升内存读写速度及数据实时保护速度达到 DDR4 3200MT/s。	可行性研究	12 人
6	高能效比可编程 AI 处理器及 SoC 芯片系列	可编程 AI 处理器芯片和 SoC 芯片。AI 处理器的超	可行性研究	15 人

		大计算能力可支持多种神经网络模型。		
7	用于数据中心的AI处理器芯片	AI处理器采用可编程与可重构技术实现硬件平台的灵活性与通用性平衡，扩展平台系统的应用空间。	可行性研究	30人

公司主要研发部门包括市场应用技术部、研发部以及运营部，各部门之间相互配合，相互协作。除上述参与具体研发项目的人员外，其他研发技术人员分别从事通用技术平台的研发设计、技术文档的撰写等相关工作。

13.关于发行人股东

根据回复材料，珠海融英与珠海融扬向上穿透的合伙人之间不存在重叠，双方之间不存在关联关系或一致行动关系。

请保荐机构、律师核查珠海融扬普通合伙人杨智涵与杨崇颐、杨崇和之间是否存在关联关系，珠海融英与珠海融扬向上穿透的合伙人之间是否存在关联关系或一致行动关系，珠海融英、珠海融扬除持有发行人股权外是否还有其他对外投资。

请保荐机构、发行人律师进行核查，并发表明确意见。

13.1 发行人说明

一、珠海融扬普通合伙人杨智涵与杨崇颐、杨崇和之间是否存在关联关系

珠海融英的普通合伙人杨崇颐与公司董事长杨崇和是姐弟关系。

珠海融扬的普通合伙人杨智涵身份证号码为 51022719*****，经三方确认，其与杨崇颐、杨崇和之间不存在关联关系。

二、珠海融英与珠海融扬向上穿透的合伙人之间是否存在关联关系或一致行动关系

1、珠海融英系于 2016 年 2 月 4 日在珠海市注册成立的合伙企业，目前持有统一社会信用代码为 91440400MA4UM0K41T 的《营业执照》，主要经营场所为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-12629，经营范围为：协议记载的经营范围：股权投资、投资管理。执行事务合伙人为杨崇颐、青岛蓝色半岛股权投资管理有限公司（委派代表：贲金锋）。

珠海融英目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）	合伙人类型
1	杨崇颐	0.00	普通合伙人
2	青岛蓝色半岛股权投资管理有限公司	0.00	普通合伙人
3	Harmonialux Holdings(Hong Kong) Limited	100.00	有限合伙人
	合计	100.00	/

珠海融英合伙人穿透后情况如下：

(1) 青岛蓝色半岛股权投资管理有限公司为中国工商银行股份有限公司控股的投资管理公司。

(2) Harmonialux Holdings(Hong Kong) Limited 股东均为自然人，分别为 Tai kuai Lap 及 Chao Iong Wa。

2、珠海融扬系于 2016 年 2 月 4 日在珠海市注册成立的合伙企业，目前持有统一社会信用代码为 91440400MA4ULWM2XD 的《营业执照》，住所为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-12625，经营范围为：协议记载的经营范围：股权投资、投资管理。执行事务合伙人为 Theon Management Limited（委派代表：Chew Kheng Heng）、杨智涵。

珠海融扬目前的合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）	合伙人类型
1	Theon Management Limited	0.00	普通合伙人
2	杨智涵	0.00	普通合伙人
3	Theon Investment Hong Kong Limited	100.00	有限合伙人
	合计	100.00	/

珠海融扬合伙人穿透后情况如下：

(1) Theon Management Limited 的唯一股东为自然人 Chew Kheng Heng。

(2) Theon Investment Hong Kong Limited 向上穿透后股东为 11 名自然人，分别为 Chew Kheng Heng、Chia Chen Chang、Jinxiang Liu、Lai Yi-Cheng、Lee-Chung Yiu、Lin Yu-Chia、Shen Feng、Seung Jin Seo、Xuegong Liu、Yang Chang-Chen、Zhongyuan Chang。

综上，珠海融英与珠海融扬向上穿透的合伙人之间不存在关联关系或一致行动关系。珠海融英与珠海融扬已就其之间不存在关联关系或一致行动关系出具了书面确认。

三、珠海融英、珠海融扬除持有发行人股权外是否还有其他对外投资

珠海融英、珠海融扬确认：截至本问询函回复日，珠海融英、珠海融扬除持

有发行人股权外，不存在其他对外投资。

13.2 保荐机构和发行人律师的核查过程和核查结论

保荐机构和发行人律师获取了杨智涵、杨崇和、杨崇颐的身份信息及三方确认文件；获取了杨崇和的董监高调查表；获取了珠海融英、珠海融扬的工商登记资料与股东穿透资料；获取了珠海融英、珠海融扬有关无关联关系的确认函；获取了珠海融英、珠海融扬的股东调查表，确认其对外投资情况。

经核查，保荐机构和发行人律师认为，杨智涵同杨崇和、杨崇颐之间不存在关联关系；珠海融英与珠海融扬向上穿透的合伙人之间不存在关联关系或一致行动关系，除持有发行人股权外，珠海融英、珠海融扬不存在其他对外投资。

14.关于银行理财产品

根据回复材料，发行人在报告期内购买银行理财产品均经财务负责人和总经理审批。

请发行人说明，利用闲置资金购买银行理财产品及相关规模是否经过董事会决议和股东会审议通过，财务总监和总经理审批购买理财产品是否在董事会授权范围内实施，相关内部控制是否健全完善，是否符合相关法律法规的要求。

请保荐机构、发行人律师进行核查，并发表明确意见。

回复：

14.1 发行人说明

一、利用闲置资金购买银行理财产品及相关规模是否经过董事会决议和股东会审议通过，财务总监和总经理审批购买理财产品是否在董事会授权范围内实施

公司于2018年10月29日整体变更为股份有限公司。报告期内，公司处于有限公司阶段和股份公司阶段公司章程规定和具体执行情况如下：

1、报告期内，有限公司阶段

（1）独资公司阶段（2016年1月-2018年2月）

独资公司阶段，公司章程对经营管理机构进行了如下规定：

“

第二十二条 公司设总经理一人，负责公司的生产和经营管理；

第二十四条 总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织公司日常生产、技术和经营管理工作。副总经理协助总经理工作。

”

（2）合资公司阶段（2018年3月-2018年10月）

合资公司阶段，公司章程对经营管理机构进行了如下规定：

“第二十一条 合资公司设立经营管理机构，负责公司日常管理工作，经营管理机构设总经理一人，由董事会聘任，任期三年。

第二十二条 总经理的职责是执行董事会决议，组织合资公司日常经营和管理。”

澜起有限的公司章程中未规定购买理财产品需要获取公司董事会或股东大会的同意，且购买理财属于公司日常经营范围，由财务负责人和总经理审批即可，无需董事会审议。因此，2018 年 10 月 29 日前澜起有限购买的理财产品均经财务负责人和总经理审批。

2、报告期内，股份公司阶段

公司变更为股份公司后，公司章程对委托理财事项进行了如下规定：

“第四十条 公司下列交易行为，须经股东大会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上；

”

“第一百零七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

董事会有权批准以下事项：

（二）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 30% 以上的交易事项，但占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上的应由股东大会审议；”

公司整体变更为股份公司后，在报告期内未再购买理财产品。

二、相关内部控制是否健全完善，是否符合相关法律法规的要求

公司已在公司章程中对委托理财事项进行了规定，并制定了《对外投资与资产处置管理制度》。公司第一届董事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过

过了《关于公司 2019 年度自有资金理财额度的议案》，未来公司将在股东大会审议通过的范围内购买理财产品。综上所述，公司的内部控制健全完善，符合相关法律法规的要求。

14.2 保荐机构和发行人律师的核查过程和核查意见

核查过程：

保荐机构和发行人律师查阅了发行人的工商档案中的公司章程及股改之后的公司章程，并查阅了发行人的三会资料和和购买理财产品的相关审批资料，并核对发行人购买银行理财产品的明细。

核查结论：

经核查，发行人相关内部控制制度健全完善，发行人利用闲置资金购买银行理财产品符合公司章程及相关法律法规的要求。

15.关于现金分红

请发行人补充披露重要子公司的《公司章程》中对子公司分红政策的相关规定、报告期内重要子公司向发行人的现金分红及相应资金流转情况，是否符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定。

请保荐机构进行核查并发表明确意见。

回复：

15.1 发行人说明

发行人报告期内重要子公司系形成规模化利润的子公司，分别系澜起澳门、澜起开曼和澜起半导体。其中，澜起澳门主要承担境外采购、产品的销售，2018年度净利润8,357.88万美元；澜起开曼主要为境外公司的控股平台，持有澜起澳门100%的股权，2018年度净利润9,997.70万美元；澜起半导体从事产品的销售，2018年度净利润为4,218.56万元。

上述主要子公司《公司章程》中分红政策如下：

序号	公司名称	分红政策
1	澜起澳门	公司章程中未具体约定股利分配政策，但重大事项均可以由股东决定，且在符合当地法律法规的情况下，对分红没有做出限制性约定
2	澜起开曼	董事将负责制定澜起开曼股息分配方案，并以现金或支票的方式支付给股东，相应的股息不可超出澜起开曼经营利润，且股息不产生任何利息
3	澜起半导体	公司不设股东大会和董事会，由股东指定一名执行董事，并由其制定公司的利润分配方案

目前公司子公司均为公司直接或间接100%持有，公司可在满足各子公司当地法律法规的前提下，对其分红政策具有控制权，且相关子公司的公司章程中未对分红进行限制。

报告期内重要子公司向发行人的现金分红仅有一笔，系2018年12月24日，经澜起开曼股东（即发行人）决定，澜起开曼向澜起科技分配未分配利润合计4,000万美元。根据公司资金安排，澜起开曼尚未向公司实际支付该笔分红款项，但公司已经就该笔分红进行会计处理，并已经向税务局报税。

报告期内，公司于 2018 年 7 月 30 日召开董事会并通过决议，将共计人民币 298,270,863 元（税前）可分配利润分配给股东。2019 年 3 月 5 日，本公司召开第一届董事会第五次会议，批准 2018 年度利润分配预案，分配现金股利人民币 233,871,475 元（税前），该年度分红预案已经发行人 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。截至本问询函回复日，上述两次分红已向全体股东发放完毕。

报告期内及 2019 年公司现金分红的资金来源于母公司经营所得，其中 2019 年分红涉及的未分配利润部分来源于子公司分红。公司母公司分红资金由公司在履行其应尽的代扣代缴义务后支付给全体股东，其中公司支付给境外股东的分红款项均履行了银行必备的外汇管理登记手续，且办理了税收完税证明。报告期内及 2019 年公司的现金分红的资金流转情况符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定。

15.2 保荐机构的核查过程和核查意见

核查过程：

保荐机构查阅了发行人子公司的章程、澜起开曼股东决议，并查阅了发行人与子公司的资金往来，且查阅了发行人报税材料，获取了发行人有关分红三会文件，获取了发行人分红资金流转的支付凭证，获取了发行人在分红时对外资股东代扣代缴的完税证明。

核查结论：

经核查，保荐机构认为，目前发行人子公司均为直接或间接100%持有，发行人可在满足各子公司当地法律法规的前提下，对其分红政策具有控制权，且相关子公司的公司章程中未对分红进行限制。报告期内发行人的现金分红的资金流转情况符合国家外汇、税务等相关法律法规的规定。

15.3 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第十节 投资者保护”之“三、报告期内的股利分配情况”中补充披露：

2019年3月5日，本公司召开第一届董事会第五次会议，批准2018年度利润分配预案，分配现金股利人民币233,871,475元（税前），该年度分红预案已经发行人2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过。截至本招股说明书签署日，本次分红已向全体股东发放完毕。

.....

发行人报告期内重要子公司系形成规模化利润的子公司，分别系澜起澳门、澜起开曼和澜起半导体，其主要子公司《公司章程》中分红政策如下：

序号	公司名称	分红政策
1	澜起澳门	公司章程中未具体约定股利分配政策，但重大事项均可以由股东决定，且在符合当地法律法规的情况下，对分红没有做出限制性约定
2	澜起开曼	董事将负责制定澜起开曼股息分配方案，并以现金或支票的方式支付给股东，相应的股息不可超出澜起开曼经营利润，且股息不产生任何利息
3	澜起半导体	公司不设股东大会和董事会，由股东指定一名执行董事，并由其制定公司的利润分配方案

目前公司子公司均为公司直接或间接100%持有，公司可在满足各子公司当地法律法规的前提下，对其分红政策具有控制权，且相关子公司的公司章程中未对分红进行限制。

报告期内重要子公司向发行人的现金分红仅有一笔，系2018年12月24日，经澜起开曼股东（即发行人）决定，澜起开曼向澜起科技分配未分配利润合计4,000万美元。根据公司资金安排，该笔分红尚未实际支付。

16.关于核心技术人员认定

请保荐机构结合公司的体量、行业地位、研发重要及复杂程度、技术人员构成、发行人各项专利的发明人、集成电路布图设计权的创作人、核心技术对应的研发人员等情况，说明核心技术人员认定是否符合企业的实际情况。

请保荐机构、发行人律师进行核查，并发表明确意见。

16.1 发行人说明

公司历经十余年的专注研发和持续投入，成为全球可提供从DDR2到DDR4内存全缓冲/半缓冲完整解决方案的主要供应商之一。公司的核心技术完全基于自主知识产权，突破了一系列关键技术壁垒，具有较高的技术含量，在行业内占据领先地位。截至2018年12月31日，公司研发技术人员合计181名，包括核心技术人员4名，核心人员认定比例与行业内公司不存在重大差异。

公司主要研发部门包括市场应用技术部、研发部以及运营部，其中市场应用技术部主要负责芯片应用方案设计、技术支持等事务，包括应用方案中软件开发、测试、硬件设计、技术支持等工作。研发部主要负责公司集成电路设计的相关事务，包括数字电路设计、模拟电路设计、芯片验证、后端设计、辅助设计等工作。运营部主要负责芯片营运、量产等相关事务，包括物料管理、晶圆工艺设计、芯片封装测试、量产管理等工作。各部门在核心技术人员的带领下潜心研发，共同实现公司技术领域的发展和开拓。

公司核心技术人员为杨崇和、山岗、常仲元及史刚，分别为公司主要技术负责人及公司相关研发部门负责人，其获得的主要荣誉及对公司的贡献情况如下。

杨崇和，美国俄勒冈州立大学电子与计算机工程硕士及博士。杨崇和于2010年当选美国电气和电子工程师协会院士 (IEEE Fellow)。此外，杨崇和还荣获多种奖项，其中包括“IEEE CAS 产业先驱奖”和上海市政府授予的“白玉兰荣誉奖”。自公司成立以来，杨崇和一直担任公司董事长兼首席执行官，主要分管公司的战略发展和技术研发方向。杨崇和带头组建并培养了公司的核心技术研发团队，并对公司建立完整的产品布局起到了核心作用。

山岗为北京航空航天大学电子与通信系统硕士，曾经荣获中国电子学会科技

进步奖一等奖，上海市科学技术奖三等奖等。山岗目前担任市场应用技术部负责人，领导并参与了公司内存接口芯片产品线及其他产品线的产品定义、产品设计及测试和市场推广的工作。杨崇和与山岗带领团队发明了“1+9”分布式缓冲内存子系统框架，并贡献给行业组织，成为DDR4内存接口芯片的重要标准之一，为公司在DDR4内存接口芯片市场占有率提升做出了突出贡献。

常仲元为比利时鲁汶大学微电子学博士。常仲元曾在 IEEE 学术期刊和国际会议上发表了论文逾 20 篇，其中 3 篇发表于 ISSCC 会议（国际固态电路会议，世界学术界和企业界公认的集成电路设计领域高级别会议），并作为第一作者在美国出版了《Low Noise Wideband Amplifiers in Bipolar and CMOS Technology》。常仲元目前担任研发部负责人，直接负责公司的产品研发工作。目前常仲元正带领团队针对DDR5内存接口芯片及津逮®服务器平台开展研发工作。

史刚为复旦大学电子工程系微电子硕士。史刚目前担任运营部负责人，领导并负责了公司产品的量产工艺，封装技术，产品以及系统级测试工作，并同研发部门协作改进产品工艺，通过严格的质量管控有效地保证了公司产品质量和可靠性。

自2016年以来，公司累计申请境内、境外发明专利共30项，其中公司核心技术人员合计申请专利17项，占公司申请发明专利比例超过50%。报告期内公司申请发明专利超过3项的员工包括杨崇和、山岗、常仲元及李毅4人。其中，李毅系公司市场应用技术部产品经理，主要负责数据中心安全产品领域的开发工作，其参与申请的专利基本是与杨崇和、山岗共同申请的，在相关专利申请中主要起辅助角色，不属于公司核心技术人员。

除部门负责人外，公司相关研发部门达到总监级别以上的员工还有8名，分别负责公司技术研发、质量与封装工程、应用工程、测试开发工程等领域，为公司技术研发骨干人员。但相比公司核心技术人员，在技术积累、团队管理、专利申请等方面还存在一定差距，暂不适宜认定为核心技术人员。

综上所述，目前公司已形成了良好的研发人员梯队，技术人员结构合理。公司核心技术人员为公司主要技术负责人及公司相关研发部门负责人，其对公司的

核心技术发展起到了突出贡献和领导作用。核心技术人员认定符合企业的实际情况。

16.2 保荐机构及发行人律师的核查过程和核查结论

保荐机构和发行人律师获取了发行人发明专利清单及证书；获取了发行人内部职能部门的工作职责说明；获取了公司在研项目清单及主要参与人员名单；对发行人核心技术人员进行了访谈；获取了发行人核心技术人员基本情况调查表。

经核查，保荐机构和发行人律师认为，发行人核心技术人员认定符合企业的实际情况。

17.关于股东承诺

杨崇颐与公司董事长杨崇和是姐弟关系，请杨崇颐比照杨崇和，对其担任普通合伙人的珠海融英持有发行人的股份作出相关承诺。

17.1 发行人说明

杨崇颐作出了相关承诺如下：

（一）关于关联交易问题的承诺函

本人现就澜起科技关联交易问题作出如下承诺：

1、本人及本人所控制的其他企业组织将尽量避免或减少与澜起科技（含其合并报表范围子公司，下同）之间的关联交易，对于澜起科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由澜起科技与独立第三方进行。本人及本人所控制的其他企业组织将严格避免向澜起科技拆借、占用澜起科技资金或采取由澜起科技代垫款、代偿债务等方式占用澜起科技资金。

2、对于本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。

3、本人及本人所控制的其他企业组织与澜起科技之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守澜起科技章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在澜起科技权力机构审议有关关联交易事项时本人将主动依法履行回避义务；对需报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方予执行。

4、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使澜起科技承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致澜起科技损失或利用关联交易侵占澜起科技利益的，澜起科技有权单方终止该等关联交易。

（二）持股锁定承诺

本人现就直接或间接所持公司股份锁定事宜出具承诺如下：

1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行公司股份（如有），也不由公司回购直接或间接持有的该部分股份。

2、上述规定的锁定期满后，在本人近亲属担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让所持有的发行人股份数量不超过直接或间接所持有发行人股份总数的百分之二十五；在本人近亲属离职后半年内，不转让直接或间接所持有的发行人股份。

3、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定股份锁定期长于本承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定执行。

（三）关于未履行公开承诺的约束性措施

本人在澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市过程中作出及披露的公开承诺构成本人的义务，若未能履行，则：本人将及时向公司说明原因，由公司公告并向公司股东和社会公众投资者公开道歉，同时采取或接受以下措施以保障投资者合法权益：

1、立即采取措施消除违反承诺事项；

2、提出并实施新的承诺或补救措施；

3、公司有权直接按本人承诺内容向交易所或证券登记机构申请延长本人所持公司股份的锁定期。

17.2 补充披露情况

发行人已在招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、相关承诺事项”之“（八）间接持有公司股权的董事、监事和高级管理人员的亲属杨崇颐、Tai kuai Lap、Chao Iong Wa、李新岗的承诺”中补充披露。

18.关于信息披露

请发行人说明：招股说明书中关于“公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，产品广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域”等表述是否准确，是否存在以未来发展战略代替现状、夸大其词等信息披露问题，如存在，请发行人修改相关表述。

请发行人全文核对招股说明书相关内容，客观使用事实描述性语言，确保相关信息披露准确、清晰、客观。

回复：

18.1 发行人说明

截至本问询函回复日，公司主要产品包括内存接口芯片、津逮®服务器 CPU 以及混合安全内存模组，均属于服务器的核心芯片或部件。而服务器是支持云计算和人工智能的重要硬件平台，云计算和人工智能服务厂商均需要采购大量服务器，甚至组建专用数据中心。因此公司现阶段的主要产品是云计算和人工智能领域重要的电子元器件之一。

云计算和人工智能概念的提出至今已有较长的历史，之所以上述领域的应用在近年得以逐步实现，主要得益于服务器芯片计算和存储能力的大幅提升。公司的内存接口芯片是服务器内存模组的核心逻辑器件，其所实现的主要功能是提升内存数据访问的速度及稳定性，满足服务器 CPU 对内存模组日益增长的高性能及大容量需求。云计算和人工智能领域相关应用所需在服务器内存处理的数据都需要经过内存接口芯片。同时，公司已研发成功的第一代津逮®服务器 CPU 及混合安全内存模组也是服务器的核心器件之一。

因此招股说明书中相关表述确有相应依据。为严谨起见，相应表述修正为“公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，包含公司产品的服务器广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域”。

同时，为体现公司在报告期内主要收入来源为内存接口芯片，且第一代津逮®服务器 CPU 及混合安全内存模组只是在 2018 年底研发成功，在报告期内还没有给公司带来重要的收入贡献，公司将在招股说明书的重大事项提示、主营业务

等章节做出相应说明和提示。

18.2 保荐机构的核查过程和核查结论

核查过程：

保荐机构查阅了发行人所处产业链的研究报告，取得了发行人报告期内主要客户清单，访谈发行人核心技术人员，并取得了发行人对内存接口芯片等主要产品在云计算和人工智能领域的具体作用的说明性文件。

核查结论：

经核查，保荐机构认为：

发行人招股说明书相关表述确有相应依据。严谨起见，相应表述修正为“公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，包含公司产品的服务器广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域”。

同时，为体现公司在报告期内主要收入来源为内存接口芯片；且第一代津逮[®]服务器 CPU 及混合安全内存模组只是在 2018 年底研发成功，在报告期内还没有给公司带来重要的收入贡献。发行人将在招股说明书的重大事项提示、主营业务等章节做出相应说明和提示。

18.3 补充披露

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、公司的主营业务、主要产品及服务”之“（一）主营业务和主要产品的基本情况”中补充披露。

公司的主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案，目前主要产品包括内存接口芯片、津逮[®]服务器 CPU 以及混合安全内存模组。经过多年的研发积累，公司产品性能在行业内赢得高度认可，**包含公司产品的服务器**广泛应用于数据中心、云计算和人工智能等诸多领域，满足了新一代服务器对高性能、高可靠性和高安全性的需求。报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

.....

公司已于 2018 年底成功推出了第一代津逮[®]服务器平台产品，但目前还处于市场推广阶段，不是公司报告期内的主要收入来源。未来不排除因技术、市场、政策等因素的影响而导致该项业务的实际开展不及预期，从而对经营情况造成一定不利影响。

19. 关于其他问题

根据回复材料，澜起香港于2016年4月在香港完成商业登记注册，2016年6月在台湾设立外国公司办事处，住址为114台北市内湖区基湖路3巷47号2楼。

请保荐机构、发行人律师核查上述表述是否准确、恰当。

19.1 保荐机构和发行人律师的核查过程和核查结论

保荐机构和发行人律师获取了澜起香港的境外法律意见书以及台湾办事处的登记文件。

经核查，将上述表述修正为

“澜起香港于 2016 年 4 月 21 日完成商业登记注册，发行股数为 1 股，每股 1 港币，注册地为香港。发行人通过全资子公司澜起开曼间接持有澜起香港的 100% 股权。

2016 年 6 月 8 日，澜起香港在台湾地区设立办事处，住址为台北市内湖区基湖路 3 巷 47 号 2 楼。”

（本页无正文，为《澜起科技股份有限公司、中信证券股份有限公司关于<关于澜起科技股份有限公司首次发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函>之回复报告》之签署页）

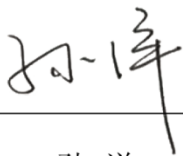


澜起科技股份有限公司

2019年5月19日

（本页无正文，为《澜起科技股份有限公司、中信证券股份有限公司关于<关于澜起科技股份有限公司首次发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函>之回复报告》之签署页）

保荐代表人：



孙 洋



王建文



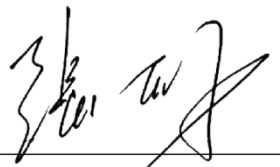
中信证券股份有限公司

2019年5月19日

保荐机构管理层声明

本人已认真阅读澜起科技股份有限公司本次问询函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，问询函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



张佑君



中信证券股份有限公司

2019年5月19日